

股票简称：胜宏科技

股票代码：300476



胜宏科技（惠州）股份有限公司

Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.

（注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园）

2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿）

保荐机构（主承销商）



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二五年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、特别风险提示

公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。

（一）境外收入波动的风险

报告期内，公司境外销售收入分别为 490,583.36 万元、487,633.43 万元、653,282.61 万元和 338,055.58 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 65.49%、65.38%、65.00%和 82.95%，占比较高，境外销售是公司收入的重要来源，境外收入的波动会给公司整体收入水平带来较大的影响。公司境外销售收入可能面临国际贸易摩擦、市场竞争激烈、相关国家或地区政策法规变动、汇率波动等因素影响，导致境外销售收入波动进而对公司业绩产生不利影响。

（二）募投项目投产后的新增产能消化风险

公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业，在海外布局高阶 HDI 及高多层板产能。本次募集资金投资项目达产后，公司计划新增高阶 HDI 产能 15 万 m²/年，占公司 2024 年 HDI 产能的比例为 16.13%；以及高多层板产能 150 万 m²/年，占公司 2024 年双面/多层板产能的比例为 17.34%。公司对本次发行募集资金投资项目的新增产能规划和可行性研究是在目前市场环境及行业发展趋势、客户需求和公司技术能力等基础上进行的，若上述因素发生重大不利变化，或宏观经济导致行业下行，则公司可能出现无法按原计划顺利实施该等募集资金投资项目，或该等项目的新增产能无法有效消化的风险。

（三）募投项目效益不达预期的风险

公司本次募投项目在境外实施，泰国高多层印制线路板项目和越南胜宏人工智能 HDI 项目预计达产后可分别实现年营业收入 195,000.00 万元和 165,000.00 万元，达产年毛利率分别为 18.24%和 25.03%，效益测算基于现有的原材料价格、当地和外派人工薪酬水平、历史费用水平、当地税收政策及汇率情况。

募投项目生产所需原材料主要从中国国内进口，随着募投项目的实施推进及

当地产业链配套的逐步完善，公司将结合采购成本、交期、材料品质等方面的考虑，从当地采购部分原材料。若未来在募投项目投产后，主要原材料对应大宗商品价格大幅上涨导致原材料市场价格出现剧烈波动且公司无法将价格及时传导至下游厂商、国际物流成本大幅提升、贸易政策发生不利变化，会使得募投项目的成本增加。若募投项目实施地人力资源成本及其他费用水平大幅提升、税收政策发生不利变化或汇率出现大幅不利波动，会使得募投项目的费用增加。该等情形均会导致项目利润水平下降，进而导致募投项目存在效益未达预期的风险。

（四）境外实施募集资金投资项目的风险

本次募集资金投资项目包括越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目，分别以越南胜宏和泰国胜宏作为募投项目实施主体。境外业务开展受当地法律法规、政治局势、经济政策等多种因素影响，若公司无法及时应对境外市场变化，或境外投资政策、税收政策等发生重大不利变化，公司的境外募投项目将面临无法按期实施或无法实现预期效益的风险。

（五）募集资金购置长期资产导致公司折旧费用增加的风险

公司本次募投项目越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目为建设项目，涉及规模较大的建设工程和设备采购等资本性支出，上述两个项目的实施将新增相应的固定资产，折旧金额相应增加。按照公司现行的资产折旧政策，本次募集资金投资项目建成后公司每年新增折旧金额为 24,696.13 万元，占公司 2022 年-2024 年年均利润总额的比例低于 26%，且公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果未来行业政策或市场环境发生重大变化，导致募集资金投资项目不能实现预期收益，则新增固定资产折旧将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

（六）募投项目人员、技术、市场储备不足及产业链配套情况变化风险

公司已对本次募投项目的必要性及可行性进行审慎分析论证，并针对项目实施在人员、技术、市场等方面完成了必要的前期规划和积累，对募投项目实施地的产业链配套情况进行了充分的研判。实施募投项目不存在重大不确定性，不会影响公司整体发展。但若募投项目实施过程中市场环境、客户需求、行业技术路线、募投实施地经营环境等出现重大不利变化，公司可能存在因人员、技术、市场储备不足或产业链配套无法满足公司经营需求导致募投项目实施进度不及预

期或无法实施的风险。

（七）募投项目终止风险

在 PCB 行业进入新一轮增长周期的背景下，公司本次募投项目具备可行性。但是在多变的国际经济环境下，如果宏观经济发生剧烈波动或严重衰退，或贸易流通严重受限，将导致包括公司在内的 PCB 企业面临一定的行业波动风险。若公司经充分研判后，确定募投项目继续实施将会给公司带来巨大的经济损失、损害投资者利益，公司存在募投项目终止风险。

（八）募投项目实施风险

公司结合当前行业发展情况、公司发展战略等因素对募集资金投资项目进行了审慎、充分的调研、论证和可行性分析，但本次募集资金投资项目在实施过程中仍面临市场供求变化、行业竞争情况变化、技术更新等诸多不确定因素，存在本次募集资金投资项目不能按时顺利完成或项目实施效果不达预期的风险。

（九）市场竞争风险

PCB 行业内企业众多，市场竞争较为激烈，日益呈现“大型化、集中化”的趋势。快速发展的下游行业和稳定合作的优质客户是公司持续发展的重要保证。如果宏观经济波动等因素导致下游需求减少，或 AI 等行业技术路线发生变化，进而导致市场竞争加剧且公司未能提升自身市场竞争力，或公司未能保持在产品性能、可靠性、交付能力等方面的优势导致订单减少，或公司不能充分抓住市场机遇，在产品开发、市场策略等方面及时适应市场需求及竞争状况，公司的市场竞争优势将可能被削弱，并面临市场份额下降或被竞争对手超越的风险。

（十）原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔，2024 年原材料成本占营业成本比重为 62.67%，原材料成本占比较高，是公司产品定价的重要影响因素之一。原材料大幅涨价的情形下，公司会相应提高产品售价，但向下游的传导存在一定滞后。公司原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大，2023 年和 2024 年，LME 铜现货平均结算价分别较上年同期变动-3.63%和 7.90%。若未来原材料对应大宗商品价格大幅上涨导致原材料价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现盈利能力下降等

情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

（十一）商誉减值风险

2025年3月末，公司商誉账面价值为121,567.43万元，占公司总资产的比例为5.81%，为公司2023年收购PSL 100%股权时形成的商誉116,877.05万元和公司2024年收购泰国胜宏100%股权时形成的商誉4,690.38万元，暂未发生减值情形。未来，若PSL相关的MFS资产组和泰国胜宏资产组出现经营不善或其他重大不利变化的情形，导致业绩不及预期，上述商誉存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

二、本次向特定对象发行A股股票情况

1、本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、2024年第二次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过、**深圳证券交易所审核通过**。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。

4、本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过257,292,863股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会授权，在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并完成中国证监会注册后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行股票总数及募集资金总额届时将相应调整。

5、本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

6、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过190,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	85,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00
合计		376,755.57	190,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金中用于偿还银行借款和补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，超出金额为 7,955.07 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 8,000.00 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议审议，公司本次发行募集资金总额由原不超过 198,000.00 万元调减至不超过 190,000.00 万元。

7、本次向特定对象发行股票不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该规划已经由公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

9、为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施做出了承诺，相关措施及承诺事项等议案已经由公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。

公司特别提醒投资者注意：公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

10、本次向特定对象发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

目 录

公司声明	1
重大事项提示	2
一、特别风险提示.....	2
二、本次向特定对象发行 A 股股票情况.....	5
目 录	8
释 义	11
一、普通术语.....	11
二、专业术语.....	12
第一节 发行人基本情况	15
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	15
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	18
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	50
四、现有业务发展安排及未来发展战略.....	58
五、财务性投资情况.....	60
六、未决诉讼、仲裁等事项.....	63
七、违法行为、资本市场失信惩戒等相关情况.....	63
第二节 本次证券发行概要	66
一、本次发行的背景和目的.....	66
二、发行对象及其与发行人的关系.....	68
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	68
四、募集资金金额及投向.....	70
五、本次发行是否构成关联交易.....	70
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	70
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	71
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	72
一、本次募集资金使用计划.....	72
二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系.....	72
三、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景.....	73
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	90
五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	91
六、本次募集资金用于研发投入的情况.....	93

七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	93
八、募集资金使用可行性分析结论.....	93
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	95
一、本次发行后上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	95
二、本次发行后公司控制权结构的变化.....	95
三、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	95
四、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	96
第五节 历次募集资金的使用情况.....	97
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况.....	97
二、前次募集资金实际使用情况说明.....	98
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明.....	103
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况.....	104
五、会计师对于前次募集资金运用所出具的报告结论.....	104
第六节 与本次发行相关的风险因素.....	105
一、与本次向特定对象发行的相关风险.....	105
二、境外收入波动的风险.....	105
三、募集资金投资项目风险.....	105
四、原材料价格波动的风险.....	108
五、商誉减值风险.....	108
六、汇率波动对业绩产生不利影响的风险.....	108
七、应收账款坏账风险.....	109
八、存货跌价的风险.....	109
九、流动比率及速动比率较低、资产负债率较高导致的偿债风险.....	109
十、无形资产摊销风险.....	109
十一、管理风险.....	110
十二、境外投资风险.....	110
十三、宏观经济波动的风险.....	110
十四、市场竞争风险.....	110
十五、人工成本上升的风险.....	111
第七节 有关声明.....	112
发行人董事会声明.....	121
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.....	121

二、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报所采取的措施	121
附件一 自有房地产清单	125
一、境内自有房地产	125
二、境外自有房地产	128
附件二 租赁房产清单	131
一、境内租赁房产	131
二、境外租赁房产	132

释 义

除非本募集说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：

一、普通术语

发行人、本公司、公司、股份公司、胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
胜华欣业	指	深圳市胜华欣业投资有限公司，系公司控股股东
香港胜宏	指	胜宏科技集团（香港）有限公司，系公司第二大股东
胜宏研究院	指	惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司
宏兴国际	指	宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司
胜宏电子	指	深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司
胜华电子	指	胜华电子（惠阳）有限公司，系公司全资子公司
胜宏精密	指	惠州市胜宏精密技术有限公司，系公司全资子公司
科发富鼎	指	宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙），系公司控股子公司
美国胜宏	指	VGTPCB Inc.，系公司全资子公司
日本宏兴	指	宏兴国际株式会社，系公司全资子公司
PSL	指	Pole Star Limited，系公司全资子公司
MFS 集团	指	由 PSL 旗下六家子公司构成的整体，具体包括 MFSS、MFSM、维胜电路板、维胜科技、益阳维胜及 MFSE
MFSS	指	MFS TECHNOLOGY (S) PTE LTD，系公司全资子公司
MFSM	指	MFS TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.，系公司全资子公司
维胜电路板	指	湖南维胜科技电路板有限公司，系公司全资子公司
维胜科技	指	湖南维胜科技有限公司，系公司全资子公司
益阳维胜	指	益阳维胜科技有限公司，系公司全资子公司
MFSE	指	MFS Technology Europe UG (haftungsbeschränkt)，系公司全资子公司
新加坡胜宏	指	VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，系公司全资子公司
越南胜宏	指	VICTORY GIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED，系公司全资子公司
泰国胜宏	指	VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，系公司全资子公司，2024 年 12 月 3 日前曾用名 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.
珠海越亚	指	珠海越亚半导体股份有限公司，系公司参股公司
方正科技	指	方正科技集团股份有限公司，系公司参股公司

惠州宏大	指	惠州市宏大投资发展有限公司
博达兴	指	惠州市博达兴实业有限公司
台达	指	台达电子工业股份有限公司及其关联公司
诺和诺德	指	Novo Nordisk 及其关联公司
Continental	指	Continental Automotive GmbH 及其关联公司
英特尔	指	Intel Corporation
AMD	指	Advanced Micro Devices, Inc.
特斯拉	指	Tesla, Inc.
英伟达	指	NVIDIA Corporation
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC，印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力
CPCA	指	“China Printed Circuit Association”的英文缩写，即中国电子电路行业协会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
发行人律师、君合律师	指	北京市君合律师事务所
立信会计师、会计师、申报会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	截至本募集说明书签署之日有效的《胜宏科技（惠州）股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年一期	指	2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

二、专业术语

PCB、印制电路板	指	“Printed Circuit Board”的缩写，即采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。印制电路板是电子元器件的支撑体和电气连接的载体，又称“印刷电路板”、“印刷线路板”
FPC、柔性电路板、挠性板	指	“Flexible Printed Circuit”的缩写，以挠性覆铜板为基材制成的一种电路板，又称“挠性印制电路板”、“软板”
刚性电路板、刚性	指	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，具

板		有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑，又称“硬板”
刚挠结合板	指	刚性电路板和柔性电路板的结合，既可以提供刚性电路板的支撑作用，又具有柔性电路板的弯曲特性，能够满足三维组装需求，又称“软硬结合板”
厚铜板	指	使用厚铜箔（铜厚在 3 盎司及以上）或成品任何一层铜厚为 3 盎司及以上的印制电路板
HDI 板、高密度互连积层板	指	“High Density Interconnection”的缩写，即高密度互连积层板，一种使用微盲孔导通技术且布线密度高于常规 PCB 的印制电路板
封装基板	指	一种芯片封装的核心材料，作为载体承载芯片，为芯片提供保护、固定、支撑及散热的作用，同时实现芯片与印刷电路板之间的电气与物理连接、功率分配、信号分配，以及沟通芯片内部与外部电路等功能，又可称为 IC 封装载板、IC 封装基板、封装载板、IC 载板或 IC 基板
高频微波印制电路板、高频板	指	即使用特定的高频基材生产的印制电路板，又可称为高频通讯电路板、高频电路板、高频板、射频电路板等
单面板	指	仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB
双面板	指	在基板两面形成导体图案的 PCB，两面间一般有适当的导孔相连
多层板	指	具有更多层导电图形的 PCB，生产中需采用定位技术将 PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔互联
Riser 卡	指	一种扩展卡，用于将多个硬件设备（如硬盘驱动器、网络适配器、显卡等）集成到服务器的主板上
基板、基材	指	制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两大类
补强材料	指	用于解决柔性电路板的柔韧性，提高插接部位的强度，方便产品的整体组装，包括 PI、FR4、铝片等
覆铜板	指	由铜箔、树脂、补强材料及其它功能补强添加物组成的 PCB 加工基材，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两类
半固化片	指	一种用于制作多层板的、主要由树脂和增强材料组成的材料。其中增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型，目前制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料
SMT	指	“Surface Mount Technology”的缩写，即表面组装技术，一种将表面元器件贴装到 PCB 上的生产工艺
V-CUT	指	一种精密机械加工工艺，利用特殊刀具在 PCB 表面切割出 V 形槽，通常用于提高生产和装配效率
FPCA	指	“Flexible Printed Circuit Assembly”的英文缩写，即柔性印制电路板组件
盲孔	指	连接 PCB 表层和内层而不贯通整板的导通孔，用于提升布线密度和节省空间
埋孔	指	隐藏在 PCB 内层之间的过孔，不与表层连接，主要用于内层信号

		的互联和优化布线设计
叠孔结构	指	通过钻孔创造内部连接通路的技术，也称为盲孔和埋孔工艺
电镀	指	利用电化学原理，将金属离子通过电流沉积在印制电路板表面或孔壁上，形成一层均匀、致密的金属镀层，以实现导电、抗氧化、防腐蚀或其他功能性需求的工艺过程
蚀刻	指	将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术，通过曝光、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用
ADAS	指	“Advanced Driving Assistant System”的英文缩写，即高级驾驶辅助系统，是利用安装在车上的各式各样的传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性
HPC 系统	指	高性能计算(High Performance Computing, 缩写 HPC)系统，是一种高度集成的计算环境，旨在解决大规模和高复杂性的计算问题。它通过使用强大的处理器集群，结合高速互联技术，实现对海量多维数据集的处理能力
5G	指	第五代移动通讯技术，具有高数据速率、延迟低、允许大规模设备连接的特性，使得智能手机、可穿戴设备、AR/VR 设备、多功能笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、物联网硬件等智能终端能够互联
云计算	指	分布式计算的一种，通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
物联网	指	互联网、传统电信网等的咨询承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络
AR	指	“Augmented Reality”的英文缩写，即增强现实，是一种技术，可以将虚拟的信息内容（如文字、图像、视频、3D 模型等）实时地计算并呈现到真实世界的场景中，使得虚拟的信息与真实世界相互融合，形成一种超越现实的感官体验
VR	指	“Virtual Reality”的英文缩写，即虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的仿真系统和硬件系统
LED	指	“Light Emitting Diode”的英文缩写，即发光二极管
工业 4.0	指	第四次工业革命的概念，也被称为智能工厂或数字化工厂。它涉及到制造业的数字化转型和智能化发展，通过融合物联网、大数据、人工智能和自动化技术等，实现生产过程的智能化、柔性化和高效化
RoHS	指	欧盟发布的《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

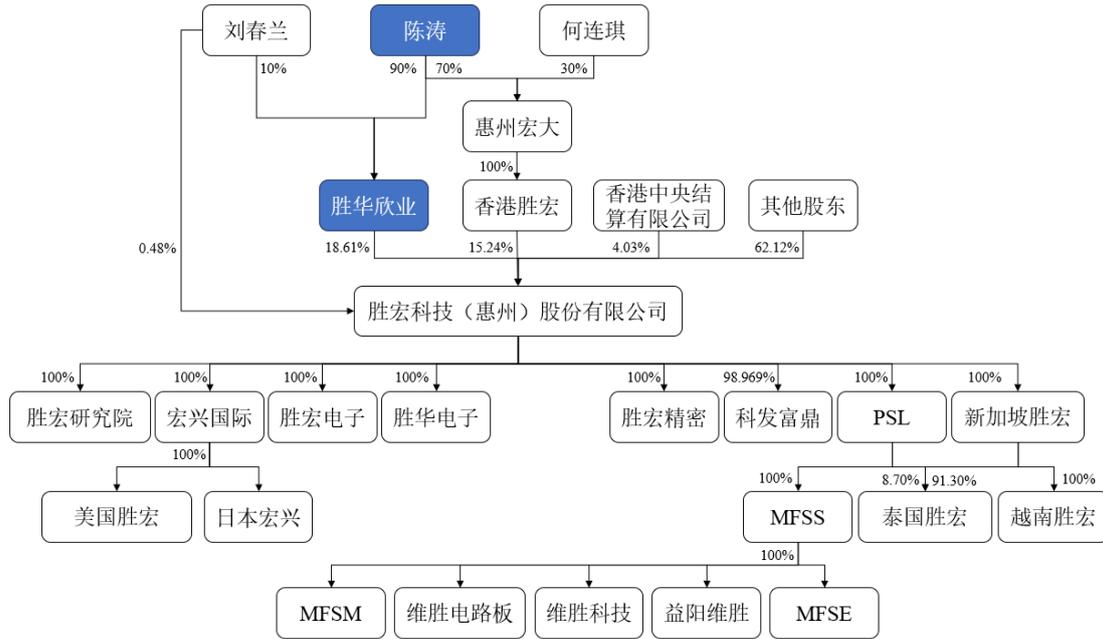
（一）发行人基本情况

公司名称	胜宏科技（惠州）股份有限公司
英文名称	Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.
成立日期	2006年7月28日（有限责任公司成立）
	2012年2月27日（股份有限公司设立）
注册资本	862,688,641 元
法定代表人	陈涛
注册地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
办公地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
股票简称	胜宏科技
股票代码	300476.SZ
股票上市地	深圳证券交易所
董事会秘书	朱溪瑶
证券事务代表	周响来
联系电话	0752-3761918
传真号码	0752-3761928
电子信箱	zqb@shpcb.com
互联网网址	www.shpcb.com
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	印制线路板的研发、生产和销售。
主要产品	公司专业从事高精密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品覆盖刚性电路板（高端多层板和 HDI 板为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域

（二）公司股权结构

1、股权结构图

截至 2025 年 3 月 31 日，公司股权结构图如下：



2、公司前十名股东持股情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司的前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例
1	深圳市胜华欣业投资有限公司	境内非国有法人	160,566,476	18.61%
2	胜宏科技集团（香港）有限公司	境外法人	131,432,001	15.24%
3	香港中央结算有限公司	境外法人	34,794,731	4.03%
4	惠州市博达兴实业有限公司	境内非国有法人	28,311,973	3.28%
5	中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,936,153	1.73%
6	招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	13,119,800	1.52%
7	深圳永冠基金管理有限公司一永冠新瑞 1 号私募证券投资基金	其他	9,190,000	1.07%
8	中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,746,330	0.90%
9	中国农业银行股份有限公司一摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	6,377,019	0.74%
10	中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,961,660	0.69%
合计			412,436,143	47.81%

(三) 控股股东及实际控制人

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。截至本募集说明书签署之日，公司控股股东胜华欣业持有公司 15.63% 的股份，香港胜宏持有公司 15.24%

股权，实际控制人陈涛持有胜华欣业 90%的股权并间接持有香港胜宏 70%的股权，合计控制公司 30.87%的表决权，间接持有公司 24.74%的股权，为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量不超过 257,292,863 股，以上限 257,292,863 股计算，本次发行完成后，控股股东胜华欣业持有公司 12.04%的股权，香港胜宏持有公司 11.74%的股权，陈涛控制公司 23.78%的表决权，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制人发生变更。

1、控股股东

项目	基本情况
公司名称	深圳市胜华欣业投资有限公司
成立时间	2001年9月3日
注册资本	50万元
法定代表人	陈涛
住所	深圳市南山区南山大道新海大厦 15D
经营范围	项目投资；国内贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）

截至本募集说明书签署之日，胜华欣业股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	陈涛	45.00	90.00%
2	刘春兰	5.00	10.00%
合计		50.00	100.00%

截至本募集说明书签署之日，公司控股股东胜华欣业持有公司股份 134,837,190 股，占公司股份总数的 15.63%，胜华欣业的一致行动人陈勇持有公司股份 2,539,681 股，占公司股份总数的 0.29%；胜华欣业不存在质押或冻结股份，胜华欣业的一致行动人陈勇持有公司股份累计被质押 1,240,000 股，占其所持公司股份比例为 48.83%，占公司总股本比例为 0.14%，质押情况具体如下：

质押人	质权人	质押股数（万股）	质押股数占质押人所持股份比例	质押股数占公司总股本比例	质押起始日期	质押到期日	质押用途
陈勇	招商证券股份有限公司	124.00	48.83%	0.14%	2025年3月14日	2026年3月13日	资金需求

2、实际控制人

陈涛先生：中国国籍，EMBA，高级工程师，无境外永久居留权；现任公司

董事长；胜华电子（惠阳）有限公司董事长、总经理；深圳市胜华欣业投资有限公司执行董事；惠州市宏大投资发展有限公司执行董事；深圳市胜宏电子有限公司执行董事兼总经理；胜宏科技集团（香港）有限公司董事；陇上江南旅游开发有限公司执行董事；甘肃龙台酒业有限公司执行董事；文县陈氏庄园酒店管理有限公司执行董事兼总经理；惠州市胜宏科技研究院有限公司执行董事兼总经理；惠州市胜宏精密技术有限公司执行董事；湖南维胜科技有限公司董事；湖南维胜科技电路板有限公司董事；益阳维胜科技有限公司董事；宏兴国际科技有限公司董事；VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事；VICTORY GIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事；VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 董事。曾在新疆兵团武警指挥部三支队、新疆喀什市二轻局服务公司、广东惠州统将电子有限公司任职。

二、所处行业的主要特点及行业竞争情况

发行人主要从事印制电路板的研发、设计、生产和销售。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3982 电子电路制造”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所属行业为“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.1 新型电子元器件及设备制造之 1.2.1.3982 电子电路制造”。

（一）行业管理部门

1、政府职能部门

中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。工业部下属的电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

2、行业自律性组织

中国电子电路行业协会（简称“CPCA”）为印制电路板行业自律组织，是

隶属工信部业务主管领导的具有独立法人资格的国家一级行业协会。CPCA 通过民主协商、协调，为行业的共同利益，发挥提供服务、反映诉求、规范行为的作用，在产业发展、行业研究、标准制定、技术交流、展览展示、刊物出版、人才培养、国际交流等方面积极开展工作。

（二）产业政策

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电路板作为电子信息产业的基础产品，政府出台多项政策扶持印制电路板行业发展。我国支持印制电路板产业发展的有关政策具体如下：

序号	政策名称	发布时间	部门	有关内容
1	《印制电路板行业规范条件》、《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》	2019年2月	工信部	按照优化布局、调整结构、绿色环保、推动创新、分类指导的原则制定，对于 PCB 企业及项目从产能布局与项目建设、生产规模和工艺技术、智能制造、绿色制造、安全生产、社会责任等若干维度形成量化标准体系。
2	《2020 年国务院政府工作报告》	2020年5月	国务院	提出加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级。
3	《建设高标准市场体系行动方案》	2021年1月	国务院	提出推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。其中 5G 建设投资力度排在第一位，突出了 5G 建设的重要性。
4	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	2021年1月	工信部	将“连接类元器件：高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板”列入重点产品高端提升行动，在智能终端、新一代通信技术、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，加快印制电路板产业发展。
5	《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》	2021年5月	国家统计局	印刷电路板被列入数字经济核心产业。
6	《“十四五”数字经济发展规划》	2021年12月	国务院	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给

序号	政策名称	发布时间	部门	有关内容
				水平。加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
7	《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》	2022 年 10 月	发改委、商务部	明确将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板等”列入鼓励外商投资产业目录。
8	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	2023 年 8 月	工信部、财政部	梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。
9	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023 年 12 月	发改委	将“二十八、信息产业 5、新型电子元器件制造（高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路(线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$)柔性电路板等)；6、电子元器件生产专用材料中的新型电子元器件（高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）”列入鼓励类产业。

（三）行业发展概况

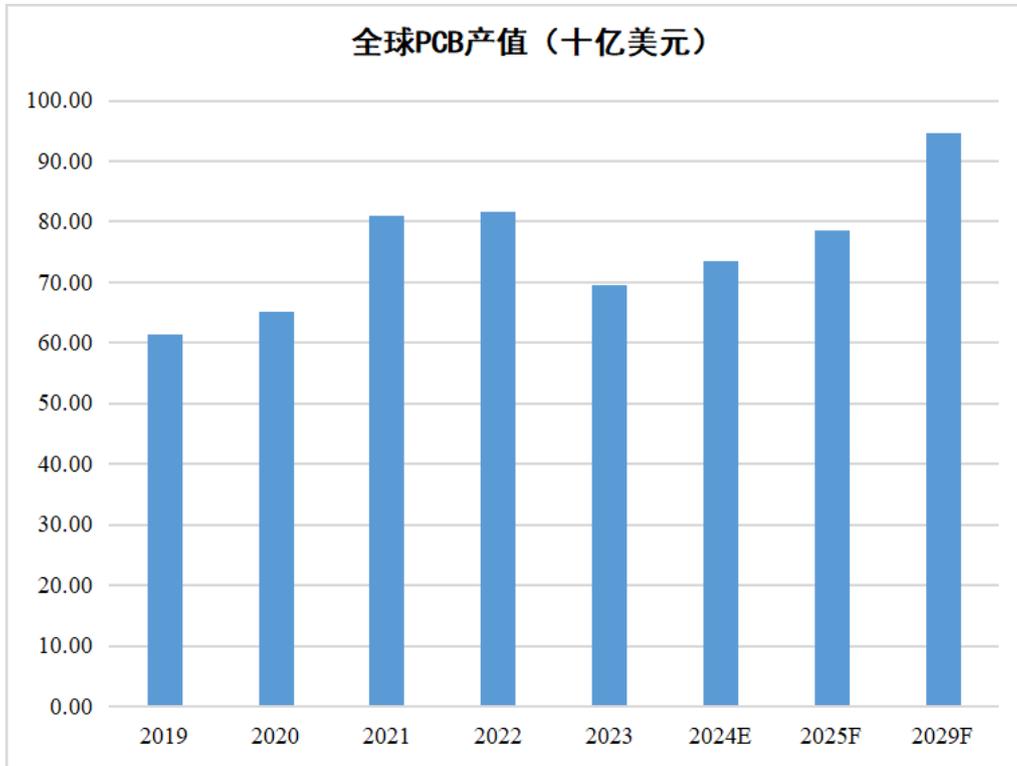
1、全球 PCB 行业发展现状

PCB，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，广泛应用于服务器/数据存储、计算机、汽车、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等领域，在整个电子产品中具有不可替代性，被誉为“电子产品之母”。

（1）产值规模

PCB 是电子信息技术的核心基础组件，在全球电子元件细分产业中产值占比最大。2024 年，受益于 AI 推动的交换机、服务器等算力基建爆发式增长，智能手机、PC 的新一轮 AI 创新周期，以及汽车电动化/智能化落地带来的量价齐升，HDI、层数较高的多层板等高端品需求快速增长，PCB 行业景气度持续上行，根据 Prismark 数据，2024 年全球 PCB 产值恢复增长，产值达到 735.65 亿美元，同比增长 5.8%。

随着人工智能技术和应用的快速发展，未来五年 AI 系统、服务器、存储、网络设备等是 PCB 需求增长的主要动能，并为 PCB 行业带来新一轮成长周期，未来全球 PCB 行业仍将呈现增长的趋势。根据 Prismark 数据，2029 年全球 PCB 产值将达到 946.61 亿美元，2024-2029 年年均复合增长率预计为 5.2%。



数据来源：Prismark

（2）产值分布

PCB 产业在世界范围内广泛分布，美、欧、日发达国家起步较早，在 2000 年以前，全球 PCB 产值 70%以上分布在美洲（主要是北美）、欧洲及日本等地区。近二十年来，凭借亚洲尤其是中国大陆、东南亚在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆、东南亚等亚洲地区进行转移，PCB 行业呈现以中国大陆、东南亚等亚洲地区为制造中心的新格局。

自 2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一。根据 Prismark 数据，中国大陆占全球 PCB 行业总产值的比例已由 2000 年的 8.10%上升至 2024 年的 56.02%；预计到 2029 年，中国大陆仍将占据全球 PCB 产值的 50%以上。近年来，在下游电子行业产能转移的带动下，全球 PCB 产业也显现向东南亚转移的趋势，东南亚地区占全球 PCB 行业总产值的比例正在不断提升，预计 2029 年占比提升到 11.51%，2024-2029 年产

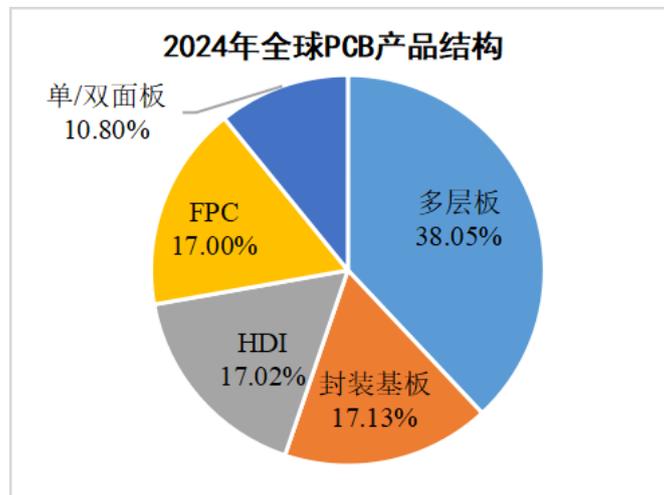
值复合增长率将达到 12.4%，领跑全球其他地区。

地区/国家	2000 年		2024 年		2029 年预测 产值 F (亿美元)	2024-2029 年 CAAGR
	产值 (亿美元)	比例	产值 (亿美元)	比例		
美洲	108.52	26.11%	34.93	4.75%	40.75	3.1%
欧洲	67.02	16.12%	16.38	2.23%	18.63	2.6%
日本	119.24	28.68%	58.40	7.94%	78.55	6.1%
中国大陆	33.68	8.10%	412.13	56.02%	497.04	3.8%
东南亚地区	21.61	5.20%	60.81	8.27%	108.98	12.4%
其他地区	65.63	15.79%	153.00	20.80%	202.66	5.8%
总计	415.7	100.00%	735.65	100.00%	946.61	5.2%

数据来源：Prismark

(3) 产品结构

随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化应用日益广泛，电子产品对 PCB 板的高密度、高精度、高性能、高效率的要求更加突出；多层板、HDI 板、封装基板、FPC 等高端 PCB 产品的市场地位提升。根据 Prismark 数据，2024 年全球多层板的市场规模最大，占比达 38.05%；其次是封装基板和 HDI，占比分别为 17.13%和 17.02%；FPC 占比达 17.00%。



数据来源：Prismark

根据 Prismark 数据，2024 年，在 AI 服务器和高速网络的强劲驱动下，18 层板及以上高多层板、HDI 板产值分别同比增长 40.3%和 18.8%，领跑其他 PCB 细分产品。

未来五年，在高速网络、人工智能、服务器/数据储存、汽车电子（EV 和 ADAS）、卫星通讯等下游行业需求增长驱动下，高多层板、HDI 板、封装基板

需求将持续增长，其中 18 层及以上 PCB 板、HDI 板、封装基板领域表现将领先于行业整体，预期 2029 年市场规模分别为 50.20 亿美元、170.37 亿美元、179.85 亿美元，2024-2029 年复合增长率分别为 15.7%、6.4%、7.4%。

2024-2029 年全球 PCB 行业产品结构表现

全球产品结构表现	2024 年		2029 年	2024-2029 年 复合增长率 F
	产值 E (亿美元)	同比	产值 F (亿美元)	
纸基板/单面板/双面板	79.47	2.4%	91.49	2.9%
4-6 层板	157.36	2.0%	176.61	2.3%
8-16 层板	98.37	4.9%	121.92	4.4%
18 层板及以上	24.21	40.3%	50.20	15.7%
HDI 板	125.18	18.8%	170.37	6.4%
封装基板	126.02	0.8%	179.85	7.4%
FPC	125.04	2.6%	156.17	4.5%
合计	735.65	5.8%	946.61	5.2%

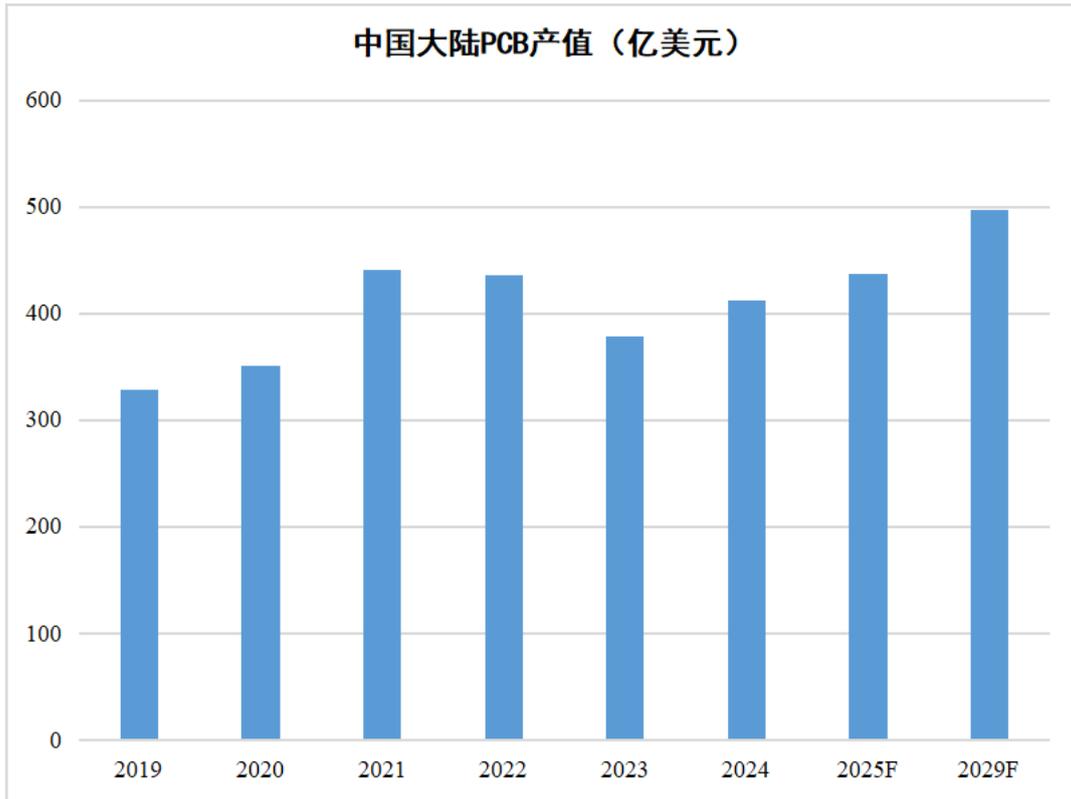
数据来源：Prismark

2、中国 PCB 行业发展现状

(1) 产值规模

目前，中国大陆以超过 50%的产值占比居于世界 PCB 产业的主导地位，成为全球 PCB 行业产值最大的区域。根据 Prismark 数据，2000 年-2020 年中国大陆 PCB 产值复合增长率高达 12.4%，领先于全球 PCB 产值的复合增长率 2.3%。2024 年，在欧洲、日本、韩国等地区 PCB 产值下滑的情况下，中国大陆 PCB 产值增长到 412.13 亿美元，同比增长 9.0%，增速领跑全球其他地区及 PCB 行业整体。

随着 AI、服务器/数据储存、汽车电子（EV 和 ADAS）、AR/VR、卫星通讯等下游应用领域的高速发展，PCB 产业在中长期将继续保持增长态势，其中 AI 推动的下游需求增长拉升 HDI、高多层板、IC 载板等高端品需求，成为 PCB 增长的主要动力。根据 Prismark 数据，2029 年中国大陆 PCB 产值将达到 497.04 亿美元，2024 年-2029 年年均复合增长率预计为 3.8%，低于全球复合增长率（5.2%），主要系中国大陆 PCB 行业的产品结构（增速较快的封装基板占比较低）和一些预期的产能向东南亚转移。然而，预计到 2029 年，中国大陆仍将是全球第一大 PCB 生产国，产值和产量占比均保持在 50%以上。



数据来源：Prismark

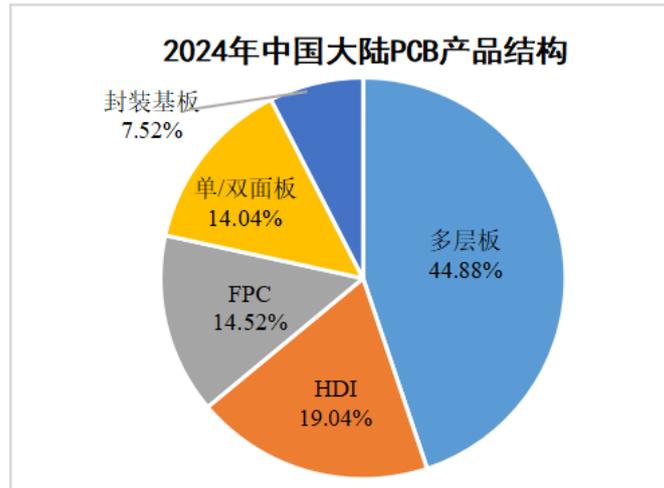
（2）产值分布

中国大陆有上千家 PCB 企业，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，该等地区具备较强的经济优势、区位优势及人才优势。然而，近年来受劳动力成本不断上涨影响，部分 PCB 企业为缓解劳动力成本等上涨带来经营压力，逐步将生产基地转移至内陆地区。由于中国内需持续增长及产业集聚效应，诸多外资 PCB 企业也在中国大陆投资建厂。

（3）产品结构

根据 Prismark 数据，2024 年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比 44.88%，单/双面板占比 14.04%；其次是 HDI 板，占比达 19.04%；FPC 和封装基板占比分别为 14.52%和 7.52%。

从中长期来看，人工智能服务器、高速网络和汽车系统的强劲需求将继续支持高端 HDI、高多层板和封装基板细分市场的增长，Prismark 预测 2024-2029 年中国大陆 18 层及以上 PCB 板、HDI 板、FPC 板的年均复合增长率分别为 21.1%、6.3%、4.5%，表现将优于行业整体（4.3%）。

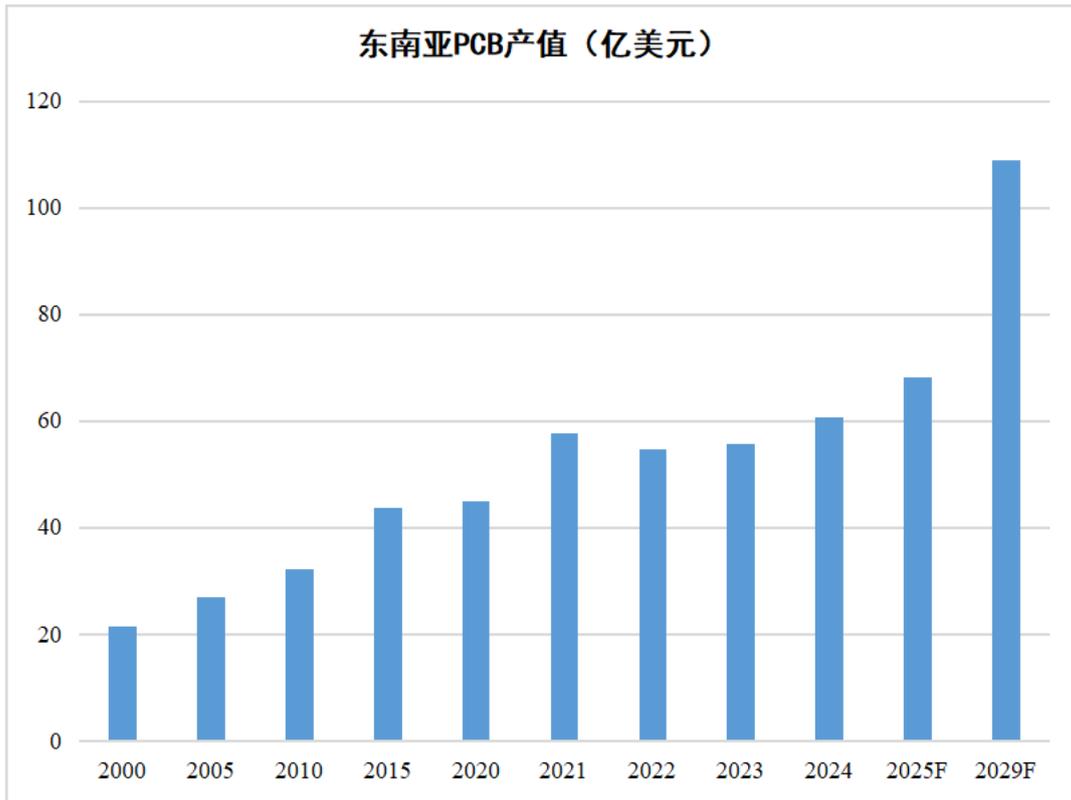


数据来源：Prismark

3、东南亚建厂成 PCB 行业新发展战略

自 2006 年开始，中国大陆成为全球最大 PCB 生产地区与全球 PCB 产业的核心区域。然而，随着全球经济一体化的深入发展、供应链多元化的需求以及国际局势变化的影响，“中国+N”的新模式逐渐成为 PCB 行业的新趋势，其中“N”代表东南亚等新兴市场。随着“中国+N”模式的持续发展，以越南、泰国、印尼为代表的东南亚国家成为本轮产业转移的最主要受益者，国内外 PCB 厂商普遍加大对东南亚的投资、产能扩张力度。根据 Prismark 报告，预计到 2025 年，2022 年全球排名前 100 位的 PCB 供应商中有超过四分之一的厂商可能在越南或泰国设有生产基地。

根据 Prismark 数据，2024 年东南亚地区 PCB 产值约为 60.81 亿美元，同比增长 8.4%，占全球 PCB 产值的 8.27%；预计到 2029 年，东南亚地区 PCB 产值将达到约 108.98 亿美元，产值占比提升到 12.4%，2024 年-2029 年年均复合增长率达到 12.4%，领跑全球其他地区及 PCB 行业整体。



数据来源：Prismark

近年来，随着东南亚地区物流及产业链配套、营商环境逐步完善，东南亚区域土地、人力、税收、运费等比较优势凸显，已从东亚区域承接了一部分消费电子、汽车等 PCB 下游行业产能；在下游行业转移的带动下，全球 PCB 产业也显现向东南亚转移的趋势，其中泰国、越南和马来西亚等地承接了较多的 PCB 产能转移。根据 Prismark 报告，东南亚地区在高多层板、HDI 板、封装基板领域将呈现强劲增长态势，PCB 产品主要应用在服务器、汽车电子、消费电子、通信等领域。

4、PCB 行业未来发展趋势

（1）高密度化、高性能化

作为电子信息产业重要的配套，印制电路板行业的技术发展与下游电子终端产品的需求息息相关。新一代的电子产品朝着轻薄短小、高速高频方向发展，下游的应用需求对 PCB 的精细度和稳定性都提出了更高的要求，要求 PCB 产品向高密度化、高性能化方向发展。

高密度化是未来印制电路板技术发展的重要方向，对电路板孔径大小、布线宽度、层数、叠孔结构等方面提出较高的要求。高密度互连技术（HDI）是 PCB

高密度化先进技术的体现，HDI 技术通过精确设置盲、埋孔的方式来减少通孔数量，节约 PCB 可布线面积，大幅度提高元器件密度，IC 封装基板的高密度化则相较 HDI 板更为显著。嵌入式技术或埋置元件技术是指将被动和主动器件内埋到 PCB 中，从而实现更高的电路密度和更小的产品尺寸，是实现电子产品高密度化的重要新技术之一。

高性能化主要是指 PCB 提高功能性如阻抗性、散热性等方面的性能，从而增强产品的功能及可靠性。现代电子产品由于其信息传送量大、信息传输速率快的特点，带动数字信号技术往高频化方向发展。只有具备良好阻抗性的 PCB 才能保障信息的有效传输，降低传输损耗，保证最终产品性能的稳定性，实现复杂功能。同时，高性能产品往往发热较多，需要具备良好的散热性能的 PCB 降低产品的温度，在此趋势下，金属基板、厚铜板等散热性能较好的 PCB 得到广泛应用，PCB 产品呈现向高性能化发展的特点。

（2）行业集中度提升

一方面，受到下游应用领域技术要求提高、终端产品更新换代加速的影响，PCB 厂商面临更高的技术要求、资金需求，技术实力强、品牌声誉良好的大规模厂商更具竞争优势；另一方面，近年来，全球范围内的供给过剩和价格侵蚀导致企业产能利用率不断下降、损失不断增加，许多中小规模 PCB 厂商无法度过行业低迷期从而加速出清，而大规模厂商能够更好地抵御价格侵蚀，反而通过行业整合获得了扩张的机会，行业集中度日益提升。根据 PrismaMark 数据，全球前五大 PCB 厂商的市场份额从 2006 年的 10.80% 已增长到 2024 年的 23.55%。

（3）行业生产趋于智能化

下游客户对 PCB 产品生产的精细化、个性化需求将促进 PCB 制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过“机器人”提高生产效率，提升加工精度，降低因人为误差造成的产品不良率。同时，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。

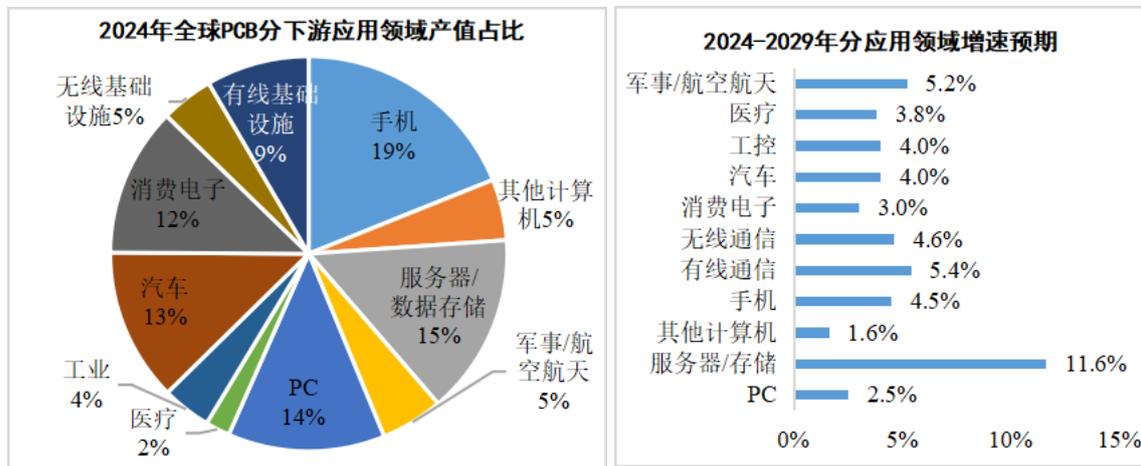
（4）生产重视绿色环保

PCB 行业生产工序众多、工艺复杂，且生产材料中包含铜、镍金、银等重金属，生产过程中会对环境产生污染，污染物处理过程比较复杂。随着各国环保

要求的日益严格，PCB 行业制定了一系列的环保规范，考虑到可持续发展的需要，PCB 行业寻求使用新型环保材料、提高环保工艺也将成为行业发展的主要趋势。

（四）发行人主要下游领域发展情况

PCB 市场下游应用分布广泛，主要涉及服务器/数据存储、计算机、汽车、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等领域。根据 PrismaMark 2024 年数据，手机占比最大，约为 18.9%；其次是服务器/数据存储，约为 14.8%；PC、汽车和消费电子占比分别为 12.8%、12.5%和 12.2%。预计 2024-2029 年增速最快的是服务器和存储相关 PCB，CAAGR 达到 11.6%，领跑其他 PCB 应用领域；其次为有线基础设施，CAAGR 达到 5.4%；汽车相关 PCB 的 CAAGR 达到 4.0%。



数据来源：PrismaMark

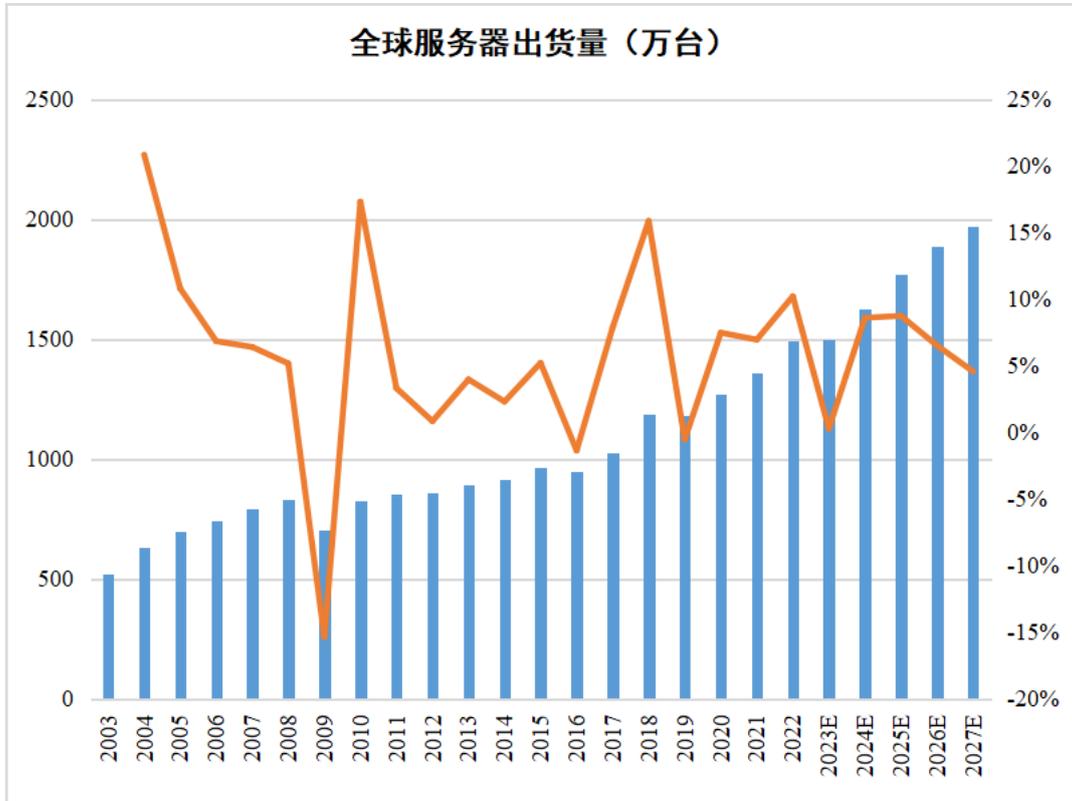
1、服务器领域

（1）服务器领域 PCB 增速领跑其他应用领域

PCB 在服务器中的应用主要包括加速板、主板、电源背板、硬盘背板、网卡、Riser 卡等，特点主要体现在高层数、高纵横比、高密度及高传输速率。随着服务器平台的升级，服务器 PCB 持续向更高层板发展，对技术和装备的升级提出要求。对应于 PCIe3.0 的 Purely 服务器平台一般使用 8-12 层的 PCB 主板；PCIe4.0 的 Whitley 平台则要求 12-16 层的 PCB 层数；对于未来将要使用 PCIe5.0 的 Eagle Stream 平台而言，PCB 层数需要达到 16-18 层以上。根据 PrismaMark 数据，18 层以上 PCB 单价约是 12-16 层价格的 3 倍。

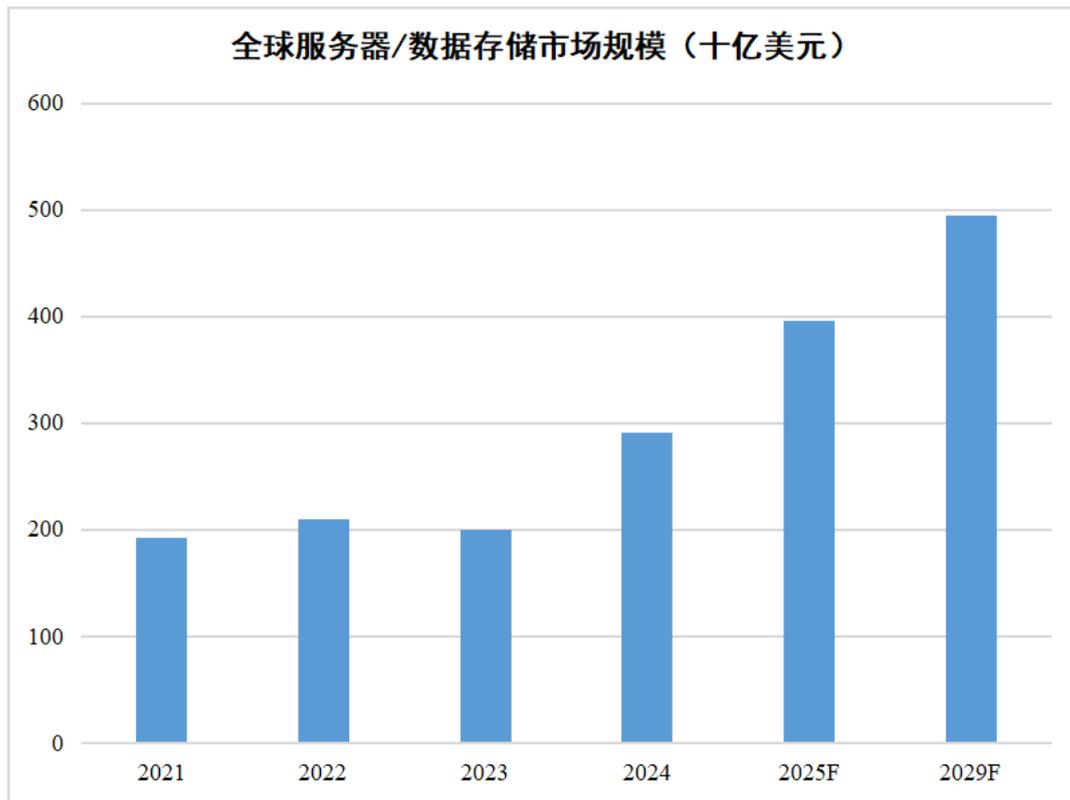
根据 IDC 数据，2022 年全球服务器出货量 1,495 万台，同比增长 10.4%；IDC

预计 2027 年全球服务器出货量将达到 1,971 万台，对应 2022-2027 年的年均复合增速为 5.7%。



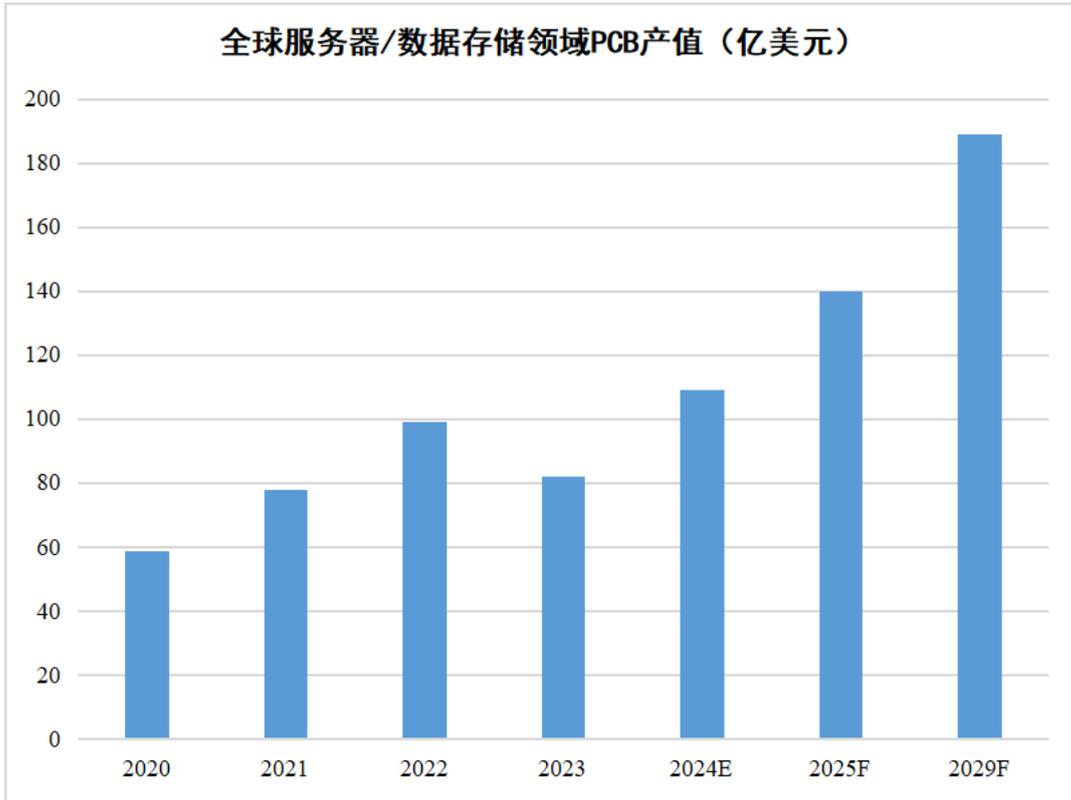
数据来源：IDC

根据 PrismaMark 数据，2024 年服务器/数据存储市场规模约为 2,910 亿美元，同比增长 45.5%，远超电子市场其他细分领域增速。由于新兴人工智能应用程序的巨大计算和存储需求，PrismaMark 预计服务器/数据存储市场将在未来五年内成为整个电子市场最强劲的增长驱动力，2025 年市场规模预计同比增长 36.1%，2024-2029 年市场规模年均复合增长率将高达 11.2%，领跑电子市场其他细分领域。



数据来源：Prismark

受益于人工智能、数据中心、高性能计算等技术的驱动，服务器市场的强劲需求将带动高多层板、高阶 HDI 等高端 PCB 产品市场的增长。根据 Prismark 数据，2024 年全球服务器/数据存储领域 PCB 市场规模为 109.16 亿美元，同比增长 33.1%，远超 PCB 其他应用领域增速；预计 2029 年全球服务器/数据存储领域 PCB 市场规模将达到 189.21 亿美元，2024 年-2029 年将以 11.6% 的复合增长领跑 PCB 其他应用领域。



数据来源：Prismark

(2) HDI 是 AI 服务器相关市场最大增量

AI 服务器为增长最快速的服务器/数据存储种类。根据 IDC 数据，2023 年全球 AI 服务器出货金额将达到 241 亿美元；2024 年将达到 280 亿美元，同比增长 16%。其中，高阶 AI 服务器出货量增速将达到 128%。其中，英伟达占据了 AI 服务器 GPU 主导地位，预计 2024 年将出货 690 万颗 GPU，增速达到 82%。

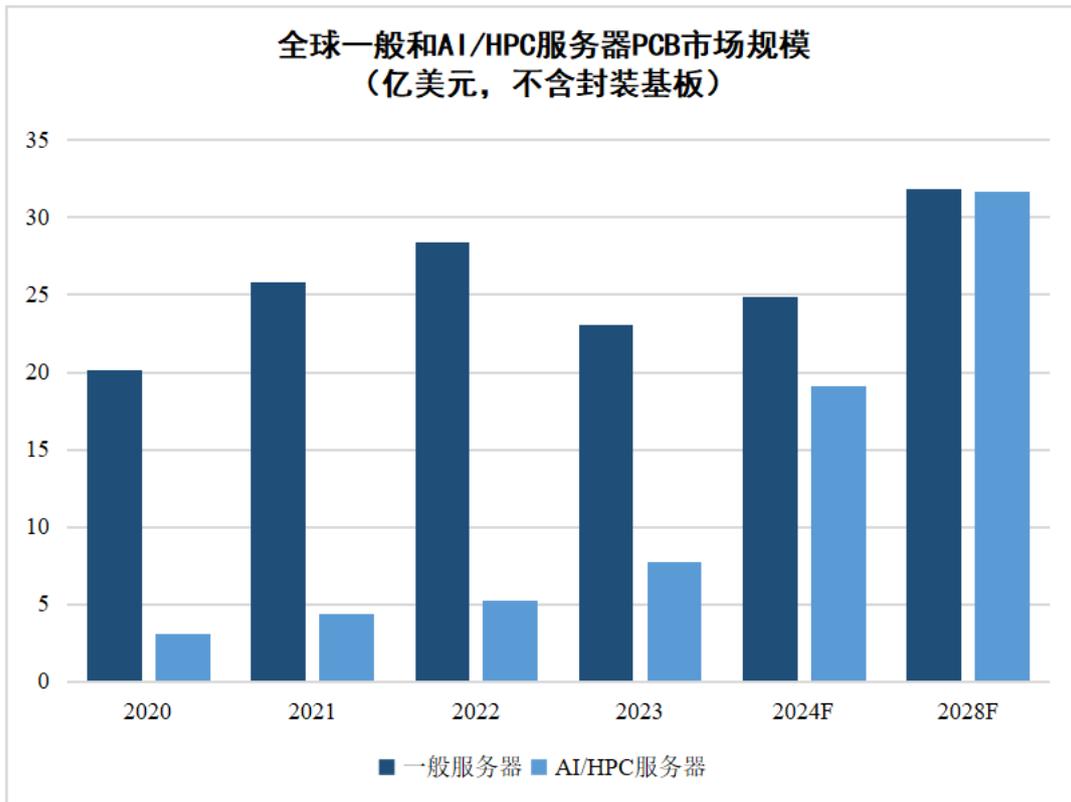


数据来源：Prismark



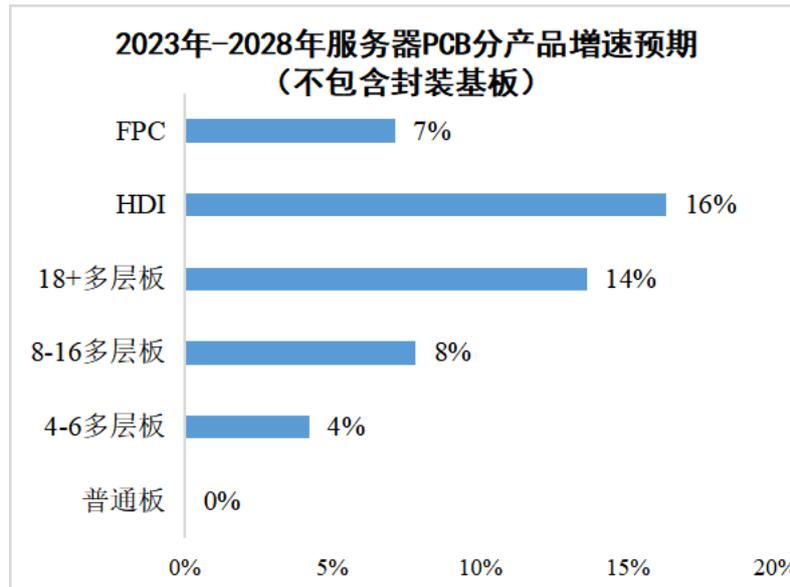
数据来源：IDC

未来五年 AI 系统、服务器等是 PCB 需求增长的主要动能。根据 Prismark 数据，2023 年全球 AI/HPC 服务器系统的 PCB 市场规模（不含封装基板）接近 8 亿美元，预计到 2024 年将达到 19 亿美元，同比增长接近 150%；到 2028 年，AI/HPC 服务器系统的 PCB 市场规模（不含封装基板）将追上一般服务器，达到 31.7 亿美元，2023-2028 年年均复合增速达到 32.5%，远超其他领域 PCB 市场规模增速。AI 服务器和 HPC 系统已成为推动低损耗高多层板和 HDI 板发展的重要驱动力。



数据来源：Prismark

AI 服务器主要涉及 3 类产品：GPU 的基板需要用到 20 层以上的高多层板；小型 AI 加速器模组通常使用 4-5 阶的 HDI 来达到高密度互联；传统 CPU 的 motherboard。并且，随着 AI 服务器升级，GPU 主板也将逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来 5 年 AI 服务器相关增速最快的 PCB，特别是 4 阶以上的高阶 HDI 产品需求增速快。Prismark 预测 2023-2028 年 AI 服务器相关 HDI 的年均复合增速将达到 16.3%，为 AI 服务器相关 PCB 市场增速最快的品类。

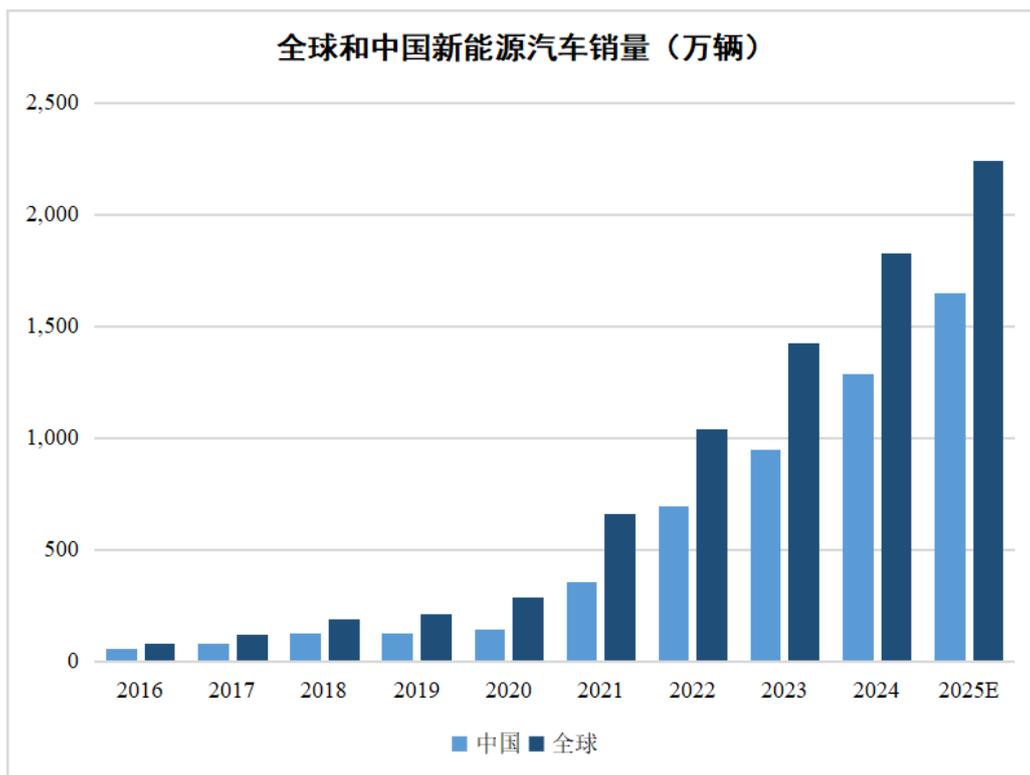


数据来源：Prismark

2、汽车电子领域

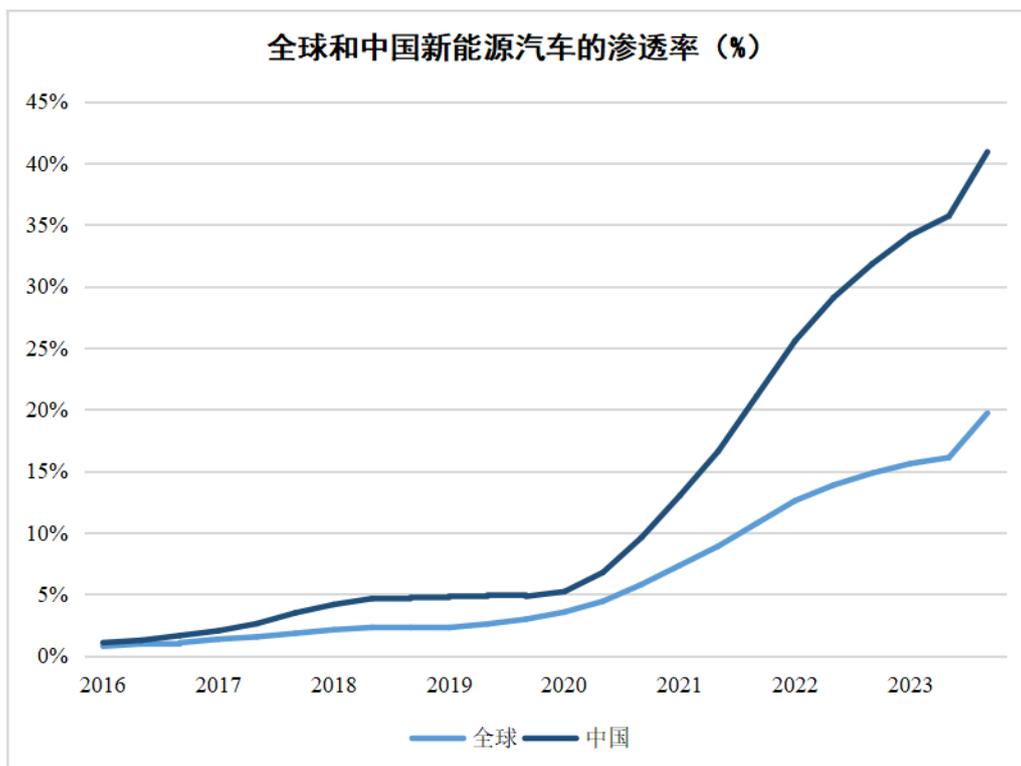
(1) 新能源汽车渗透率快速上升

根据中国汽车流通协会和 EVTank 的数据，全球新能源汽车的销量从 2016 年的约 77 万辆增加到了 2024 年的 1823.6 万辆，同比增长 24.4%。中国新能源汽车的销量从 2016 年的约 51 万辆增加到了 2024 年的 1286.6 万辆，连续十年位居全球第一，且年度销量首次突破 1000 万辆，全球占比超过了 70%，同比增速达到 35.5%。EVTank 预计 2025 年全球新能源汽车销量将达到 2,239.7 万辆，其中中国将达到 1649.7 万辆，2030 年全球新能源汽车销量有望达到 4405.0 万辆。



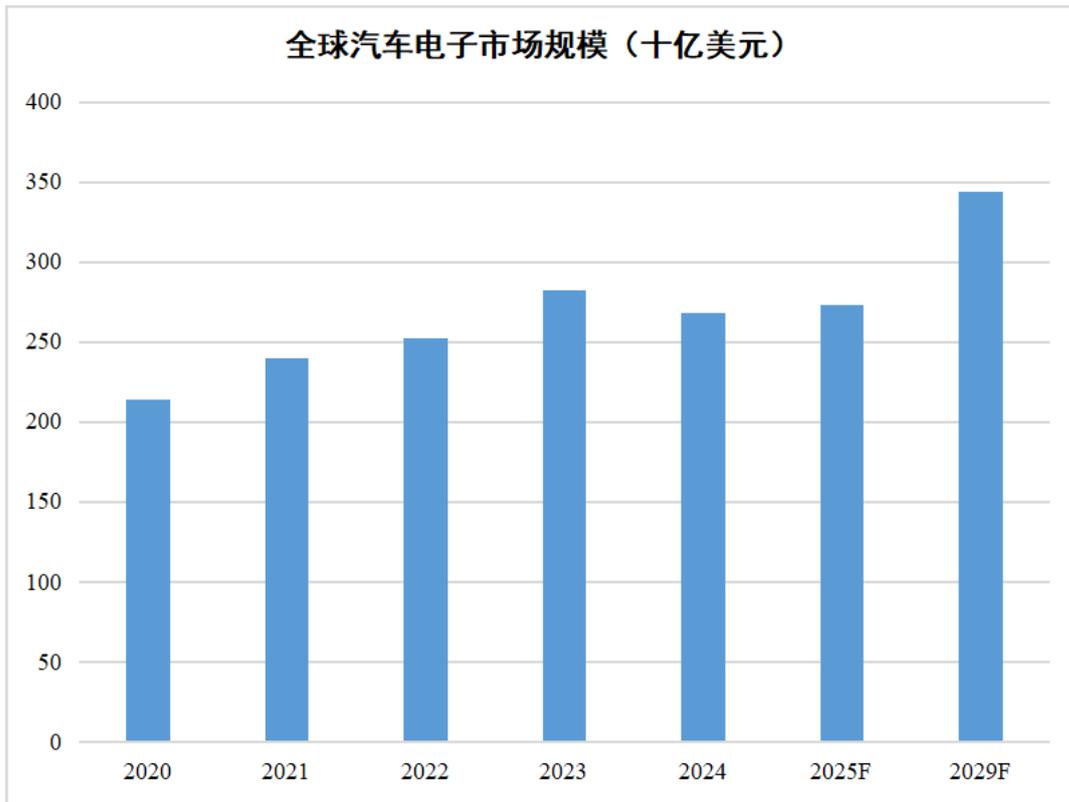
数据来源：中国汽车流通协会、EVTank

根据中国汽车流通协会和中国汽车工业协会的数据，新能源汽车的渗透率在2020年之后快速上升。2024年，全球和中国新能源汽车的渗透率分别达到20%左右和40.9%，海外渗透率还有较大提升空间。随着新能源汽车渗透率的提高，车用PCB的价值量将会被拉动。



数据来源：中国汽车流通会和中国汽车工业协会

在电动化、智能化趋势下，终端厂商不断升级电动车、智能座舱、自动驾驶等产品，汽车电子化和智能化水平进一步提高，市场规模快速增长。根据 PrismaMark 数据，2024 年全球汽车电子市场规模约为 2,680 亿美元，同比下降 5.0%；预计 2025 年将恢复增长，同比增长约 2.0%；预计到 2029 年将达到 3,440 亿美元，2024-2029 年年均复合增长率为 5.2%。从汽车电子占整车成本比重来看，预计到 2030 年将提升至 50%。



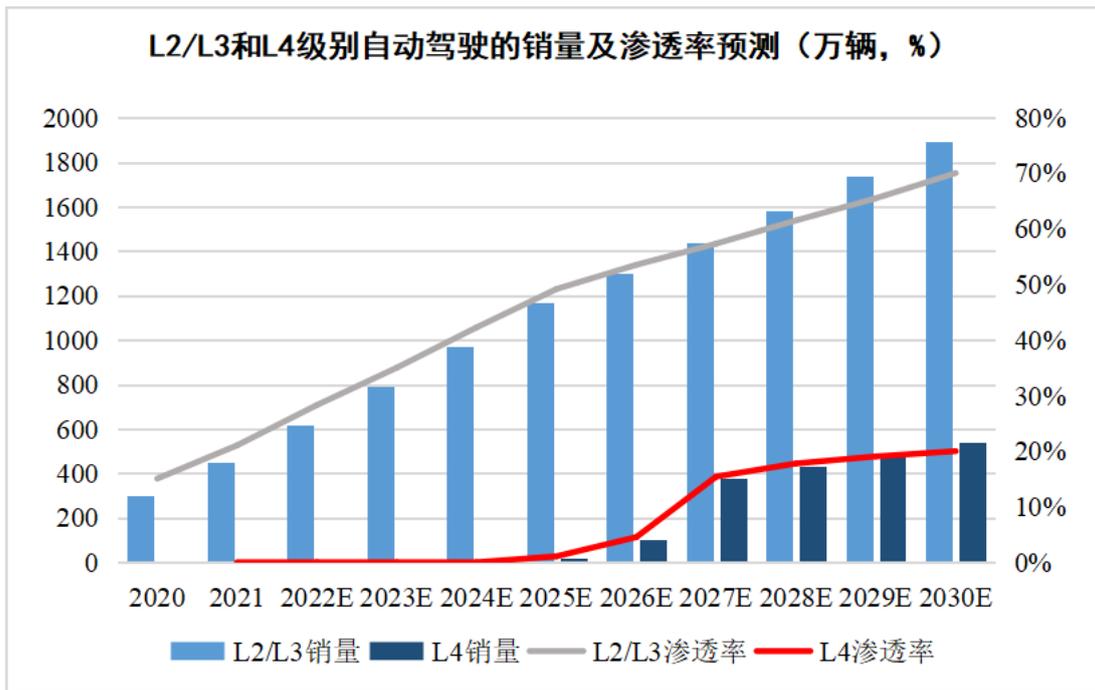
数据来源：PrismaMark

（2）汽车电子化及智能化驱动车用 PCB 价值翻倍增量

传统燃油汽车和新能源汽车的不同主要在于动力系统，传统燃油汽车使用的是发动机，而新能源汽车使用的是电动机。电动机中的电控系统主要是由三大动力控制系统组成的，分别是整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS），PCB 的价值增量主要来源于这三大动力控制系统，尤其是 BMS，架构复杂，需要使用大量 PCB，且对 PCB 的工艺要求很高，平均用量在 3-5 平方米左右，单体价值较高。总体来看，传统燃油汽车 PCB 使用量是 0.6-1 平方米/车，高端车型用量是 2-3 平方米/车，而新能源汽车则达到 5-8 平方米/车，根据佐思汽研数据，特斯拉 Model3 的 PCB 总价值量在 3,000-4,000 元之间，约

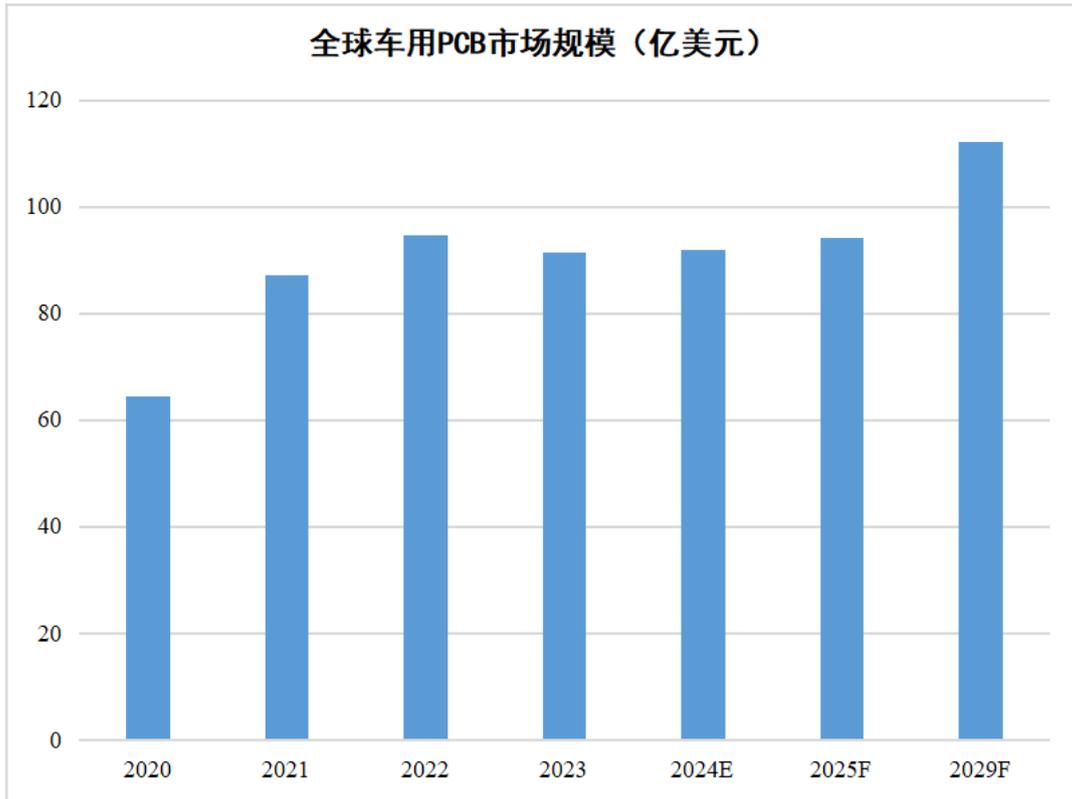
为普通燃油车的 5-6 倍。

我国乘用车自动驾驶等级正在由 L2 向 L3+ 过度。根据国际汽车工程师学会（SEA）的数据预测，中国 L2/L3 级别自动驾驶乘用车的渗透率将从 2020 年的 15% 到 2030 年的 70%；L4 级别乘用车方面，预计渗透率将从 2021 年的 0.01% 增长到 2030 年的 20%。随着 ADAS 等级提高，所需传感器增加，一方面将带动 PCB 使用面积增加，另一方面，智驾系统多采用 HDI 板，其中激光雷达的 HDI 价格可达数十美元。



数据来源：SEA

随着汽车电动化和智能化水平的不断提高，车用 PCB 价值量快速增长。根据 PrismaMark 数据，2024 年全球车用 PCB 市场规模为 91.95 亿美元，同比增长 0.5%；到 2029 年，全球车用 PCB 市场规模将增长到 112.05 亿美元，2024 年-2029 年将保持 4.0% 的复合增长。

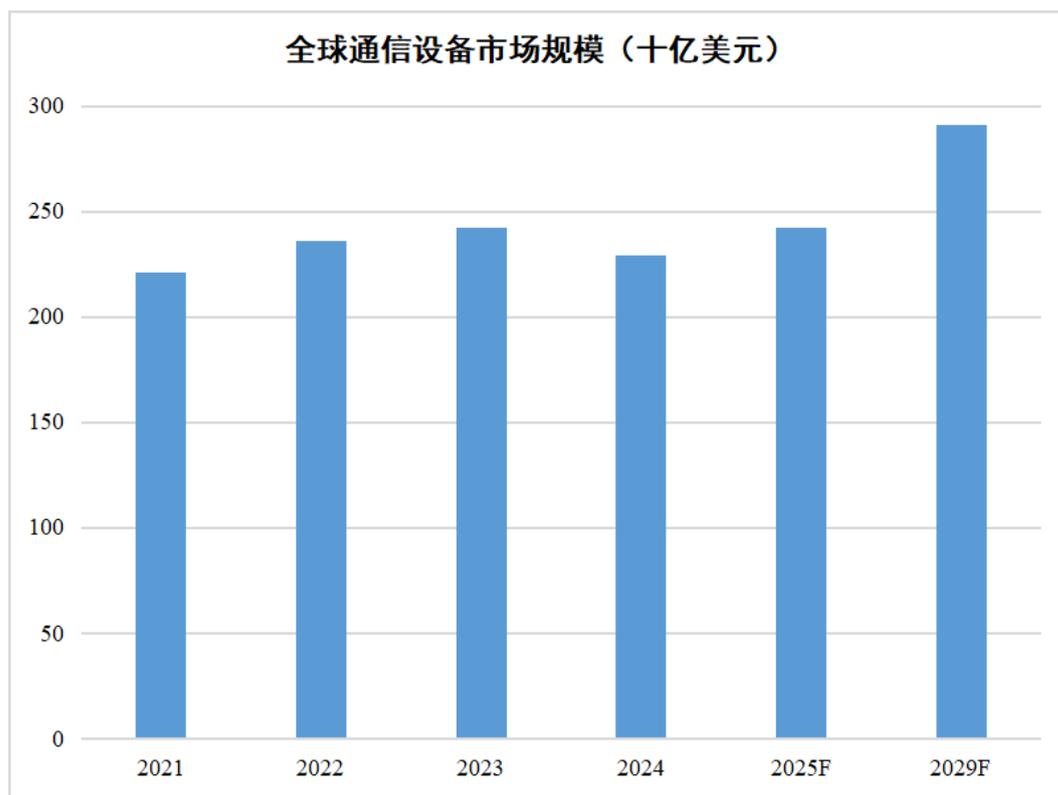


数据来源：Prismark

3、通信领域

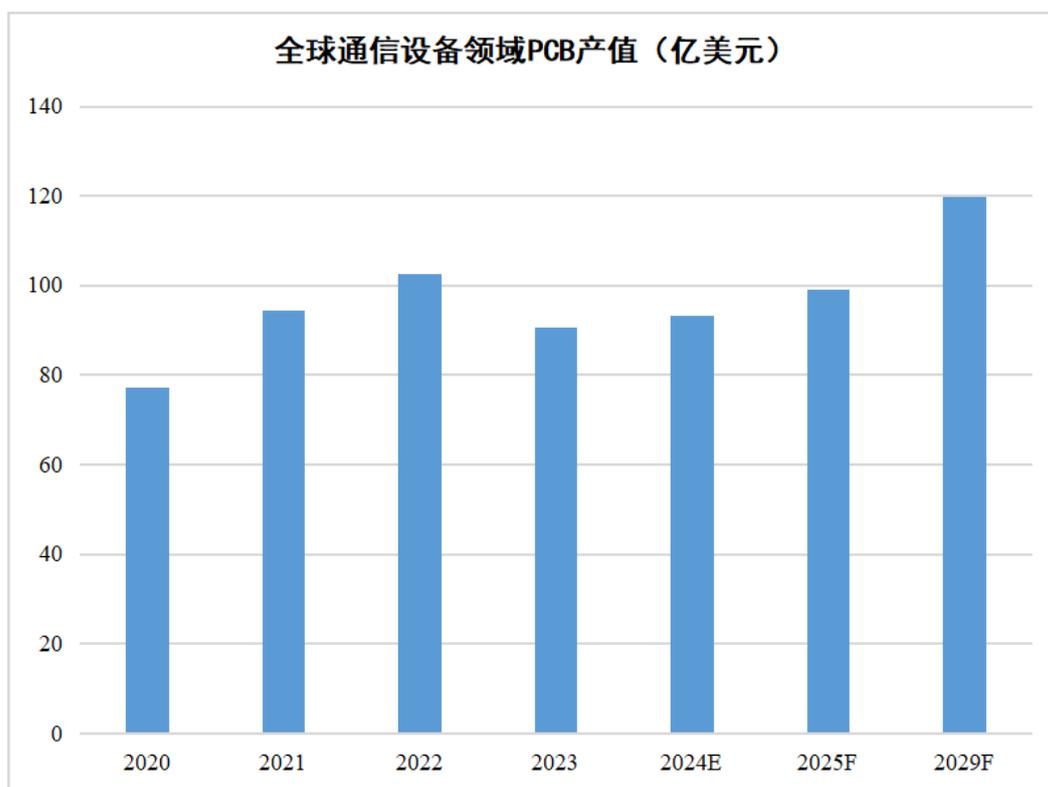
通信设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施，包括通信基站、路由器、交换机、基站天线、射频器件和骨干网传输设备等。目前通讯设备对PCB需求主要以多层板为主，5G通信设备对高频、高速PCB工艺和材料要求更高，电源方面需低功耗、高功率密度电源，同时数据传输量的提升需高速芯片搭配高多层板产品，有利于信号高速传输的高频高速板需求量将大幅上升。

根据Prismark数据，2024年全球通信设备市场规模达到约2,290亿美元，同比下降5.4%；预计2025年同比增长5.7%；预计到2029年将达到2,910亿美元，2024-2029年年均复合增长率为3.8%。



数据来源：Prismark

根据 Prismark 数据,2024 年全球通信设备领域 PCB 产值约为 93.30 亿美元,同比增加 2.8%;到 2029 年,全球通信设备领域 PCB 产值将达到 119.63 亿美元,2024 年-2029 年将保持 3.9%的复合增长。

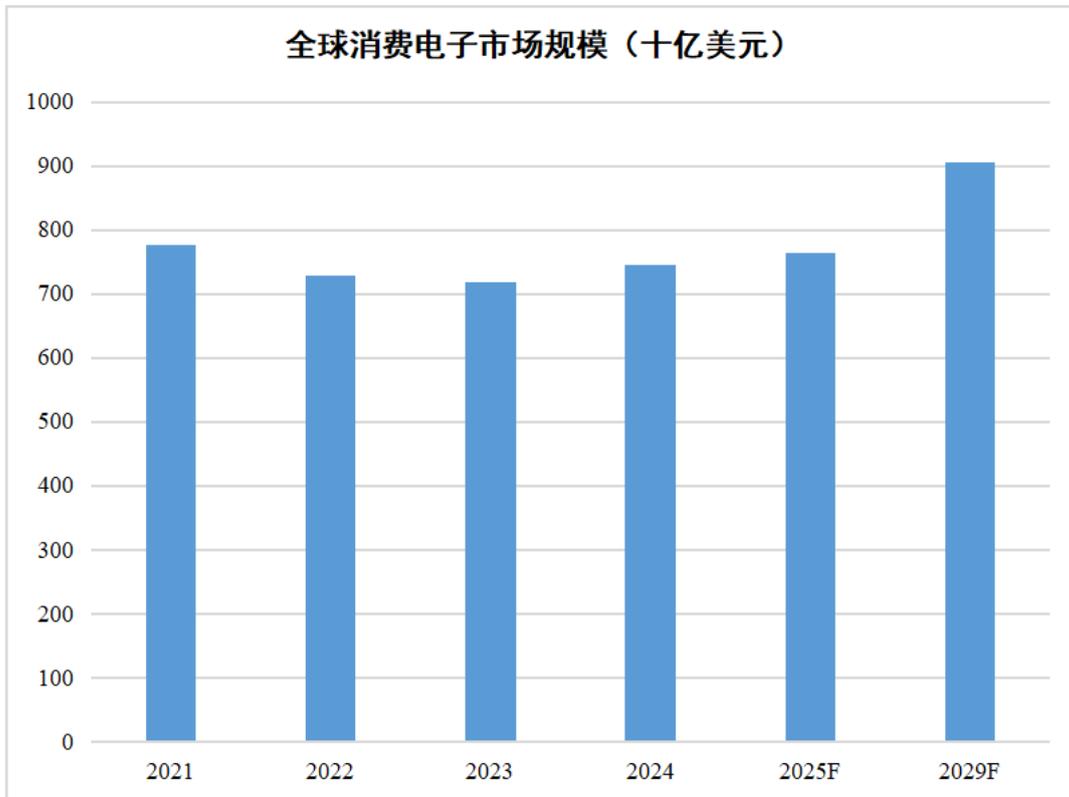


数据来源：Prismark

4、消费电子领域

消费电子是电子信息制造业中的重要类别，与广大人民的生活需求息息相关，包括手机、电脑、家电、家具、可穿戴设备等细分领域。消费电子用 PCB 产品通常具有大批量、轻薄化、小型化等特性，以单面板/双层板、四层板、六层板、HDI 板和 FPC 板为主。消费电子产品具有覆盖面广、下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点，每一次新的消费热点出现都将引领一轮消费电子产品迭代升级，拉动 PCB 行业的需求增长。

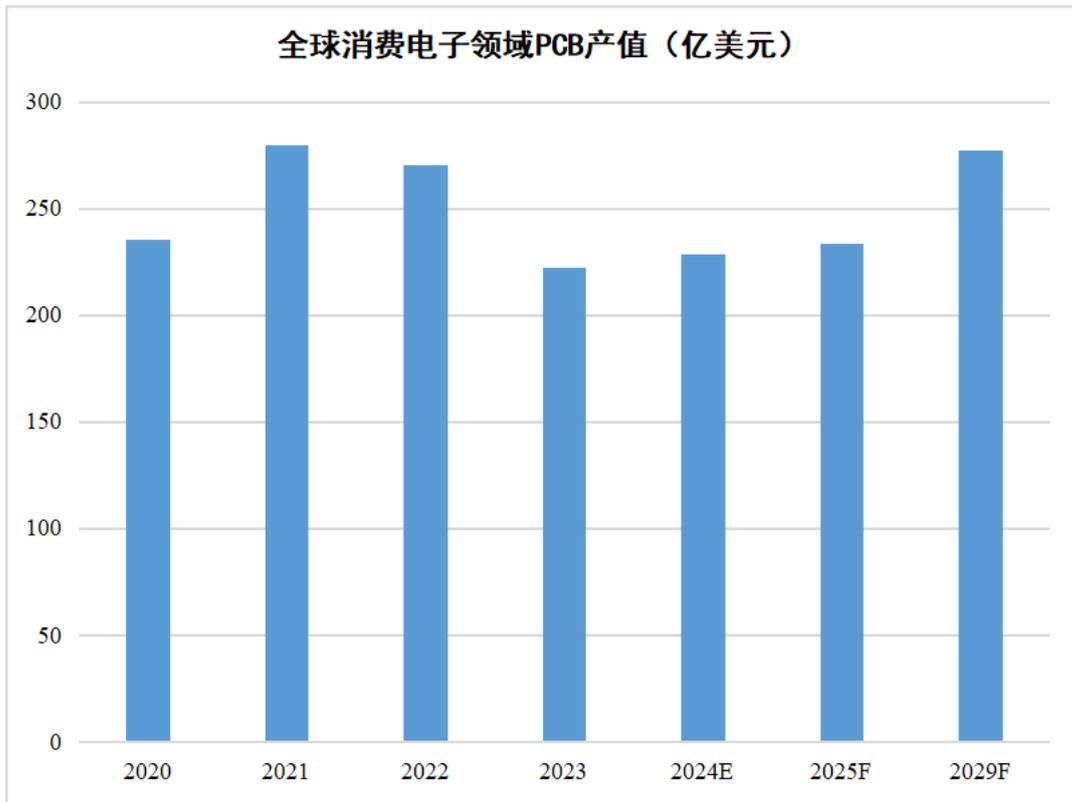
随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR、VR、可穿戴设备等消费热点频现，以 AI、IoT、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，消费电子产业具有广阔的市场前景。根据 Prismark 数据，2024 年全球消费市场规模约为 7,450 亿美元，同比增长 3.6%；到 2029 年将达到 9,050 亿美元，2024-2029 年年均复合增长率为 3.5%。从中长期来看，消费电子产业具有广阔的市场前景。



数据来源：Prismark

根据 Prismark 数据，2024 年全球消费电子领域 PCB 产值为 228.58 亿美元，同比增长 2.9%；到 2029 年，全球消费电子领域 PCB 产值将达到 277.06 亿美元，

2024 年-2029 年将保持 3.5%的复合增长。



数据来源：Prismark

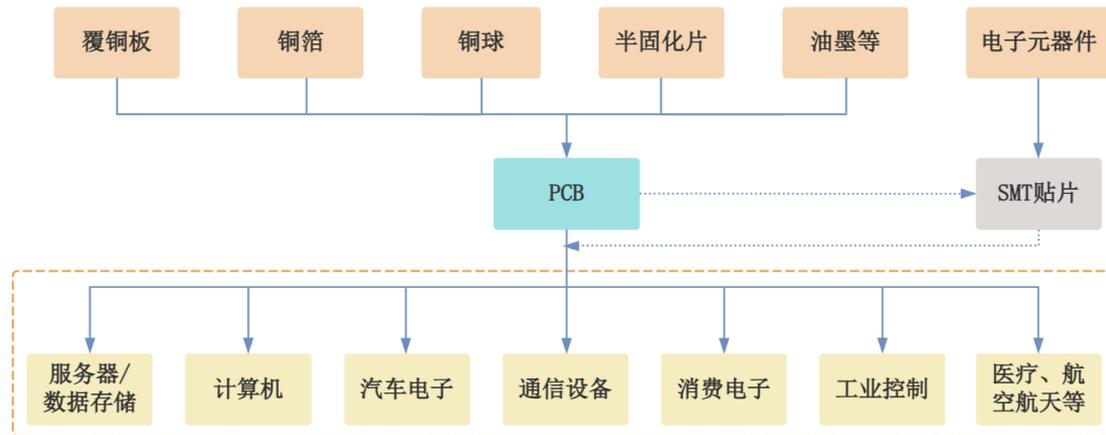
（五）行业利润变动情况

行业利润水平主要取决于上下游行业的变动情况。PCB 行业的上游产业包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨等，上游原材料价格水平决定 PCB 板的生产成本，覆铜板、铜箔等原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大；下游服务器/数据存储、通信、计算机、汽车、消费、医疗、工控等行业的波动决定 PCB 板的需求和价格水平。目前，PCB 原材料供应充足、竞争充分，受益于 AI、5G、新能源汽车、智能驾驶、AR/VR 等下游行业和技术驱动，PCB 行业的整体景气度较高。

（六）所处行业与上下游行业之间的关联性

印制电路板产业链上游主要包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨等原材料的生产及供应商。下游为各类电子产品的生产商，包括服务器/数据存储、计算机、汽车电子、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等领域。

PCB 行业与上下游行业之间的关系如下图所示：



1、与上游行业的关联性

PCB 企业的生产成本直接受到上游原材料价格波动的影响。生产印制电路板所需的原材料主要为覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨等。此外，为满足下游领先品牌客户的采购需求，许多 PCB 生产企业尤其是软板生产企业还需要采购电子元器件与 PCB 产品进行贴装后销售。目前 PCB 的上游配套产业发展成熟，供应充足、竞争充分，相应配套服务能够满足 PCB 行业的发展需求。

覆铜板被称为基材，系由木浆纸、玻璃纤维布等增强材料浸以树脂，单面或双面覆以铜箔经热压而成的一种产品。作为生产 PCB 的核心原材料，覆铜板与 PCB 的品质、性能关系密切，其供应水平和生产技术对 PCB 的制造有显著的影响，占 PCB 生产成本的比例较大；在覆铜板的原材料中，铜箔占其原材料成本的 30%-50%。除覆铜板以外，铜箔、铜球等铜制品也是生产 PCB 的重要材料，因此，铜价对 PCB 原材料价格的影响较大，铜价的走高会提高企业的生产成本，PCB 制造企业较为关注铜价的变化。

2、与下游行业的关联性

PCB 的下游应用领域较为广泛，近年来，下游行业更趋多元化，产品应用覆盖服务器/数据存储、计算机、汽车、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等各个领域。PCB 行业与下游行业的发展相互关联、相互促进。一方面，PCB 下游行业良好的发展势头为 PCB 产业的成长奠定了基础；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游行业产品的推陈出新提供了可能性，从而进一步满足终端市场需求，同时下游行业产品的更新换代及科技进步引致的新品问世也为 PCB 产品需求提供了强有力的支撑。

近年来，随着全球科学技术飞速发展，人工智能、新能源汽车、智能驾驶、

5G 通信等新的科技热点不断涌现，带动全球电子信息产业持续增长，从而促进了 PCB 行业的发展。未来 PCB 产品应用领域还将进一步扩大，市场空间广阔。

（七）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

PCB 行业的周期性受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展，PCB 行业下游应用领域越来越广泛，涉及服务器/数据存储、计算机、汽车、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等众多领域，产品覆盖面变广，行业波动风险降低。总体而言，PCB 行业受单个行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况对本行业的影响较大。

2、区域性

全球 PCB 产值主要集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国和欧洲等国家或地区，近年来，在下游产业向东南亚转移的带动下，东南亚投资布局成为 PCB 行业的新发展趋势。全球排名前列的 PCB 厂商基本均在东南亚投资布局，以泰国、越南等为代表的东盟国家的 PCB 产业集群逐渐形成。

国内 PCB 厂商主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区，其中以珠三角地区最为集中。随着沿海地区劳动成本的上升，部分 PCB 企业开始将生产基地从沿海转移到内陆地区。并且，受下游行业向东南亚转移趋势的影响，一些内资 PCB 企业也陆续开展东南亚投资布局。

3、季节性

PCB 行业下游电子产品需求受节假日及消费习惯的影响呈现出一定的季节性，一般上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。通常，PCB 行业的生产旺季早于下游产品的销售旺季。

（八）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的持续大力支持

PCB 行业作为电子信息产业中重要的组成部分，受到国家产业政策的大力支持。近年来，国家相关部门制定了一系列鼓励、促进 PCB 行业发展的政策和法规，如 2023 年，发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将新型电子元器件制造（高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电

路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板等）、新型电子元器件（高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板等）列入信息产业行业鼓励类项目中。具体内容参见本节之“二、（二）产业政策”。一系列鼓励 PCB 产业发展的积极政策，将引导 PCB 产业步入持续健康发展的轨道。

（2）完整的产业链和产业集群

中国电子信息产业链日趋完善、规模大、配套能力强、产业集聚效应明显。PCB 行业是关键的电子信息基础产业，在产业链中起着承上启下的关键作用，完整的产业链使 PCB 企业既能快速采购原材料，又能快速响应客户需求，使企业在良性发展轨道上稳定前进。同时，珠三角和长三角等地均具有完善和优质的电子产业集群，企业可获得区位优势。

（3）PCB 下游应用领域升级带动

PCB 下游应用领域广泛，包括服务器/数据存储、计算机、汽车、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等。广泛的应用分布为 PCB 行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。近年来，AI、5G 通信、HPC 系统、新能源汽车、智能驾驶、AR/VR、智能制造等新技术和新产品的不断涌现推动了对 PCB 产品尤其是高多层板、HDI 板、封装基板等高端 PCB 产品的大规模需求。PCB 应用行业的技术革新及新兴产业的发展为 PCB 行业带来了广阔的市场空间，为 PCB 市场发展提供了重要支撑。

（4）智能制造技术升级

PCB 生产涉及的工业制程复杂、工序繁多、技术要求严格，工业自动化的迅速发展，使得生产制程自动化水平越来越高，可以有效提高生产效率和产品良率，并同时降低人工成本，提高公司盈利能力。叠加 5G、大数据、云计算、物联网、智能驾驶、工业 4.0 等方面的应用，智能制造逐步落地，PCB 厂商也将得益于这轮技术进步的红利，实现整个行业的跨越式发展。

2、不利因素

（1）市场竞争加剧

PCB 行业作为电子元器件的基础行业，在全球主要经济体经济增长率放缓的背景下，PCB 行业产值整体增长速度放缓，加剧了 PCB 厂商的竞争程度。同时，越来越多的 PCB 生产企业通过资本市场募集资金来扩大生产规模，提高市

市场份额。随着国内外 PCB 厂商陆续布局产能扩张项目，市场竞争日趋激烈，行业集中度日益提升，部分落后的中小企业将逐步退出市场，产能优势将集中到头部企业。

（2）劳动力和环保成本上涨

随着人口老龄化的加剧、经济发展和人民生活水平的提高，我国劳动力成本不断上升。部分 PCB 企业开始将生产基地从沿海转移到内陆地区，并通过技术改造、提升生产自动化和智能化水平、优化生产流程等措施，以缓解劳动力成本上升带来的成本压力。

当前政府主管部门对企业安全生产和环境保护的要求不断提升，环保监管强度不断加大，一方面能推动 PCB 行业向规范化、绿色化方向发展，促进技术升级和产业转型，另一方面也会加大 PCB 企业的环保设备投入和环保运行支出，给企业带来一定的成本压力。

（九）行业竞争格局

1、全球 PCB 行业竞争格局

全球 PCB 生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。据 PrismaMark 数据，全球有超过 2,200 家 PCB 生产企业，主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国和欧美等国家或地区。其中，中国大陆 PCB 产值增速较快，目前中国大陆是全球 PCB 行业产值最大的区域，产值占比超过 50%。根据 PrismaMark2024 年 Q4 排行榜，全球前 20 大 PCB 厂商中，中国大陆企业有 5 家，中国台湾企业有 7 家，日本和韩国企业各有 3 家。虽然目前 PCB 行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显，但是在未来一段时间内，行业仍将保持较为分散的竞争格局。

PrismaMark 统计的 2024 年 Q4 全球前 20 大 PCB 厂商总部所在国家和地区情况如下：

国家或地区	数量
中国大陆	5
中国台湾	7
日本	3
韩国	3
美国	1
奥地利	1

数据来源：PrismaMark

2、国内 PCB 行业竞争格局

我国 PCB 行业经过多年的发展，目前呈现“百家争鸣”的局面，有上千家 PCB 生产企业，形成了中国台资、中国港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局，市场竞争较充分。根据中国电子电路行业协会（CPCA）发布的中国电子电路行业排行榜，2024 年中国综合 PCB 企业排名如下：

排名	公司名称	营业收入 (亿元)	基本情况
1	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	351.40	中国台资控股厂商，臻鼎的控股子公司，A 股上市公司（002938.SZ），主营产品为 FPC、HDI、刚性板等，其大陆生产基地分布在深圳、淮安、秦皇岛和营口
2	苏州东山精密制造股份有限公司 ^注	248.01	内资厂商，A 股上市公司（002384.SZ），主营产品为 FPC、刚性板、刚挠结合板等，其大陆生产基地分布在苏州、盐城和珠海
3	深南电路股份有限公司	179.07	内资厂商，A 股上市公司（002916.SZ），主营背板、高速多层板、高频微波板等中高端 PCB 产品，其大陆生产基地分布在深圳、无锡、南通
4	沪士电子股份有限公司 ^注	133.42	非内资厂商，A 股上市公司（002463.SZ），主营单双面板、多层及 HDI 板，其大陆生产基地主要分布在昆山、黄石等地
5	健鼎科技股份有限公司	129.42	中国台资控股厂商，中国台湾上市公司（3044.TW），其大陆生产基地分布在无锡、仙桃
6	深圳市景旺电子股份有限公司	126.59	内资厂商，A 股上市公司（603228.SH），主营产品为刚性板、FPC、金属基板，其大陆生产基地分布在深圳、龙川、江西和珠海
7	华通电脑股份有限公司	123.27	中国台资控股厂商，中国台湾上市公司（2313.TW），其大陆生产基地分布在重庆、苏州、惠州
8	建滔集团有限公司	110.40	中国港资控股厂商，港股上市公司（00148.HK），主营单双面板、多层及 HDI 板
9	胜宏科技（惠州）股份有限公司	107.31	内资厂商，A 股上市公司（300476.SZ），主营多层板、HDI 板、FPC 软板，生产基地分布在惠州、长沙、益阳、马来西亚、泰国等地。
10	欣兴电子股份有限公司	101.06	中国台资控股厂商，中国台湾上市公司（3037.TW），其大陆生产基地分布在苏州、昆山和深圳

注：东山精密 2024 年营业收入只统计电子电路产品营业收入。沪电股份实际控制人吴礼淦家族为中国台湾、中国香港、美国、新西兰等地居民，沪电股份在 CPCA 排名中没有被认定为内资企业。

数据来源：CPCA、上市公司年报。

3、同行业上市公司情况

PCB 生产企业众多，各公司在技术层级、产能规模、应用领域上存在一定差别，在各自细分市场具有竞争优势。国内同行业上市公司主要概况如下：

单位：亿元

证券简称	注册地	上市日期	主营业务情况	2024 年经营情况	
				营业收入	净利润
深南电路	深圳市	2017-12-13	PCB 的研发、生产和销售，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务。 2024 年 CPCA 中国综合 PCB 企业排名第 3 名。	179.07	18.78
景旺电子	深圳市	2017-01-06	PCB 的研发、生产和销售，主营产品为双面及多层刚性板、挠性板、金属基板等。 2024 年 CPCA 中国综合 PCB 企业排名第 6 名。	126.59	11.69
沪电股份	昆山市	2010-08-18	PCB 的研发、生产和销售，主导产品为企业通讯市场板、汽车板、办公及工业设备板、消费电子板等。 2024 年 CPCA 中国综合 PCB 企业排名第 4 名。	133.42	25.87
鹏鼎控股	深圳市	2018-09-18	PCB 的研发、生产和销售，主导产品为通讯用板、消费电子用板、汽车\服务器及其他用板等。 2024 年 CPCA 中国综合 PCB 企业排名第 1 名。	351.40	36.20
东山精密	苏州市	2010-04-09	主要从事电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件等的研发、生产和销售。电子电路产品主要为 FPC 软板、刚性电路板。 2024 年 CPCA 中国综合 PCB 企业排名第 2 名。	367.70	10.86

数据来源：wind、CPCA、上市公司年报。

（十）公司的行业地位

公司深耕 PCB 行业近二十年，凭借深厚的技术积淀与丰富的行业经验，连续多年位居“全球 PCB 百强榜”和“中国 PCB 百强榜”前列。根据 PrismaMark2024 年 Q4 排行榜，公司位列全球 PCB 厂商第 13 名，内资 PCB 企业第 4 名；根据中国印制电路行业协会（CPCA）2024 年排行榜，公司位列中国综合 PCB 企业第 9

名，并入选 2024 广东省制造业企业 500 强（第 69 名）及广东企业 500 强（第 276 名）。公司在高密度多层 VGA（显卡）PCB 和 HDI 小间距 LED PCB 市场份额全球第一，其中高密度多层 VGA PCB 荣获广东省制造业单项冠军。作为 CPCA 副理事长单位及行业标准制定单位之一，公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，并拥有省、市、区三级工程技术研发中心及省、市级企业技术中心，科研实力雄厚。

公司凭借先进的生产技术和优异的产品性能，在行业中树立了良好的品牌形象，获得了核心战略客户的认可，在新能源、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机等下游领域积累了一大批稳定合作的优质客户。公司已与富士康、技嘉、海康威视、海信、戴尔、华硕、TCL、德赛西威、小米、联想、歌尔股份等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、Continental、诺和诺德、微软、博世、台达等众多国际知名品牌，长期稳定的优质客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定了坚实的基础。

公司旗下 MFS 集团经过 30 多年的行业积累，在 PCB 领域拥有自主研发的多项关键核心技术，已成为行业内能够规模化供应质量稳定、性能优良的 FPC 产品的生产厂商之一，凭借优良的产品品质和服务质量，与许多国际知名客户建立长期合作关系。根据 CPCA 颁布的《第二十二届（2023）中国电子电路行业主要企业营收榜单》，维胜科技在综合 PCB 企业中排名第 38 名，在以 FPC 软板为主的综合 PCB 企业中排名第 4 名。

（十一）公司竞争优势及劣势

1、公司竞争优势

（1）产品优势

公司产品结构多元，产品覆盖刚性电路板（多层板和 HDI 为核心）、柔性电路板（单/双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，产品优势明显。公司在高密度多层 VGA（显卡）PCB 和 HDI 小间距 LED PCB 市场份额全球第一，其中高密度多层 VGA PCB 荣获广东省制造业单项冠军。公司产品广泛应用于新能源、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域，获得众多知名客户或终端品牌的认可。公司

及时根据市场需求调整客户结构和产品结构，大力拓展新能源、新能源汽车、AI 算力、高端服务器、光传输、基站通讯、元宇宙类产品，进一步提升高端产品在公司的份额及市场占有率。

（2）技术研发优势

公司是 CPCA 的副理事长单位，系行业标准的制定单位之一，具备丰富的行业经验和深厚的技术积累，科研实力雄厚。公司先后被评为“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省自主创新标杆企业”、“第五届中国电子电路行业优秀企业”，荣获第二十届至第二十三届中国专利优秀奖；累计获评广东省高新技术产品 42 个，其中名优高新技术产品 13 项；获得市级科技成果登记 7 项。2023 年公司入选首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌名单，荣获 2023 年广东省省级制造业单项冠军，“胜宏科技”文字商标入选 2023 年广东省重点商标保护名录。

公司依托省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心等研发平台，自上市以来，围绕 PCB 核心技术累计投入研发近 20 亿元，拥有线路板领域有效专利超 370 项，研发团队人员超 1300 名，建立了以基础材料为起点，到工艺、设备的全产业链技术能力。

公司在算力和 AI 服务器领域取得重大突破，如基于 AI 服务器加速模块的多阶 HDI 及高多层产品，24 层 6 阶 HDI 产品和 32 层高多层板已实现大批量出货，并具备 70 层高精密多层线路板、28 层 8 阶高密度互连 HDI 板的量产能力；在工业控制和医疗领域，公司具备 12 层高精密板软硬结合板 Rigid-Flex、10 层高精密 FPC/FPCA（线宽 25um）的量产及批量出货能力；在消费电子领域，公司具备 14 层高精密 HDI 任意阶互联板的量产及批量出货能力。公司将继续加大对高端人工智能、车载电子、工业机器人、高阶数据传输等领域产品的布局研发。

（3）客户优势

公司工艺技术水平先进，产品质量优良，深受国内外下游行业客户的青睐。公司客户遍及发展迅速的下游细分朝阳行业，已与富士康、技嘉、海康威视、海信、戴尔、华硕、TCL、德赛西威、小米、联想、歌尔股份等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、Continental、诺和诺德、微软、博世、台达等众多国际知名品牌。上述客户均在其行业内具有

重要的影响力，市场竞争优势明显，主要产品位居市场领先地位。

（4）快速响应客户需求优势

公司在惠州、长沙、益阳、马来西亚、泰国等地建立了多个生产服务基地，给客户多个供货地的选择，并可以保护客户免受供应链中断或地缘政治风险的影响。随着公司业务的快速增长，为提升客户服务质量，公司分别在美国、新加坡、泰国、越南、日本、中国台湾、欧洲、马来西亚、韩国等国家或地区设立子公司和办事处，并配备专业技术服务团队，为国际客户提供全球化销售服务和技术支持，与客户保持紧密联系，快速响应客户需求。

公司具备雄厚的产品设计和技术研发实力，紧密围绕客户进行技术创新与产品布局，在具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划中全过程跟踪服务客户，能更快、更好地响应客户的产品设计和技术研发需求。

（5）质量优势

在产品质量控制方面，公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，在采购、生产、销售各环节均进行严格的质量控制，积累了丰富的产品质量控制经验。一方面，公司通过了 CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001、AS9100、ISO22301 等多项质量体系认证；另一方面，公司在本行业领域率先实现突破，成为同行业第一家建成新一代工业互联网智慧工厂的企业，大大提高自动化生产水平，进一步提升了产品的品质和良率。公司智慧工厂、先进的生产工艺、严格的制度管理以及丰富的管理经验，使公司产品质量保持稳定并持续提高，在业内具有较高的知名度和美誉度，市场占有率稳步提升。

2、公司竞争劣势

经过多年的努力经营，公司凭借高技术、高品质和高质量的服务在市场中已逐步树立了良好的品质形象，公司近年的销售额虽然处于国内 PCB 企业的前列，具备了较强的市场竞争力，但是在研发投入、产能扩大、业务扩张等各方面的资金投入均较高，公司资金已无法满足下游新能源、汽车电子（新能源）、计算机、人工智能、新一代通信技术、消费电子等国家战略新兴产业蓬勃发展的需求，成为公司进一步发展的瓶颈。通过与国际竞争对手经营情况的对比，从长期竞争来看，公司的资本规模仍较小。因此，公司亟需进一步提升资金实力，提升自身竞争力。

三、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主营业务情况

公司专业从事高精密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品覆盖刚性电路板（高端多层板和 HDI 板为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。

公司工艺技术水平先进，产品质量优良，深受国内外下游行业客户的青睐。公司客户遍及发展迅速的下游细分朝阳行业，已与富士康、技嘉、海康威视、海信、戴尔、华硕、TCL、德赛西威、小米、联想、歌尔股份等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、Continental、诺和诺德、微软、博世、台达等众多国际知名品牌，长期稳定的优质客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定了坚实的基础。

公司深耕 PCB 行业近二十年，凭借深厚的技术积淀与丰富的行业经验，连续多年位居“全球 PCB 百强榜”和“中国 PCB 百强榜”前列。根据 PrismaMark2024 年 Q4 排行榜，公司位列全球 PCB 厂商第 13 名，内资 PCB 企业第 4 名；根据中国印制电路行业协会（CPCA）2024 年排行榜，公司位列中国综合 PCB 企业第 9 名，并入选 2024 广东省制造业企业 500 强（第 69 名）及广东企业 500 强（第 276 名）。公司在高密度多层 VGA（显卡）PCB 和 HDI 小间距 LED PCB 市场份额全球第一，其中高密度多层 VGA PCB 荣获广东省制造业单项冠军。作为 CPCA 副理事长单位及行业标准制定单位之一，公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，并拥有省、市、区三级工程技术研发中心及省、市级企业技术中心，科研实力雄厚。

（二）主要经营模式

公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式、销售模式。影响公司经营模式的主要因素包括下游客户的需求、上游供应商的服务模式和服务能力、市场竞争情况及国家法律法规政策等因素。报告期内，影响公司主要经营模式的因素未出现重大不利变化。

1、采购模式

公司采购管理中心负责公司主要原材料、辅助原材料和设备等采购事宜，主要职能包括供应商管理体系搭建、采购流程及制度制定、采购过程管理及成本控制，识别采购风险源，进行全面风险管理。采购管理中心运用 ERP、SRM 系统，构建公开、透明的采购平台。采购团队根据供应链市场的实时变化，结合客户产品需求，制定科学合理且灵活高效的多层次采购控制计划；通过深度分析行业供应链的竞争力影响因素，不断加强自身采购竞争力，努力打造企业长期采购优势，以确保公司成本和供应稳定，助力提升公司经济效率。

2、生产模式

由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，尤其是某些大客户的产品类别较多，基于这一特点和公司各生产线的技术优势，公司将生产单位划分成多层板事业部一至六处和 HDI 板事业部，不同处别均有不同的产品领域定位，且因各处皆位于同一园区，可相互支援，园区内不同的产品线可全方位满足各种订单的生产需求，大大缩短了客户前期引入及认证的时间，顺应公司发展战略。当收到客户订单后，各职能部门依托内部完善的 ERP 和 MES 系统，快速高效地拟定排产计划，准备所需物料、工具、设备，做好人员部署，以待生产，高效率、高质量地满足客户需求。

3、销售模式

公司采用 4S 销售模式（Sales、CS、QS、TS），以满足客户对技术和品质的高标准需求。为了更好地服务全球客户，特别是国际大客户，公司通过 4S 团队的多维度、全方位服务，从客户审核、NPI 项目导入到量产后的品质保障，公司在激烈的市场竞争中赢得高质量订单。同时，公司顺应全球供应链区域化、周边化和本地化趋势，在美国、新加坡、日本、中国台湾、欧洲、马来西亚、韩国、泰国、越南等地设立子公司和办事处，并配备专业技术服务团队，为国际客户提供全球化销售服务和技术支持，创造卓越的客户体验，提升客户满意度。

（三）业务经营资质

公司的生产经营不涉及特殊的经营资质。

（四）主要产品的生产及销售情况

1、主要产品的产能、产量和销量

报告期内，公司主要产品的产能、产量和销量情况如下：

单位：万平方米

项目	产品类别	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
产能	PCB 硬板	191.10	958.18	896.51	911.50
	FPC 软板	16.50	66.00	5.43	-
产量	PCB 硬板	171.62	846.96	780.63	777.07
	FPC 软板	12.96	48.19	3.24	-
销量	PCB 硬板	187.49	844.41	774.17	806.99
	FPC 软板	11.49	46.21	3.51	-
产销率	PCB 硬板	109.24%	99.70%	99.17%	103.85%
	FPC 软板	88.65%	95.90%	108.12%	-

注：公司于2023年11月30日完成对MFS集团的收购，2023年度FPC软板的产能、产量及销量等数据仅包含2023年12月数据，下同；公司于2024年9月30日完成对泰国胜宏的收购，2024年度泰国胜宏产能、产量及销量等数据仅包含2024年10-12月数据，下同。

2、主营业务收入构成情况

（1）按产品构成分析

单位：万元

产品类别	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
PCB 硬板	377,470.96	92.62%	874,031.64	86.96%	736,615.89	98.76%	749,136.61	100.00%
FPC 软板	30,058.79	7.38%	131,044.56	13.04%	9,242.19	1.24%	-	-
合计	407,529.75	100.00%	1,005,076.20	100.00%	745,858.08	100.00%	749,136.61	100.00%

报告期内，公司的印制电路板产品以PCB硬板为主。报告期各期，公司PCB硬板收入分别为749,136.61万元、736,615.89万元、874,031.64万元和377,470.96万元。

（2）主营业务收入区域分析

单位：万元

销售区域	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	69,474.16	17.05%	351,793.59	35.00%	258,224.65	34.62%	258,553.25	34.51%
境外	338,055.58	82.95%	653,282.61	65.00%	487,633.43	65.38%	490,583.36	65.49%
合计	407,529.75	100.00%	1,005,076.20	100.00%	745,858.08	100.00%	749,136.61	100.00%

报告期内，公司产品以境外销售为主。报告期各期，公司境外销售收入分别为490,583.36万元、487,633.43万元、653,282.61万元和338,055.58万元。

（五）原材料和能源供应情况

公司生产所需主要原材料为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等，前述原材料市场供应充足、竞争充分。公司与主要原材料供应商已建立了稳定的合作关系，原材料供应稳定。

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购金额及其占原材料采购总额的比重如下：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比
刚性覆铜板	73,709.59	31.94%	177,144.66	28.65%	146,461.16	36.34%	160,901.34	36.86%
半固化片	53,264.39	23.08%	80,437.21	13.01%	45,920.74	11.39%	49,638.81	11.37%
铜球	8,466.94	3.67%	39,056.58	6.32%	36,533.29	9.06%	30,937.48	7.09%
铜箔	9,757.78	4.23%	29,887.64	4.83%	25,183.57	6.25%	25,755.85	5.90%
挠性覆铜板	1,615.36	0.70%	10,615.03	1.72%	378.02	0.09%	-	-
合计	146,814.06	63.62%	337,141.12	54.52%	254,476.78	63.13%	267,233.48	61.22%

注：占比为占主要原材料采购总额的比例。

2、报告期公司主要能源消耗情况

公司日常生产经营耗用的能源主要为电力，报告期各期，公司电力采购金额分别为 38,064.88 万元、44,121.09 万元、51,091.58 万元和 12,813.36 万元。2023 年，公司电力采购金额上升，主要原因系电力价格上调所致；2024 年，公司电力采购金额上升，主要系公司新增生产主体维胜电路板、维胜科技、益阳维胜、MFSM 和泰国胜宏所致。

（六）发行人的技术与研发情况

1、公司的核心技术及其研发情况

公司一直注重核心技术的发展，目前拥有的核心技术均由公司研发团队通过自主研发获得，属于原始创新技术，处于国内领先水平。公司的核心技术覆盖了多层高精密 PCB、HDI 及 FPC 产品的设计、制造工艺及品质控制等多个关键领域，涵盖了新型工艺流程优化、设备选型升级及材料应用创新等方向。截至 2025 年 3 月 31 日，公司获授权的境内及境外专利共 373 项，其中含 175 项发明专利。

2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
研发人员数量（人）	1,366	1,362	1,344	1,077
研发人员数量占比	9.12%	9.87%	10.89%	12.03%
研发投入金额（万元）	12,961.72	44,982.65	34,830.36	28,748.42
研发投入占营业收入比例	3.01%	4.19%	4.39%	3.65%

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品的技术领先水平，巩固和提升公司的市场竞争地位，公司历来重视技术研发，在研发方面的投入逐年增加，报告期各期研发费用占营业收入的比例分别为 3.65%、4.39%、4.19%和 3.01%。公司将不断加大在研发方面的投入，确保公司在 PCB 行业的技术领先地位，增强产品的竞争力，拓展公司的服务领域。

（七）生产经营所需的主要生产设备、房地产

1、固定资产情况

公司的主要固定资产为生产办公用的厂房、生产设备、运输设备和办公设备等，截至 2025 年 3 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	324,569.79	59,227.94	265,235.31	81.72%
机器设备	764,514.70	323,264.80	439,052.56	57.43%
运输设备	5,408.03	3,874.08	1,530.95	28.31%
电子设备及其他	34,074.50	15,489.38	18,440.10	54.12%
合计	1,128,567.02	401,856.20	724,258.91	64.18%

注：上表中固定资产净值不含划分为待处理的固定资产形成的固定资产清理的金额。

2、主要生产设备

截至 2025 年 3 月 31 日，公司主要生产设备如下：

序号	设备名称	原值（万元）	净值（万元）	成新率
1	钻孔机	83,837.10	36,690.99	43.76%
2	曝光机	59,868.09	35,307.39	58.98%
3	镭射钻孔机	48,637.57	38,317.40	78.78%
4	VCP 线	40,070.87	22,178.01	55.35%
5	测试机	23,265.73	13,951.33	59.97%
6	成型机	22,323.50	10,920.64	48.92%

序号	设备名称	原值（万元）	净值（万元）	成新率
7	印刷机	15,556.49	7,272.26	46.75%
8	自动光学检测机	12,477.33	8,518.10	68.27%
9	液压多层真空热/冷压机	12,219.94	6,554.63	53.64%
10	真空蚀刻机	9,934.04	6,491.90	65.35%
11	水平沉铜线	9,108.83	4,984.63	54.72%
12	等离子除胶机	8,608.52	5,797.93	67.35%
13	DES 显影蚀刻连退膜机	7,331.90	3,467.09	47.29%
14	外观检查机	7,218.27	4,578.46	63.43%
15	研磨机	7,042.30	3,810.65	54.11%
16	冲孔机	6,661.42	3,398.19	51.01%
17	冰水机	5,729.01	2,839.87	49.57%
18	磨边机	5,523.13	2,600.00	47.07%
19	钻靶机	5,334.98	3,069.15	57.53%
20	压合自动拆解叠合线	4,588.97	2,437.85	53.12%
21	前处理机	4,466.36	2,492.35	55.80%
22	飞针测试机	4,416.65	2,684.21	60.77%
23	棕化机	3,410.34	2,019.39	59.21%
24	真空树脂塞孔机	3,342.40	2,208.00	66.06%
25	斜边机	2,826.20	1,544.44	54.65%
26	隧道炉	2,460.31	1,196.15	48.62%
27	熔合机	2,444.25	1,046.45	42.81%
合计		418,704.51	236,377.44	56.45%

公司生产设备主要分布于母公司，少部分由子公司胜宏精密、胜华电子、维胜科技、维胜电路板、益阳维胜、MFSM、泰国胜宏等所有和使用。

3、自有房地产

（1）境内自有房地产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司存在境内自有房地产共 50 处，其中房产 46 处，建筑面积合计 507,233.36 平方米，地产 4 处，土地面积合计 433,098.30 平方米。具体情况参见本募集说明书“附件一 自有房地产清单”之“一、境内自有房地产”。

公司全资子公司维胜电路板及益阳维胜于2023年11月30日发行人收购PSL交割完成后成为发行人的全资子公司，维胜电路板及益阳维胜的自有房地产存在下述情形，下述情形均存在于收购PSL交割完成之前：

①维胜电路板存在部分违章建筑

公司全资子公司维胜电路板厂区内存在部分因历史原因导致未办理建设工程审批手续的建筑物（以下合称“违章建筑”）。维胜电路板未就上述违章建筑办理建设工程规划手续，因此存在被相关主管部门采用责令停止建设、限期拆除、处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款的风险。维胜科技电路板目前已启动其厂区内污水站的扩建，相关扩建工程项目已备案，**并已取得扩建工程项目中的“环保站及动力站”的建设工程规划许可证**，待污水站扩建完成后，可立即拆除与污水站相关的违章建筑，其余违章建筑可随时拆除。

上述违章建筑的建筑面积合计约384.83平方米，占发行人境内自有房产总建筑面积的0.08%，占比较小，拆除违章建筑不会对发行人的生产经营产生重大影响。截至本募集说明书签署之日，维胜电路板不存在因上述违章建筑遭到重大处罚的情形。

②维胜电路板有一处已完工但尚未取得不动产权证的自有房产

公司全资子公司维胜电路板因前述违章建筑，存在一处已完工但尚未取得不动产权证的自有房产。待前述扩建工程项目完成且违章建筑问题解决后，可申请办理不动产权证。

上述已完工但尚未取得不动产权证的自有房产的面积约为81.76平方米，占发行人境内自有房产总建筑面积的0.02%，占比较小。

③维胜电路板及益阳维胜存在未按照土地使用权出让合同的约定进行土地开发的情形

公司全资子公司维胜电路板持有位于长沙经开区金华路（东二路）的面积为90,590平方米的国有建设用地使用权（以下简称“长沙地块”）。截至本募集说明书签署之日，长沙地块尚有约30亩（约20,000平方米）土地未进行开发。维胜电路板计划于长沙地块新建研发大楼及环保站和动力站项目，**其中环保站和动力站工程已取得建设工程规划许可证**。根据《闲置土地处置办法》的相关规定及

长沙地块使用权出让合同的约定，维胜电路板尚未开发的土地存在被征缴土地闲置费、被主管部门无偿收回及被追究违约金的风险。

公司全资子公司益阳维胜持有位于益阳市资阳区长春镇清水潭村.新祝村的面积为 107,211.30 平方米的国有建设用地使用权（以下简称“益阳地块”）。截至本募集说明书签署之日，益阳地块尚有约 80 亩（约 53,333 平方米）土地未进行开发。益阳维胜计划于益阳地块建设 1 栋元器件表面贴装工厂及 2 栋综合研发楼，即“益阳维胜科技有限公司装配工厂（二期）建设项目”，该项目已备案。根据《闲置土地处置办法》的相关规定，以及益阳地块使用权出让合同和相关投资协议的约定，益阳维胜尚未开发的土地存在被征缴土地闲置费、被主管部门无偿收回或被追究违约金的风险。

截至本募集说明书签署之日，针对前述土地未开发的情形，维胜电路板及益阳维胜尚未收到任何主管部门要求征缴土地闲置费，或要求无偿收回土地的通知或要求，亦未被任何政府部门或第三方基于任何协议的约定主张任何违约责任（包括但不限于支付违约金）。此外，根据湖南益阳长春经济开发区管理委员会于 2019 年 1 月 24 日出具的《说明》，就益阳地块未按时间要求完成建设的地块，若追究相关责任及违约金，由园区负责协调解决。

（2）境外自有房地产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司存在境外自有房地产共 11 处，土地面积合计 104,453.60 平方米。具体情况参见本募集说明书“附件一 自有房地产清单”之“二、境外自有房地产”。

①泰国胜宏存在未提供建筑证及施工许可证的情形

根据 DFDL (Thailand) Limited 出具的《泰国胜宏法律意见书》，泰国胜宏有效拥有所属土地及土地上之建筑物，且泰国胜宏对土地的占有符合相关法律法规的规定。然而泰国胜宏未提供一栋用作工厂的单层建筑物的建筑证，且未提供位于 Bang Pa-In 工业园区之外三栋建筑物的施工许可证。根据泰国相关建筑控制法规，未获得建筑证或施工许可证的，存在监禁或罚款的风险。

根据发行人就收购泰国胜宏与交易对手方所签订的股份转让协议，存在交易对手方对前述罚款的兜底条款。同时根据 DFDL (Thailand) Limited 出具的《泰国胜宏法律意见书》，前述刑事监禁的风险相对较低。此外未获得施工许可证的三

栋建筑物为员工住宅，对泰国胜宏的业务和运营不会产生重大影响。

②MFSM 尚未获得 4 处物业的产权证

2025 年 1 月，MFSM 与 ACCULEX I VENTURE HOLDINGS SDN. BHD. 签署了买卖协议，以获取位于马来西亚马六甲州的 4 处物业（Lot 6312、Lot 6313、Lot 6315 及 Lot 6316）用于工厂生产运营。其中 Lot 6315 及 Lot 6316 为承租方 MFSM 从出租方 ACCULEX I VENTURE HOLDINGS SDN. BHD. 自 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日承租的物业。该 4 处物业的产权证尚在办理中。

4、租赁房地产

（1）境内租赁房产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司子公司存在在境内租赁用于办公、生产场地及员工住宿的房产共 13 处，建筑面积合计 67,666.60 平方米，具体情况参见本募集说明书“附件二 租赁房产清单”之“一、境内租赁房产”。

境内租赁房产的租赁合同均未办理租赁登记备案手续。根据《中华人民共和国民法典》的规定，未办理租赁登记备案手续不会影响租赁合同的有效性，也不会导致发行人子公司无法正常使用该等租赁物业。

境内租赁房产存在 3 处未取得房屋所有权证书的情形，且境内租赁房产存在 1 处设有在先抵押的情形。发行人子公司寻找替代的租赁房产不存在实质困难，且租赁房产搬迁不会对其经营造成重大影响。

综上，发行人子公司境内租赁房产所存在的上述情形不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

（2）境外租赁房地产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司子公司存在在境外租赁用于办公、生产场地及员工住宿的房产共 5 处，具体情况参见本募集说明书“附件二 租赁房产清单”之“二、境外租赁房产”。

2024 年 9 月，越南胜宏与 VSIP BAC NINH CO., LTD 签署了土地使用权租赁协议，以获取位于越南北宁省延丰区谭江公社的面积为 103,626 平方米的土地使用权，用于建设越南胜宏人工智能 HDI 项目。

四、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司经营理念

科技强骨，文化育魂。公司坚持以创新为引擎，以文化为支撑，秉承“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的经营理念，为实现“客户满意、创新创造、引领行业发展”的愿景而不断奋斗。

（二）发展战略

公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”的核心发展理念，紧抓 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，继续以“抢抓机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”为使命，致力于实现“客户满意、创新创造、引领行业发展”的美好愿景。公司将围绕夯实基础、优化流程、提升效能、强化技术、打造品牌五个层面，具体包括：

1、立足长远，锚定战略再发力。保持战略定力，梳理产品研发思路，重点开发 TOP 级客户高价值产品；发挥公司技术优势，满足车载、AI 算力、智能终端等产品的需求。

2、把脉精准，提升份额注动力。品质支撑，技术营销，价格设计获胜。针对重点客户的重点项目和高附加值产品进行研发；各销售团队按行业、客户设立开发目标和措施，存量、增量及潜力客户实行分级管理。

3、攻坚克难，品质管控聚合力。持续推进完善数字工厂建设，发挥智慧工厂优势，夯实体系建设根基，贯通品质追溯系统，拉通各战区，实施专项攻坚举措，全力满足客户需求。

4、完善机制，团队建设增活力。从人才引进、人才培养、人才考核、人才激励四个层面健全人才管理机制，做到人尽其才，才尽其用。特别是通过宏系干部培养计划的实施，为公司发展赋能。

5、从严治理，企业运营显魄力。守住安全线，对安全事故零容忍。扎紧管理网，绝不触碰管理红线。走稳合规路，完善上市公司管理制度和流程，确保合法依规，提升企业影响力。管好资金池，控本降费，降低负债，从容发展。

6、真抓实干，和衷共济添助力。加强干部队伍锻造，做堪当表率的模范型干部、务实担当的实干型干部、精益求精的创新型干部、以厂为家的奉献型干部，倾力打造能干事、干实事的高效团队。

（三）未来三年业务发展规划

公司立志于推动中国“智”造，身体力行地推动 PCB 产业技术创新。近几

年，面对日益激烈的行业竞争，公司业绩仍然能保持稳定增长，根本原因在于一直在走创新路上。

未来三年是公司实现第二个百亿目标的关键阶段。为达成此目标，公司经营层将围绕“转观念、树品牌、强根基、下现场、堵漏洞、抓改革”，有序展开各项工作，具体包括：

1、技术再强化。持续优化升级产品结构，提升技术支撑能力，深耕拳头产品，紧盯汽车、高端人工智能、高阶数据传输、AI 算力等领域，走差异化创新之路，不断提升核心竞争力。

2、管理精细化。流程管事、制度管人，不断优化生产流程，完善作业标准，提高生产效率，进一步降低运营成本。充分发挥数字工厂的效用，苦练内功，提升内生发展动力。

3、产品深入化。继续加大市场推广和客户开发力度，走近客户，渗透核心客户的核心产品，提升产品附加值，有效提升公司市占率和盈利水平。

4、发展持续化。谨遵“安全无小事、时时讲安全”的准则，筑牢安全生命线，注重生态环境保护、积极履行社会责任、不断提高治理水平。

5、战略协同化。与 MFS 集团进行优势互补，从业务、资产、管理等方面进行深度融合，取长补短，以便能够在产品结构、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应，获取新的利润增长点。

五、财务性投资情况

（一）财务性投资及类金融的认定标准

1、财务性投资的认定标准

根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》，“财务性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，

如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”

2、类金融业务的认定标准

根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资情况

公司于 2024 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书出具之日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）。

（三）公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资的情形

截至 2025 年 3 月 31 日，发行人可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表科目账面价值情况如下表所示：

项目	截至 2025 年 3 月 31 日账面价值（万元）	是否属于财务性投资
交易性金融资产	-	否
衍生金融资产	-	否
应收款项融资	4,954.72	否
其他应收款	15,610.61	否
其他流动资产	19,792.73	否
其他权益工具投资	122,158.54	否
其他非流动资产	88,500.69	否

1、其他权益工具投资

公司其他权益工具投资为对珠海越亚和方正科技的股权投资，具体情况如下：

单位：万元

序	被投资企业	初始投资	投资金额	持股	期末余额	主营业务情况	占最近
---	-------	------	------	----	------	--------	-----

号	业名称	时点		比例			一期末 净资产 比例
1	珠海越亚	2021年9月	8,958.93	2.15%	11,118.23	无芯封装载板的研发、设计、生产以及销售	1.12%
2	方正科技	2022年11月	36,612.20	5.49%	111,040.31	PCB 产品研发、生产与销售	11.18%
合计		-	45,571.13	-	122,158.54	-	12.30%

注：公司通过直接持有科发富鼎的份额而间接持有珠海越亚的股权。

珠海越亚与方正科技均与公司的主营业务具有高度相关性，均属于公司 PCB 业务的同一领域或产业链上下游，属于公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，因此不构成财务性投资。

2、交易性金融资产

截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 0.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 354.90 万元，系远期外汇产品公允价值变动收益，不属于财务性投资。

3、衍生金融资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司衍生金融资产账面价值为 0.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司衍生金融资产账面价值为 1,579.55 万元，系公司为获取存款、贷款利息差所办理的“存美贷美”业务借款余额与保证金余额折算为人民币后的差额，不属于财务性投资。“存美贷美”业务中，公司与银行签订国际贸易融资、权利质押、外汇合约等协议，主要质押美元保证金，同时向银行借款等额美元，并通过外汇合约锁定汇率，借款到期时以保证金及利息归还借款本金及利息。

4、应收款项融资

截至 2025 年 3 月 31 日，公司应收款项融资账面价值为 4,954.72 万元，均系银行承兑汇票，不属于财务性投资。

5、其他应收款

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 15,610.61 万元，系日常经营产生，主要包括应收出口退税、押金及保证金、代扣代缴款、预付物业费、员工备用金等，不属于财务性投资，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	金额
----	----

项目	金额
应收出口退税	11,860.02
押金及保证金	2,300.85
代扣代缴款	1,109.67
预付物业费、员工备用金等	1,844.09
账面余额合计	17,114.62
减：坏账准备	1,504.01
账面价值	15,610.61

6、其他流动资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 19,792.73 万元，系待抵扣的增值税进项税额和预缴企业所得税，不属于财务性投资。

7、其他非流动资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产账面价值为 88,500.69 万元，系长期资产预付款、合同取得成本和使用权资产押金，不属于财务性投资，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	账面价值
长期资产预付款	86,986.82
合同取得成本	1,178.92
使用权资产押金	334.95
合计	88,500.69

综上所述，自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况，不存在类金融业务。截至 2025 年 3 月 31 日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定。

六、未决诉讼、仲裁等事项

截至 2025 年 3 月 31 日，公司无任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

七、违法行为、资本市场失信惩戒等相关情况

报告期内，公司遵守国家的有关法律与法规，合法经营，不存在重大违法违规的行为。报告期内，公司存在的四处行政处罚情形如下：

（一）惠州市生态环境局行政处罚

2021年12月，公司因违反建设项目环境影响评价制度和建设项目环境保护三同时制度，被惠州市生态环境局处以50万元罚款（行政处罚决定书文号：惠市环（惠阳）罚[2021]103号），处罚依据系因公司增加线路板生产规模，扩建项目环境影响报告表未经批准即于2018年3月开始建设；需要配套建设的环境保护设施未经验收即于2019年3月建设完成并投入生产，该行为违反建设项目环境影响评价制度和建设项目环境保护三同时制度。

公司已针对扩建产能补办环评批复，并完成环评验收程序。2022年2月，公司取得胜宏科技三期改扩建项目环境影响报告表的批复（文号惠市环建[2022]16号）；2022年4月，公司通过胜宏科技三期改扩建项目竣工环境保护验收。

根据《惠州市环境保护局主要环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准（2018年版）》的规定，本次违法情节认定为“投资额在1亿元以上的轻度影响项目”，并非法律法规规定的顶格处罚，且行政处罚决定书未认定发行人上述违法行为属于情节严重的情形。本次环保处罚系因公司在保证污染物达标排放的基础上有效实现了降耗降污增产，现有产能超过环评批复所载数量的情形，未导致公司排污超许可范围，未造成重大环境污染或者生态破坏，亦未被环境保护主管部门责令停止生产或者使用的情形。发行人已缴纳罚款，并且已经整改完毕，不存在逾期不改正的情形。此外根据惠州市生态环境局惠阳分局于2022年4月27日出具的《情况说明》：“胜宏科技（惠州）股份有限公司近一年内未发生重大环境污染违法行为。”因此发行人上述违法行为不构成重大违法违规情形，不会构成胜宏科技向特定对象发行股份的重大障碍。

（二）广东省统计局行政处罚

2023年6月，公司因提供不真实统计资料，被广东省统计局处以警告并处罚人民币1万元罚款（行政处罚决定书文号：粤统罚字[2023]第4号）。

上述处罚金额较小，处罚额度属于《广东省统计局关于行政处罚自由裁量权的适用规则》规定的违法程度“一般”的处罚基准范围，并非法律法规规定的顶格处罚，不属于《中华人民共和国统计法》规定的情节严重的情形，且行政处罚决定书亦未认定发行人上述违法行为属于情节严重的情形。发行人已缴纳罚款，

并且已经整改完毕，不存在逾期不改正的情形。因此发行人上述违法行为不构成重大违法违规情形，不会构成胜宏科技向特定对象发行股份的重大障碍。

（三）中华人民共和国西永海关行政处罚

2024年1月，公司因货物报关时毛重申报与实际不符，被中华人民共和国西永海关处人民币1500元罚款（当场处罚决定书文号：西永关缉简违字[2024]3号）。

上述处罚金额较小，处罚额度属于《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》规定的违法程度“一般”的处罚基准范围，并非法律法规规定的顶格处罚，且当场处罚决定书亦未认定发行人上述违法行为属于情节严重的情形。发行人已按照当场处罚决定书的要求缴纳罚款，不存在逾期不改正的情形。因此发行人上述违法行为不构成重大违法违规情形，不会构成胜宏科技向特定对象发行股份的重大障碍。

（四）中华人民共和国梅沙海关行政处罚

2024年11月，公司因货物报关时与申报不符，被中华人民共和国梅沙海关处人民币4.96万元罚款（处罚决定书文号：梅沙关审缉违字[2024]132号）。

上述处罚金额较小，处罚额度属于《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》规定的违法程度“一般”的处罚基准范围，并非法律法规规定的顶格处罚，且处罚决定书亦未认定发行人上述违法行为属于情节严重的情形。发行人已按照处罚决定书的要求缴纳罚款，不存在逾期不改正的情形。因此发行人上述违法行为不构成重大违法违规情形，不会构成胜宏科技向特定对象发行股份的重大障碍。

除上述情形外，公司遵守国家的有关法律与法规，合法经营，不存在重大违法违规、资本市场失信惩戒的行为。公司不存在现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；公司或者其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

近年来，公司深入贯彻科技兴企的战略思想，把握新一轮科技革命和产业变革机遇，以印制线路板的研发和制造为基础，服务高技术领域和未来产业，落实国家重大战略需求，致力于引领行业科技进步，并深度参与全球产业链分工，创造了优异的经济和社会效益。随着公司的发展进入新的里程碑阶段，面向高技术领域的资金需求大幅增加。

1、公司坚持创新驱动，服务于国家重大战略需求

工信部等七部门于 2024 年初发布《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出围绕制造业主战场加快发展未来产业，面向国家重大战略需求和人民美好生活需要，前瞻部署光子计算技术、大模型等新赛道，打造超大模型新型智算中心、新型显示等领域的创新标志性产品，引导领军企业前瞻谋划新赛道，壮大产业主体，鼓励国内企业走出去。

胜宏科技坚持以创新驱动为中心，系统化制定和实施科技创新举措，致力于引领行业科技进步，在人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等战略性高技术领域实现核心应用，相关产品系全球先进 AI 芯片和超算系统的关键材料，竞争力领先同行业，与英伟达等客户建立了深度合作。

自上市以来，公司依托省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心等研发平台，围绕 PCB 核心技术累计投入研发近 20 亿元，拥有线路板领域有效专利超 370 项，研发团队人员超 1300 名，建立了以基础材料为起点，到工艺、设备的全产业链技术能力。

2、公司持续创造新动能，成为行业领军企业

公司持续创造发展新动能，在科技创新、战略布局、经营利润、市场地位等方面全方位突破，由上市之初的全球百强企业跃升至全球第 13 名，以行业标杆的示范性作用，取得了引领式发展成绩，致力于成为 PCB 行业领军企业。

自 2015 年以来，公司的收入和净利润实现近 30% 的复合增速，领先全球 PCB 行业；全球排名跃升至第 13 名，在高密度多层 VGA（显卡）PCB 和小间距 LED

PCB、人工智能终端笔电产品等多个细分领域达到全球第一。

公司以高度前瞻性理念，率先布局智慧工厂，最早实现 PCB 行业的数字化生产运营技术的突破，成为同行业第一家建成新一代工业互联网智慧工厂的企业，人均产值屡创新高，以数字化赋能高质量高效率发展。

同时，公司的绿色发展战略也引领了行业进步和变革。胜宏科技是 PCB 行业首批获“国家级绿色工厂”荣誉认证的企业。多年来，公司积极构建行业领先的高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，通过引进光储可再生能源系统设施、磁悬浮离心式冰水机、能管中心等节能减排技术，打造行业绿色制造标杆。

3、公司高度重视投资者回报，提升公司投资价值

得益于资本市场的助力，公司成功把握了电子信息产业大发展的机遇。自 2015 年上市至 2024 年末，公司累计实现收入 523.13 亿元，累计实现净利润 52.89 亿元，累计发放现金分红和回购超过 14 亿元，占净利润的比例超过 28%，为投资者创造了稳健回报，有效践行了高质量发展的理念。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、面向国家战略需求，前瞻性布局高技术领域

人工智能应用场景对 PCB 产品的技术等级和品质一致性提出很高要求，公司需配套建立先进制程能力，以及高精度的工艺控制能力，产品阶数、线宽/线距等指标均需达到领先水平。

为加大对人工智能、超级计算、新型显示等高技术领域的布局，公司需大幅增加研发投入，并升级装备能力，创新生产技术和工艺，以打造引领行业的创新旗舰产品，满足人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等卡脖子领域的高等级要求，推进前述高技术产业链的国产化。

2、响应国家政策和市场趋势，深度参与全球产业链分工

为响应国家政策号召，深度参与全球未来产业分工，公司积极谋划“走出去”，与上下游国际知名企业联合开展技术研发和产业化应用，在国际市场打造领先的研发和交付能力。

随着合作广度和深度不断增强，核心海外客户纷纷要求 PCB 厂商参与其全球供应网络，对公司建立海外生产布局的时间要求非常迫切，高度重视实施时间表。PCB 行业企业近年来纷纷出海，在东南亚投资扩产。海外布局一方面有利

于获取新增海外客户，另一方面带动合作客户对国内基地产品的需求。公司亟需快速完成出海布局，建立全球化配套能力，而海外投资布局需要较大规模的资本性开支。

3、改善资产负债结构，提升财务健康度水平

公司 2023 年度有息负债增加较多，一方面，相关财务费用影响公司业绩，另一方面，公司核心战略客户高度重视供应商的财务健康度，要求公司持续提升负债结构、现金流、盈利能力等方面的健康度水平，财务健康度水平直接影响公司与战略客户的合作。通过本次融资，公司的资产负债结构将得到大幅改善，财务健康度水平将提升，促进公司与核心战略客户合作规模的扩大。

二、发行对象及其与发行人的关系

（一）发行对象

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

（二）发行对象与公司的关系

截至本募集说明书签署之日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告中披露发行对象与公司的关系。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价

基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

调整公式如下：

假设调整前发行底价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行底价为 P_1 ，则：

派息： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过 257,292,863 股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会授权，在本次发行申请通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行股票总数及募集资金总额届时将相应调整。

（三）限售期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	85,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00
合计		376,755.57	190,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金中用于偿还银行借款和补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，超出金额为 7,955.07 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 8,000.00 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议审议，公司本次发行募集资金总额由原不超过 198,000.00 万元调减至不超过 190,000.00 万元。

本次募集资金总额小于项目总投资额，资金缺口由公司自有或自筹资金解决。本次募集资金到位后，公司资产负债率相较于募集资金到位前有所下降，偿债能力提升，相关资金的取得不存在重大不确定性。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署之日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系，具体将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行前，陈涛先生持有胜华欣业 90% 的股权并间接持有香港胜宏 70% 的

股权，合计控制公司 33.85%的表决权，系上市公司的实际控制人。以本次发行股票数量上限测算，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过、**深圳证券交易所审核通过**。

本次向特定对象发行股票尚需中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

在中国证监会同意注册后，公司将依法实施本次向特定对象发行股票，并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次发行股票的相关程序。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	85,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00
合计		376,755.57	190,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金中用于偿还银行借款和补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，超出金额为 7,955.07 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 8,000.00 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议审议，公司本次发行募集资金总额由原不超过 198,000.00 万元调减至不超过 190,000.00 万元。

二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系

公司专业从事印制线路板研发、生产和销售，产品覆盖刚性电路板（多层板和 HDI 为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联网、医疗仪器、计算机、航空航天等领域，产品获得英伟达、特斯拉、AMD、英特尔、Continental、诺和诺德、台达等知名客户认证。

本次向特定对象发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目，以及补充流动资金和偿还银行贷款。

募集资金投向围绕公司 PCB 主业，在海外布局高阶 HDI 及高多层板产能，升级装备能力，创新生产技术和工艺，以打造引领行业的创新旗舰产品，满足人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等卡脖子领域的高等级要求，有利于提升公司的核心竞争力。补充流动资金和偿还银行贷款项目有利于增强公司资金实力，优化财务结构，提升财务健康度水平。

三、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景

（一）越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目

1、项目概况

越南胜宏人工智能 HDI 项目预计总投资 181,547.67 万元，拟使用募集资金 85,000.00 万元，建设期 3 年，第三年开始分步投产，至第五年全部达产。本项目的实施主体为全资子公司越南胜宏，地点位于越南北宁省，拟建设生产人工智能用高阶 HDI 产品，计划年产能 15 万平方米。

泰国高多层印制线路板项目预计总投资 140,207.90 万元，拟使用募集资金 50,000.00 万元，建设期 2 年，第三年全部达产。本项目的实施主体为全资子公司泰国胜宏，地点位于泰国大城府，拟建设生产服务器、交换机、消费电子等领域用高多层 PCB 产品，计划年产能 150 万平方米。

2、项目建设的必要性

（1）全球化战略释放增长驱动力，公司需进一步深化布局

随着公司业务规模的扩大，以及客户等级的结构性提升，全球化战略势在必行。近年来，全球化成为公司的核心发展战略之一，也是当下实现新的跨越式发展的必要举措。

经过长期研判和探索，公司于 2023 年收购全球领先的软板制造商 MFS 集团，完成全球化布局的第一个里程碑，打造了良好的协同效应。未来，公司需要进一步深化全球化布局，在海外市场做精做细，与上下游国际知名企业联合开展技术研发和产业化应用，在国际市场打造领先的研发和交付能力。

越南项目聚焦高速成长的人工智能赛道，拟投资业内领先的先进制程装备，生产人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等应用领域的高阶 HDI 产品。泰国项目主要布局多层板，目标应用领域包括服务器、交换机、汽车电子、消费电子等，满足客户对高端多层板的海外交付要求。

（2）客户高度重视公司海外布局及实施时间表

伴随胜宏科技国际竞争力的增强，客户等级显著提升，客户结构整体升级，成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、台达等国际知名企业的供应链，构成了公司最核心的客户群。优质国际客户的认可，使得公司在宏观经济和行业景气度波动期间均实现了稳健的业绩，为全体股东创造回报。优质国际客户是公司未来发展的重要驱动力之一。

随着合作广度和深度不断增强，国际客户纷纷要求公司参与其全球供应网络，建立全球化交付配套能力，以满足其在国际市场的订单需求；且客户对公司建立海外布局的时间要求非常迫切，高度重视实施时间表。若未能按期建立全球化配套能力，则公司将面临错失业务机会的风险，不利于长期发展。

（3）人工智能推动电子行业创新，高端 PCB 产品需求对技术和装备升级提出要求

随着人工智能技术和应用的快速发展，未来五年 AI 系统、服务器、存储、网络设备等等是 PCB 需求增长的主要动能。随着 AI 服务器的升级，GPU 主板也将由高多层板逐步升级为 HDI，HDI 将是未来 5 年 AI 服务器相关增速最快的 PCB，特别是 4 阶以上的高阶 HDI 产品需求增速快。

随着服务器平台的升级，服务器 PCB 持续向更高层板发展，对技术和装备的升级提出要求。对应于 PCIe3.0 的 Purely 服务器平台一般使用 8-12 层的 PCB 主板；PCIe4.0 的 Whitley 平台则要求 12-16 层的 PCB 层数；对于未来将要使用 PCIe5.0 的 Eagle Stream 平台而言，PCB 层数需要达到 16-18 层以上。根据 Prismark 数据，18 层以上 PCB 单价约是 12-16 层价格的 3 倍。

针对高速增长的高阶 HDI 和高多层板等高端产品需求，公司需着力布局先进技术和装备，以满足核心战略客户的要求。

3、项目建设的可行性

（1）人工智能 AI 催生 PCB 行业增长新动能

受益于人工智能 AI 算力基建带来的服务器、交换机需求高速增长，以及 AI 开启的消费电子终端创新周期，HDI、层数较高的高多层板等高端品需求快速增长，PCB 行业景气度持续上行，根据 Prismark 数据，2024 年全球 PCB 产值恢复增长，产值达到 735.65 亿美元，同比增长 5.8%；预计 2029 年全球 PCB 产值将

达到 946.61 亿美元，2024-2029 年年均复合增长率预计为 5.2%。而 HDI 将成为 AI 服务器相关 PCB 市场增速最快的品类，Prismark 预测 2023-2028 年 AI 服务器相关 HDI 的年均复合增速将达到 16.3%。

根据 IDC 数据，2024 年全球 AI 服务器出货金额将达到 280 亿美元，同比增长 16%，其中，高阶 AI 服务器出货量增速将达到 128%。其中，英伟达占据了 AI 服务器 GPU 主导地位，预计 2024 年将出货 690 万颗 GPU，增速达到 82%。以现有核心战略客户合作为基础，公司重点聚焦 AI 服务器领域的高端产品需求，市场前景可观。

（2）东南亚布局成为行业趋势，产业链聚集效应逐渐形成

自 2006 年超越日本成为全球第一大 PCB 生产国开始，我国 PCB 产能已占据全球产能的一半以上。目前，东南亚投资布局成为 PCB 行业的新发展趋势。全球排名前列的 PCB 厂商基本均在东南亚投资布局，以泰国、越南等为代表的东盟国家的 PCB 产业集群逐渐形成。

近年来，泰国和越南承接了较多的电子信息行业企业的产能转移，产业集群快速发展，吸引了惠普、索尼、松下、三星、LG、西门子等终端品牌厂商，广达、UMC Electronics、Celestica、Sanmina 等组装厂，以及莫仕、台达、村田等各类元器件制造商，其中很多企业为胜宏科技现有客户。下游客户在东南亚的布局，以及与胜宏科技的紧密合作，为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实基础。

（3）公司技术实力和客户拓展能力持续提升

公司依托省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心等研发平台，自上市以来，围绕 PCB 核心技术累计投入研发近 20 亿元，拥有线路板领域有效专利超 370 项，研发团队人员超 1300 名，建立了以基础材料为起点，到工艺、设备的全产业链技术能力。

随着技术实力的提升，公司的客户群体持续升级，成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、台达等国际知名企业的供应链，优质的核心客户群体驱动公司订单需求的增长。

（4）随着综合实力的提升，公司的国际化运营能力渐趋成熟

2023 年 11 月收购 MFS 集团后，公司全方位赋能标的公司发展，整合效果

良好，协同效应显著。2024 年度，MFS 集团营业收入同比增长 14%，净利润同比增长 114%。

随着国际化战略的持续贯彻实施，公司的国际化运营能力持续提升，建立起较为成熟的人才团队、管理体系和海外运营能力，结合现有优质大客户资源，具备充足的海外项目实施能力。

（5）印制线路板（PCB）行业发展得到国家政策大力支持

作为电子产品中重要的基础载体，PCB 产业是国家重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到国家政策大力支持。“十四五规划”中提出要加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业，国务院及相关部委随后推出了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》、《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》、《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》等一系列产业政策和引导 5G 通信、新能源汽车、物联网、工业互联网等领域的发展。这为 PCB 行业的未来发展带来了积极的影响，不断推动行业发展。

（二）补充流动资金和偿还银行贷款项目

1、项目概况

公司计划将本次募集资金中的 55,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款，由母公司胜宏科技（惠州）股份有限公司实施，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2、项目的必要性

（1）补充营运资金满足公司业务快速发展的需求

随着横向并购战略的实施，以及 AI 算力、AI 服务器等高技术领域蓬勃发展，公司的收入和利润规模快速增长，未来几年仍将大力投入研发，面向国家重大战略需求，抢先布局 AI 算力、GPU 芯片等领域，筑牢技术优势，抢抓发展机遇，需要大量的营运资金。

报告期内，公司营运资金缺口主要通过向银行贷款的方式解决，导致财务费用增加。通过本次发行募集资金补充流动资金，公司的营运资金将得到补充，抗风险能力将进一步增强。

（2）改善资产负债结构，提升财务健康度水平

2022年末至2025年3月末，公司资产负债率、流动比率、速动比率情况如下：

项目	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
资产负债率	52.54%	53.44%	56.13%	51.50%
流动比率	1.18	1.07	0.96	0.93
速动比率	0.88	0.80	0.78	0.75

因并购贷款等因素所致，公司2023年度有息负债增加较多，一方面，相关财务费用影响公司业绩，另一方面，公司核心战略客户高度重视供应商的财务健康度，要求公司持续提升负债结构、现金流、盈利能力等方面的健康度水平，财务健康度水平直接影响公司与战略客户的合作。通过本次融资，公司的资产负债结构将得到改善，财务健康度水平将提升，避免因负债率过高而影响与核心战略客户的合作。

3、项目的可行性

（1）本次发行的募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险，有效缓解公司经营活动扩张的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

（2）公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。

公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

4、补充流动资金规模的合理性

（1）公司资产负债率情况

报告期各期末，公司资产负债率分别为51.50%、56.13%、53.44%和52.54%，

资产负债率较高且高于同行业公司平均值，具体情况如下：

公司名称	2025-3-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
深南电路	42.14%	42.12%	41.67%	40.88%
景旺电子	41.62%	40.25%	47.94%	46.48%
沪电股份	44.78%	43.81%	38.65%	33.87%
鹏鼎控股	25.83%	27.44%	29.81%	28.00%
东山精密	58.26%	58.96%	59.00%	59.52%
同行业公司平均值	42.53%	42.51%	43.42%	41.75%
胜宏科技	52.54%	53.44%	56.13%	51.50%

（2）公司银行借款情况

截至 2025 年 3 月末，公司短期借款余额为 46,780.93 万元，一年内到期的长期借款余额为 79,385.16 万元，长期借款余额为 285,407.34 万元，合计 411,573.43 万元。公司货币资金余额为 132,999.99 万元，货币资金余额远小于银行借款余额。

（3）补充流动资金测算

①流动资金测算假设

流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债的影响，公司以经审计的 2024 年度营业收入及相关经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例为基础，按照销售百分比法，对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产（应收票据+应收账款+应收款项融资+预付款项+存货）和主要经营性流动负债（应付票据+应付账款+合同负债）分别进行估算，进而预测公司未来三年（2025 年-2027 年）生产经营对流动资金的需求量。

②2025 年-2027 年营业收入增长率预测

2022 年-2024 年，公司分别实现营业收入 788,515.46 万元、793,124.76 万元和 1,073,146.95 万元，2022 年-2024 年营业收入复合增长率为 16.66%。预测公司 2025 年-2027 年营业收入增长率为 16.66%。

③营运资金需求及未来三年流动资金缺口

营运资金需求=经营性流动资产-经营性流动负债；未来三年流动资金缺口=2027 年营运资金需求-2024 年营运资金需求。

经测算，公司未来三年流动资金缺口为 72,258.39 万元。上述假设及测算不代表公司对 2025 年-2027 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。

综上，公司资产负债率较高，报告期末货币资金余额远小于银行借款余额，公司未来三年流动资金缺口为 72,258.39 万元。本次发行拟使用募集资金中 55,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款具有合理性。

5、本次发行补充流动资金规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定

根据 2023 年 2 月中国证监会发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》之规定：“通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。”除“补充流动资金和偿还银行贷款项目”外，本次募投项目拟使用募集资金投入的内容均为资本性支出，不存在非资本性支出的情况。本次募集资金中拟用于补充流动资金和偿还银行贷款合计为 55,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 28.95%，未超过募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定。

（三）项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排等

1、项目的实施准备和进展情况

越南胜宏人工智能 HDI 项目由全资子公司越南胜宏实施。越南胜宏已完成企业设立登记并取得越南当地投资许可，并与 VSIP BAC NINH CO., LTD 签署了土地使用权租赁协议，且已取得土地使用权证。公司已就对越南胜宏投资建设的事项，取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》、中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行出具的《业务登记凭证》（业务类型：ODI 中方股东对外义务出资）。

泰国高多层印制线路板项目由全资子公司泰国胜宏实施。泰国子公司系公司 2024 年 9 月收购的主体，拥有完整的业务资质。目前已开始实施建设，公司从总部调遣相关管理及技术人员参与泰国子公司建设运营。公司已就增资泰国子公司进行产能升级扩建的事项，取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》、中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行出具的《业务登记凭证》（业务类型：ODI 中方股东对外义务出资）。

2、预计实施时间及整体进度安排

(1) 越南胜宏人工智能 HDI 项目

公司本次募投项目“越南胜宏人工智能 HDI 项目”的实施主要包括购买及清理场地、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、验收竣工等工作安排。项目预计建设周期 36 个月，具体建设进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
购买及清理场地	■											
工程及设备招标		■										
基础建设及装修工程		■	■	■	■	■						
设备采购及安装调试			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训				■	■	■	■	■	■	■	■	■
验收竣工												■

项目资金预计使用进度安排如下：

单位：万元

建设期	拟投资金额	
	建设投资	铺底流动资金
第一年	60,389.97	-
第二年	52,467.76	-
第三年	62,034.82	6,655.12
合计	174,892.55	6,655.12

本次发行拟募集 85,000.00 万元用于越南胜宏人工智能 HDI 项目，由于募集资金低于项目投资金额，因此，募集资金到账后，公司将结合项目建设进度以及资金情况合理统筹安排募集资金的投入。

本次向特定对象发行股份董事会前，公司已支付除土地使用权证书移交环节的 5%之外的全部租金（Rental Price）用于实施该募投项目，相关支出未包含在该募投项目投资构成中。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，也不存在置换董事会前已投入资金的情形。

(2) 泰国高多层印制线路板项目

公司本次募投项目“泰国高多层印制线路板项目”的实施主要包括清理场地、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试生产、验收竣工等工作安排。项目预计建设周期 24 个月，具体建设进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
清理场地	■											
工程及设备招标		■										
基础建设及装修工程			■	■	■	■						
设备采购及安装调试							■	■	■	■	■	
人员招聘及培训								■	■	■	■	■
试生产											■	■
验收竣工												■

项目资金预计使用进度安排如下：

单位：万元

建设期	拟投资金额	
	建设投资	铺底流动资金
第一年	58,877.97	-
第二年	74,325.24	7,004.68
合计	133,203.21	7,004.68

本次发行拟募集 50,000.00 万元用于泰国高多层印制线路板项目，由于募集资金低于项目投资金额，因此，募集资金到账后，公司将结合项目建设进度以及资金情况合理统筹安排募集资金的投入。

本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，也不存在置换董事会前已投入资金的情形。

（四）项目投资概算

1、越南胜宏人工智能 HDI 项目

本项目计划总投资 181,547.67 万元，其中建设投资 174,892.55 万元，铺底流动资金 6,655.12 万元，本次募集资金全部用于资本性支出项目。项目具体投资构成明细如下：

序号	工程或费用名称	投资金额	占比	是否属于资本性支出
1	建设投资	174,892.55	96.33%	是
1.1	建筑工程费	50,822.91	27.99%	是
1.2	设备购置费	120,455.96	66.35%	是
1.3	设备安装费	3,613.68	1.99%	是
2	铺底流动资金	6,655.12	3.67%	否
项目总投资		181,547.67	100.00%	-

（1）建筑工程费

本项目建设工程费的测算如下：

序号	项目	总建筑面积（m ² ）	单位造价（元/m ² ）	金额（万元）
1	主体基建工程	135,650.08	1,412.33	19,158.33
2	装修工程	135,650.08	1,707.53	23,162.67
3	绿化及道路等配套工程	-	-	8,501.91
合 计		-	-	50,822.91

（2）设备购置费

设备购置费主要系购置生产设备及其他配套设备所产生的支出。项目设备购置费用根据项目产能规划、所需设备数量和同类产品的市场价格进行测算，本项目设备购置费为 120,455.96 万元。

（3）设备安装费用

本项目设备安装费按照设备购置费的 3% 计取，设备安装费金额为 3,613.68 万元。

（4）铺底流动资金

公司结合本次募投项目的预计收入规模及各项资产、负债的周转情况对流动资金需求进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款等收支状况，参照企业现有实际经营情况，铺底流动资金占项目达产后流动资金的 30%，本项目所需铺底流动资金为 6,655.12 万元。

上述各项投资支出均为项目建设的必要支出，测算过程合理。

2、泰国高多层印制线路板项目

本项目计划总投资 140,207.90 万元，其中建设投资 133,203.21 万元，铺底流动资金 7,004.68 万元，本次募集资金全部用于资本性支出项目。项目具体投资构成明细如下：

序号	工程或费用名称	投资金额	占比	是否属于资本性支出
1	建设投资	133,203.21	95.00%	是
1.1	建筑工程费	21,381.85	15.25%	是
1.2	设备购置费	108,564.43	77.43%	是
1.3	设备安装费	3,256.93	2.32%	是
2	铺底流动资金	7,004.68	5.00%	否
项目总投资		140,207.90	100.00%	-

（1）建筑工程费

本项目建设工程费的测算如下：

序号	项目	金额（万元）
1	主体建设工程	4,588.50
2	装修工程	16,392.70
3	绿化及道路等配套工程	400.65
合 计		21,381.85

注：泰国高多层印制线路板项目系在原有土地上改扩建，不涉及厂房土建，主要对现有场地进行装修。

（2）设备购置费

设备购置费主要系购置生产设备及其他配套设备所产生的支出。项目设备购置费用根据项目产能规划、所需设备数量和同类产品的市场价格进行测算，本项目设备购置费为 108,564.43 万元。

（3）设备安装费用

本项目设备安装费按照设备购置费的 3% 计取，设备安装费金额为 3,256.93 万元。

（4）铺底流动资金

公司结合本次募投项目的预计收入规模及各项资产、负债的周转情况对流动资金需求进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款等收支状况，参照企业现有实际经营情况，铺底流动资金占项目达产后流动资金的 30%，本项目所需铺底流动资金为 7,004.68 万元。

上述各项投资支出均为项目建设的必要支出，测算过程合理。

（五）本次募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

1、越南胜宏人工智能 HDI 项目

本项目建设期 36 个月。建设期第 3 年预计达产 40%，建设期第 5 年预计全部达产，项目达产后效益测算过程如下：

单位：万元

项目	T2 年	T3 年	T4 年	T5 年	T13 年
营业收入	-	66,000.00	115,500.00	165,000.00		165,000.00
营业成本	-	48,964.18	90,335.14	123,693.39		120,560.97
税金及附加	-	-	-	-		-
经营利润	-	17,035.82	25,164.86	41,306.61		44,439.03
销售费用	-	1,144.57	2,026.15	2,929.23		2,965.69
管理费用	3,162.02	1,884.74	3,320.05	4,775.58		4,809.85
研发费用	-	1,821.72	3,288.04	4,847.22		5,004.75
财务费用	-	-	-	-		-
利润总额	-3,162.02	12,184.79	16,530.63	28,754.58		31,658.74
所得税费用	-	-	-	-		3,165.87
净利润	-3,162.02	12,184.79	16,530.63	28,754.58		28,492.86

（1）营业收入

本项目主要产品为高阶 HDI，产品价格以当前市场价格及未来变化趋势作为主要测算依据，销售数量根据所建工厂的配套生产能力及未来市场需求预计来估算。建设期第 3 年预计达产 40%，建设期第 5 年全部达产，项目计算期内，达产后年销售收入 165,000.00 万元。

（2）营业成本

项目营业成本包括原材料消耗费、直接人工费、制造费用、折旧费和燃料及动力费等。原材料消耗费参考主要原材料的市场现有价格；直接人工费根据项目拟投入人员数量，参照目前公司同岗位平均工资水平和当地人员薪酬水平，结合当地未来人工上涨的趋势进行估算；制造费用中折旧费根据项目新增固定资产金额，参考公司现行的会计政策计提，其他制造费用根据公司历史财务数据进行测算。建设期第 5 年全部达产时的营业成本为 123,693.39 万元。

（3）期间费用

项目期间费用中的人工工资及福利根据项目拟投入人员数量，参照岗位平均工资水平结合未来涨幅趋势进行测算，其他费用根据公司历史财务数据中各项费用占营业收入的比例进行测算。建设期第 5 年全部达产时的年销售费用为

2,929.23 万元，管理费用为 4,775.58 万元，研发费用为 4,847.22 万元。

综上，本项目建设期 36 个月。项目全部达产后，预计实现年销售收入 165,000.00 万元。公司选用市场较为通行的 12% 作为折现率。经测算，项目静态投资回收期为 7.69 年（所得税后，含建设期），税后投资内部收益率为 15.18%。

2、泰国高多层印制线路板项目

本项目建设期 24 个月。建设期第 2 年预计达产 50%，建设期第 3 年预计全部达产，项目达产后效益测算过程如下：

单位：万元

项目	T2 年	T3 年	T4 年	T12 年
营业收入	97,500.00	195,000.00	195,000.00		195,000.00
营业成本	78,718.41	159,424.79	159,829.10		156,527.86
税金及附加	-	-	-		-
经营利润	18,781.59	35,575.21	35,170.90		38,472.14
销售费用	1,690.41	3,412.31	3,445.39		3,516.58
管理费用	2,948.85	5,930.28	5,976.91		6,077.30
研发费用	2,866.66	5,757.14	5,796.43		5,881.01
财务费用	-	-	-		-
利润总额	11,275.67	20,475.49	19,952.17		22,997.26
所得税费用	2,255.13	4,095.10	3,990.43		4,599.45
净利润	9,020.53	16,380.39	15,961.74		18,397.80

(1) 营业收入

本项目主要产品为高多层板，包括 14 层以上高多层板，产品价格以当前市场价格及未来变化趋势作为主要测算依据，销售数量根据所建工厂的配套生产能力及未来市场需求预计来估算。建设期第 2 年预计达产 50%，建设期第 3 年预计全部达产，项目计算期内，达产后年销售收入 195,000.00 万元。

(2) 营业成本

项目营业成本包括原材料消耗费、直接人工费、制造费用、折旧费和燃料及动力费等。原材料消耗费参考主要原材料的市场现有价格；直接人工费根据项目拟投入人员数量，参照目前公司同岗位平均工资水平和当地人员薪酬水平，结合当地未来人工上涨的趋势进行估算；制造费用中折旧费根据项目新增固定资产金额，参考公司现行的会计政策计提，其他制造费用根据公司历史财务数据进行测

算。建设期第 3 年全部达产时的营业成本为 159,424.79 万元。

（3）期间费用

项目期间费用中的人工工资及福利根据项目拟投入人员数量，参照岗位平均工资水平结合未来涨幅趋势进行测算，其他费用根据公司历史财务数据中各项费用占营业收入的比例进行测算。建设期第 3 年全部达产时的年销售费用为 3,412.31 万元，管理费用为 5,930.28 万元，研发费用为 5,757.14 万元。

综上，本项目建设期 24 个月。项目全部达产后，预计实现年销售收入 195,000.00 万元。公司选用市场较为通行的 12% 作为折现率。经测算，项目静态投资回收期为 7.28 年（所得税后，含建设期），税后投资内部收益率为 14.30%。

3、效益指标的合理性

（1）募投项目与公司报告期毛利率对比

项目	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度	报告期平 均值	越南胜宏人 工智能 HDI 项目达产年	泰国高多层 印制线路板 项目达产年
毛利 率	33.37%	22.72%	20.70%	18.15%	23.74%	25.03%	18.24%

越南胜宏人工智能 HDI 项目达产年测算的毛利率为 25.03%，高于公司报告期毛利率平均值 23.74%，主要原因系该募投项目产品为更高端的高阶 HDI 产品，产品价值量高。

泰国高多层印制线路板项目主要生产高多层板，包括 14 层以上高多层板，该募投项目达产年测算的毛利率为 18.24%，低于公司报告期毛利率平均值 23.74%，效益预测较为谨慎合理。

因此，公司本次募投项目达产年测算的毛利率与公司经营情况相匹配，效益指标测算合理。

（2）募投项目效益测算与可比项目对比

公司与同行业可比公司过往募投建设项目对比情况如下：

公司名称	项目定位	项目名称	达产年毛 利率(%)	静态投资回 收期(税后， 含建设期， 年)	内部投资 收益率 (税后)
骏亚科技	工业控制	年产 80 万平方米智能互联高 精密线路板项目	20.48%	7.37	18.13%
兴森科技	/	广州兴森快捷电路科技有限	-	7.17	10.21%

公司名称	项目定位	项目名称	达产年毛利率(%)	静态投资回收期(税后,含建设期,年)	内部投资收益率(税后)
		公司二期工程建设项目目 ——刚性电路板项目			
兴森科技	5G 通信、服务器和光模块	宜兴硅谷印刷线路板二期工程 项目目——年产 96 万平方米 印刷线路板项目	20.83%	7.13	16.53%
崇达技术	/	珠海崇达电路技术有限公司 新建电路板项目（一期）	28.26%	7.82	12.41%
崇达技术	通信、服务器、智能手机、消费电子	珠海崇达电路技术有限公司 新建电路板项目（二期）	27.02%	8.07	10.07%
世运电路	汽车电子、服务器、5G 通讯、工业控制	鹤山世茂电子科技有限公司 年产 300 万平方米线路板新 建项目（二期）	23.92%	-	-
博敏电子	5G 通信、服务器、Mini LED、工控、新能源汽车	博敏电子新一代电子信息产 业投资扩建项目（一期）	22.81%	-	-
四会富仕	工业控制、汽车电子	年产 150 万平方米高可靠性 电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）	20.69%	5.46	21.07%
科翔股份	新能源汽车、消费电子、通信和工业控制	江西科翔印制电路板及半导 体建设项目（二期）	25.16%	6.39	15.28%
景旺电子	手机、消费电子、5G 通信设备、汽车电子、Mini LED	年产 60 万平方米高密度互连 印刷电路板项目	-	8.99	13.70%
鹏鼎控股	汽车电子、服务器	年产 338 万平方英尺汽车板 及服务器板项目	-	6.21	15.73%
金禄电子	汽车电子	新能源汽车配套高端印制电 路板建设项目	-	5.43	26.65%
广合科技	服务器、消费电子	多高层精密线路板项目一期 第二阶段工程	-	6.75	16.60%
澳弘电子	家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子	年产高精密度多层板、高密度 互连积层板 120 万平方米建 设项目	-	6.27	25.80%
胜宏科技	/	高端多层、高阶 HDI 印制线 路板及 IC 封装基板建设项目	27.50%	6.27	19.49%
中富电路	工业控制、汽车电子、消费电子	年产 100 万平方米印制线路 板项目	21.83%	7.52	15.55%
满坤科技	/	吉安高精密印制线路板生产 基地建设项目	25.47%	6.57	19.91%
特创科技	工控新能源、汽车电子	前次募投	23.39%	7.96	13.28%

公司名称	项目定位	项目名称	达产年毛利率(%)	静态投资回收期(税后,含建设期,年)	内部投资收益率(税后)
行业平均			23.95%	6.96	16.90%
胜宏科技	人工智能	越南胜宏人工智能 HDI 项目	25.03%	7.69	15.18%
胜宏科技	服务器、交换机、消费电子	泰国高多层印制线路板项目	18.24%	7.28	14.30%

如上表所示，越南胜宏人工智能 HDI 项目预测达产年毛利率、内部投资收益率和静态回收期均接近同行业公司平均水平，属于合理区间；泰国高多层印制线路板项目由于产品结构差异，预测达产年毛利率、内部收益率低于同行业公司平均水平，静态回收期接近同行业公司平均水平，属于合理区间。因此，公司本次募投项目的效益测算较为谨慎、合理。

4、因实施募投项目而新增的折旧对发行人未来经营业绩的影响

发行人本次募投项目为越南胜宏人工智能 HDI 项目、泰国高多层印制线路板项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目。其中，越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目为建设项目，涉及规模较大的建设工程和设备采购等资本性支出，上述两个项目的实施将新增相应的固定资产。

本次发行募集资金投资项目实施后，随着资产规模的增加，折旧金额也有较大幅度增加。按照公司现行的资产折旧政策，本次募集资金投资项目建成后本公司每年新增折旧金额为 24,696.13 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	资产类别	年折旧金额
越南胜宏人工智能HDI项目	房屋及建筑物	1,609.39
	机器设备等	11,786.62
泰国高多层印制线路板项目	房屋及建筑物	677.09
	机器设备等	10,623.03
合计		24,696.13

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月，公司分别实现营业收入 788,515.46 万元和 793,124.76 万元、1,073,146.95 万元和 431,234.09 万元，利润总额分别为 89,726.28 万元、74,921.40 万元、131,182.31 万元和 108,737.24 万元，本次募投项目建成后，预计新增的折旧为 24,696.13 万元/年，占 2022 年-2024 年公司年平均利润总额的比例约为 25%。考虑到本次募投项目未来全部投产后，预

计新增净利润 41,941.80 万元/年，效益较高。

综上，本次募集资金因募投项目而新增的折旧不会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。

（六）本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

1、本次募投项目与公司既有业务的区别和联系

本次募投项目与公司既有业务的区别和联系参见本节“二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系”。

2、本次募投项目与前次募投项目的区别和联系

公司前次募集资金原投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	298,946.52	148,534.33
2	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		348,946.52	198,534.33

公司前次募投项目发生变更，变更情况具体参见“第五节 历次募集资金的使用情况”之“二、前次募集资金实际使用情况说明”之“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”，变更完成后，前次募集资金投资项目的具体投资情况如下：

序号	项目名称	变更后拟使用募集资金金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	18.66	项目终止
2	永久性补充流动资金	10,000.00	不适用
3	支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价	138,515.67	项目完成
4	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	不适用
合计		198,534.33	-

如上表所示，公司前次募集资金主要用于支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价项目，公司完成了对 PSL100%股权收购，并通过 PSL 间接持有 MFS 集团 100%的股权，MFS 集团是全球领先的软板制造商。通过收购 PSL，公司形成了覆盖刚性电路板（多层板和 HDI 为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、软硬结合板）的全系列 PCB 产品组合，进一步丰富公司产品结构，提升公

司整体竞争力。

公司本次募投项目“越南胜宏人工智能 HDI 项目”和“泰国高多层印制线路板项目”均围绕公司 PCB 主业，在海外布局高阶 HDI 及高多层板产能，升级装备能力，创新生产技术和工艺，以打造引领行业的创新旗舰产品，满足人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等卡脖子领域的高等级要求，有利于提升公司的核心竞争力。

综上，公司前次募投项目主要是布局软板产能，本次募投项目系扩大硬板产能（高阶 HDI 及高多层板），所布局的 PCB 产品不同，产品功能存在差异，但均能进一步丰富和优化公司产品结构，有利于提升公司整体竞争力，不存在重复建设的情形。

（七）本次募投项目是否符合国家产业政策

公司专业从事印制线路板研发、生产和销售，本次募集资金投资项目拟用于越南胜宏人工智能 HDI 项目、泰国高多层印制线路板项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目，均投向主业。公司的主营业务及本次募投项目相关产品属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3982 电子电路制造”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司所在行业符合国家产业政策，是国家长期重点支持发展的行业。公司本次募集资金投资项目产品为《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等电子产品用材料，属于鼓励类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类、淘汰类项目。

综上，公司本次募集资金投资项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类项目，符合国家产业政策要求，已取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》和广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》，不存在其他需要取得主管部门意见的情形。

四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

公司多年来专注于印制线路板产品的研发、生产和销售，积累了大量的技术

与经验，具备较强的技术研发创新能力和生产管理能力和生产管理能力，为项目的顺利实施提供保障。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

（一）越南胜宏人工智能 HDI 项目

1、项目备案审批情况

越南胜宏人工智能 HDI 项目由全资子公司越南胜宏实施。越南胜宏已完成企业设立登记并取得越南北宁省工业园区管理委员会颁发的《投资登记许可证》（项目代码：5411825000）。公司已就对越南胜宏投资建设的事项，取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函[2024]1094号）、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202400656号），以及中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行出具的《业务登记凭证》（业务类型：ODI 中方股东对外义务出资）。

2、项目土地使用权取得情况

（1）募投项目使用租赁土地的原因及合理性

越南胜宏人工智能 HDI 项目用地位于越南北宁省，项目实施主体为越南胜宏。越南工业土地出让模式通常为各省的工业区管理局下设的工业区股份公司与用地企业签署长期租赁合同后，由土地出租方将土地使用权转租予用地企业，并由该用地企业取得土地使用权证书。

（2）租赁土地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划

2024 年 9 月 10 日，越南胜宏与 VSIP 签署了土地使用权租赁协议（编号：31-24/CN.13.2/LA IP-BN2/VSIPBN），具体情况如下：

募投项目名称	越南胜宏人工智能 HDI 项目
出租方	VSIP BAC NINH CO., LTD

承租方	越南胜宏
租赁面积（m ² ）	103,626 m ²
土地用途	工业用地
使用年限	至 2069 年 1 月 22 日
租用年限	2024 年 9 月 10 日至 2069 年 1 月 22 日
租金	①租金（Rental Price）：4,142.19 亿越南盾，于土地使用权证移交前支付完毕； ②租金（Land Rent Charge）：自 2032 年 5 月 1 日起，越南胜宏需向 VSIP 支付年租金。年租金基于当地主管部门设定的同一类型土地的参考单价和土地面积来计算。
到期后对土地的处理计划	根据越南《土地法》第 126 条的相关规定，越南胜宏向 VSIP BAC NINH CO., LTD 租赁的土地租期（2069 年 1 月 22 日）到期后，可申请延期（延期最多 50 年）

（3）土地使用权取得情况

截至本募集说明书签署日，VSIP 已将租赁项目地块交付给越南胜宏，越南胜宏已取得该租赁项目地块的土地使用权证。

3、项目环评情况

截至本募集说明书签署日，越南胜宏人工智能 HDI 项目已取得越南北宁省人民委员会颁发的《环保许可证》（第 252/GPMT-UBND 号），已完成该募投项目环评相关程序。

（二）泰国高多层印制线路板项目

泰国高多层印制线路板项目由泰国全资子公司泰国胜宏实施。泰国胜宏系公司 2024 年 9 月收购的主体，拥有完整的业务资质。该项目系在原有土地上改扩建，不涉及购买或租赁募投用地事项。公司已就增资泰国胜宏进行产能升级扩建的事项，取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函[2024]1437 号）、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（原为境外投资证第 N4400202400857 号，泰国子公司更名后变更为境外投资证第 N4400202500028 号），以及中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行出具的《业务登记凭证》（业务类型：ODI 中方股东对外义务出资）。

根据 DFDL (Thailand) Limited 出具的《泰国胜宏法律意见书》，泰国胜宏不需要向泰国自然资源与环境政策规划办公室提交环境影响评估报告，也不需要履行其他环境影响评价相关程序；泰国胜宏在现有土地上进行产能升级扩建也无需向泰国自然资源与环境政策规划办公室提交环境影响评估报告或履行其他环境

影响评价相关程序。

根据 DFDL (Thailand) Limited 出具的《泰国胜宏法律意见书》，泰国胜宏持有所有必要的经营许可证。

本次募集资金投资项目不存在尚需履行的程序及重大不确定性。

六、本次募集资金用于研发投入的情况

公司本次募投项目为“越南胜宏人工智能 HDI 项目”、“泰国高多层印制线路板项目”和“补充流动资金和偿还银行贷款”，不涉及研发项目，亦不涉及研发投入资本化的情形。

七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕高技术应用领域展开布局，面向人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片等国家战略需求，符合国家相关的产业政策，项目的实施有利于促进公司现有主营业务的持续健康发展，在国际市场打造领先的研发和交付能力，深度参与英伟达等国际客户的全球供应网络，进一步提高公司的核心竞争力和国际化运营能力，符合公司长远发展战略。本次募集资金投资项目实施后将进一步提升公司盈利能力，巩固并提高公司在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

1、增大公司总资产与净资产规模

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增大，资本结构将得到优化，资金实力将大幅提升，财务费用有望得到节降，为公司后续发展提供有力保障。

2、改善资产负债结构，提升财务健康度水平

本次发行完成后，公司的资本金得到进一步充实，资产负债结构优化，偿债能力将显著提高，财务健康度水平将有效提升。

八、募集资金使用可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票的募集资金使用计划符合公司的战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的使用，

是公司面向国家战略需求，布局高技术应用领域的必要路径，也是抢抓重大战略机遇，培育新质生产力的重要举措，有利于公司高质量发展，提升国际化竞争力，同时解决公司快速发展的营运资金需求，提升财务健康度水平，符合公司及全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金是必要且可行的。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目，以及补充流动资金和偿还银行贷款。募集资金投向围绕公司 PCB 主业，在海外布局高阶 HDI 及高多层板产能，升级装备能力，创新生产技术和工艺，以打造引领行业的创新旗舰产品，满足人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等卡脖子领域的高等级要求，有利于提升公司的核心竞争力。补充流动资金和偿还银行贷款项目有利于增强公司资金实力，优化财务结构，提升财务健康度水平。

本次向特定对象发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及业务和资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

二、本次发行后公司控制权结构的变化

本次发行前，截至本募集说明书签署日，公司控股股东胜华欣业持有公司 15.63% 的股份，香港胜宏持有公司 15.24% 股权，陈涛持有胜华欣业 90% 的股权并间接持有香港胜宏 70% 的股权，合计控制公司 30.87% 的表决权，间接持有公司 24.74% 的股权，系公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的 30%，即不超过 257,292,863 股（含本数）。若本次向特定对象发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本 1,119,981,504 股，原有股东持股比例将有所稀释；在本次发行后，胜华欣业持有公司 12.04% 的股份，香港胜宏持有公司 11.74% 的股份，陈涛控制公司 23.78% 的表决权，仍为公司实际控制人。

因此，本次发行不会导致公司控制权结构发生变化。

三、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终确定发行对象时，将对发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务进行背景调查，避免出现上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事

的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

四、发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在与发行人存在关联关系的发行对象，以及与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在关联交易的情形，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

第五节 历次募集资金的使用情况

一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

截至本募集说明书签署日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金到账已满五个会计年度，募集资金已使用完毕并销户。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金情况

截至本募集说明书签署日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金到账已满五个会计年度，募集资金已使用完毕并销户。

（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。

前次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，前次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 号验资报告。

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金实施专户存储，公司、保荐人分别与开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，报告期内公司《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金净额		198,534.33	已累计使用募集资金总额		207,973.73							
			各年度使用募集资金总额		207,973.73							
变更用途的募集资金总额		148,515.67	2021 年		51,842.93							
变更用途的募集资金总额比例		74.81%	2022 年		192.49							
			2023 年		148,042.26							
			2024 年		7,896.05							
			2025 年 1-3 月		0							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	150,000.00	148,534.33	18.66	150,000.00	18.66	18.66		项目终止		
		永久性补充流动资金（注 1）			17,896.05				10,000.00	17,896.05	7,896.05	不适用
		支付收购 PoleStar Limited 100% 股权			140,000.00				138,515.67	140,000.00	1,484.33	项目完成

		部分对价（注2）								
2	补充流动资金和偿还银行贷款	补充流动资金和偿还银行贷款（注3）	50,000.00	50,000.00	50,059.02	50,000.00	50,000.00	50,059.02	59.02	不适用
合计			200,000.00	198,534.33	207,973.73	200,000.00	198,534.33	207,973.73	9,439.40	

注1：“永久性补充流动资金”项目截止2025年3月31日实际投资金额比募集后承诺投资金额多7,896.05万元，系公司于2023年12月8日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 PoleStar Limited 100% 股权部分对价”结项，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

注2：“支付收购 PoleStar Limited 100% 股权部分对价”项目截至2025年3月31日实际投资金额比募集后承诺投资金额多出1,484.33万元，系使用了募集资金累计产生的利息及理财收益。

注3：“补充流动资金和偿还银行贷款”项目截至2025年3月31日实际投资金额比募集后承诺投资金额多出59.02万元，系使用募集资金的利息收入。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司向特定对象发行股票募集资金原投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	298,946.52	148,534.33
2	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		348,946.52	198,534.33

1、终止部分募集资金投资项目

2022 年由于宏观经济增速、国际环境等多方面影响，公司所处 PCB 行业的短期需求暂时放缓。2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次终止部分募集资金投资项目为高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目，终止项目涉及的募集资金金额为 148,534.33 万元，占向特定对象发行募集资金净额的比例为 74.82%。

2、补充流动资金

为满足公司主营业务快速发展的流动资金需求，提高募集资金使用效率，缓解运营资金压力，降低财务杠杆，增强企业抗风险能力，维护上市公司和股东的利益，2023 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。本次变更投向的总金额占公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金总额的比例为 5%。

3、收购 Pole Star Limited100%股权

为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 PoleStarLimited100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole Star Limited100%股权部分

对价”。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。本次使用部分募集资金金额占公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金总额的比例为 69.26%。

以上变更完成后，募集资金投资项目的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更后拟使用募集资金金额
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	18.66
2	永久性补充流动资金	10,000.00
3	支付收购 Pole Star Limited100%股权部分对价（注）	138,515.67
4	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00
合计		198,534.33

注：“支付收购 PoleStarLimited100%股权部分对价”项目使用募集资金及利息实际金额以支付收购对价当日募集资金专户余额为准，因银行存款结息存在滞后性，支付时存在少量利息尚未到账的情形，相关利息将用于补充流动资金。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited100%股权部分对价”结项，将剩余募集资金 7,428.19 万元（截至 2023 年 12 月 8 日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已将剩余募集资金 7,896.05 万元全部转出并用于永久性补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2021 年 11 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件。

2023 年 2 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了保本型理财产品，累计取得收益（含利息收入）93,943,312.18 元，到期赎回的本金和理财收益均归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司无闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目终止
支付收购 Pole Star Limited 100% 股权部分对价	不适用	/	不适用	14,227.89	30,415.41	44,643.30	是
永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金和偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：胜宏科技收购 Pole Star Limited 100% 股权时未设置业绩承诺或补偿安排，“支付收购 Pole Star Limited 100% 股权部分对价”项目承诺效益参考《Pole Star Limited 股东全部权益价值资产评估报告》中收益法评估下的收益预测：2023 年营业收入 204,199.83 万元，净利润 13,930.56 万元；2024 年营业收入 255,677.75 万元，净利润 19,130.04 万元（评估报告预测的营业收入及净利润以美元为单位，已采用当期平均汇率折算为人民币）。

胜宏科技收购 Pole Star Limited 的合并日为 2023 年 11 月 30 日，选取 2023 年、2024 年全年数据，是为与收益预测期间一致。

计算实际效益时，对于 2023 年 11 月 30 日前购入资产所产生的折旧摊销费用所依据

的资产价值为其在原最终控制方财务报表中的账面价值，以保持与收益预测基准年度已审数的可比性，未考虑并购日评估增值对于折旧/摊销的影响。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

永久性补充流动资金项目有利于提高资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。由于该项目并不直接产生收益，故无法单独核算效益。

支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价项目丰富了公司的产品结构，提升公司整体竞争力，在满足客户多种需求的同时，进一步分散公司经营风险，提高公司抗风险的能力，本次收购契合公司发展战略，在客户资源、供应链、技术等多方面产生协同效应，该战略投资对公司具有重要意义。本次收购完成后，标的公司产生的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。公司收购 Pole Star Limited 100%股权时未设置业绩承诺或补偿安排，参考《Pole Star Limited 股东全部权益价值资产评估报告》中收益法评估下的收益预测对支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价项目效益实现情况进行分析。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司前次募集资金不存在累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、会计师对于前次募集资金运用所出具的报告结论

关于公司前次募集资金运用，公司编制了前次募集资金使用情况的专项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了前次募集资金使用情况鉴证报告（信会师报字[2025]第 ZC10257 号），认为“胜宏科技截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了胜宏科技截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况”。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、与本次向特定对象发行的相关风险

（一）本次发行的审批风险

本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、2024年第二次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过、**深圳证券交易所审核通过**。本次向特定对象发行股票方案尚需中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。

（二）股票市场价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、股票市场投机行为、投资者心理预期等诸多因素的影响，可能给投资者带来损失。此外，本次向特定对象发行需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间公司股票的市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定风险。

二、境外收入波动的风险

报告期内，公司境外销售收入分别为 490,583.36 万元、487,633.43 万元、653,282.61 万元和 338,055.58 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 65.49%、65.38%、65.00%和 82.95%，占比较高，境外销售是公司收入的重要来源，境外收入的波动会给公司整体收入水平带来较大的影响。公司境外销售收入可能面临国际贸易摩擦、市场竞争激烈、相关国家或地区政策法规变动、汇率波动等因素影响，导致境外销售收入波动进而对公司业绩产生不利影响。

三、募集资金投资项目风险

（一）募投项目投产后的新增产能消化风险

公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业，在海外布局高阶 HDI 及高多层板产能。本次募集资金投资项目达产后，公司计划新增高阶 HDI 产能 15 万 m^2 /年，占公司 2024 年 HDI 产能的比例为 16.13%；以及高多层板产能 150 万 m^2 /年，占公司 2024 年双面/多层板产能的比例为 17.34%。公司对本次发行募集资金投资项目的新增产能规划和可行性研究是在目前市场环境及行业发展趋势、客

户需求和公司技术能力等基础上进行的，若上述因素发生重大不利变化，或宏观经济导致行业下行，则公司可能出现无法按原计划顺利实施该等募集资金投资项目，或该等项目的新增产能无法有效消化的风险。

（二）募投项目效益不达预期的风险

公司本次募投项目在境外实施，泰国高多层印制线路板项目和越南胜宏人工智能 HDI 项目预计达产后可分别实现年营业收入 195,000.00 万元和 165,000.00 万元，达产年毛利率分别为 18.24%和 25.03%，效益的测算基于现有的原材料价格、当地和外派人工薪酬水平、历史费用水平、当地税收政策及汇率情况。

募投项目生产所需原材料主要从中国国内进口，随着募投项目的实施推进及当地产业链配套的逐步完善，公司将结合采购成本、交期、材料品质等方面的考虑，从当地采购部分原材料。若未来在募投项目投产后，主要原材料对应大宗商品价格大幅上涨导致原材料市场价格出现剧烈波动且公司无法将价格及时传导至下游厂商、国际物流成本大幅提升、贸易政策发生不利变化，会使得募投项目的成本增加。若募投项目实施地人力资源成本及其他费用水平大幅提升、税收政策发生不利变化或汇率出现大幅不利波动，会使得募投项目的费用增加。该等情形均会导致项目利润水平下降，进而导致募投项目存在效益未达预期的风险。

（三）境外实施募集资金投资项目的风险

本次募集资金投资项目包括越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目，分别以越南胜宏和泰国胜宏作为募投项目实施主体。境外业务开展受当地法律法规、政治局势、经济政策等多种因素影响，若公司无法及时应对境外市场变化，或境外投资政策、税收政策等发生重大不利变化，公司的境外募投项目将面临无法按期实施或无法实现预期效益的风险。

（四）募集资金购置长期资产导致公司折旧费用增加的风险

公司本次募投项目越南胜宏人工智能 HDI 项目和泰国高多层印制线路板项目为建设项目，涉及规模较大的建设工程和设备采购等资本性支出，上述两个项目的实施将新增相应的固定资产，折旧金额相应增加。按照公司现行的资产折旧政策，本次募集资金投资项目建成后公司每年新增折旧金额为 24,696.13 万元，占公司 2022 年-2024 年年均利润总额的比例低于 26%，且公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果未来行业政策或市场环境发生重大变化，

导致募集资金投资项目不能实现预期收益，则新增固定资产折旧将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

（五）募投项目人员、技术、市场储备不足及产业链配套情况变化风险

公司已对本次募投项目的必要性及可行性进行审慎分析论证，并针对项目实施在人员、技术、市场等方面完成了必要的前期规划和积累，对募投项目实施地的产业链配套情况进行了充分的研判。实施募投项目不存在重大不确定性，不会影响公司整体发展。但若募投项目实施过程中市场环境、客户需求、行业技术路线、募投实施地经营环境等出现重大不利变化，公司可能存在因人员、技术、市场储备不足或产业链配套无法满足公司经营需求导致募投项目实施进度不及预期或无法实施的风险。

（六）募投项目终止风险

在 PCB 行业进入新一轮增长周期的背景下，公司本次募投项目具备可行性。但是在多变的国际经济环境下，如果宏观经济发生剧烈波动或严重衰退，或贸易流通严重受限，将导致包括公司在内的 PCB 企业面临一定的行业波动风险。若公司经充分研判后，确定募投项目继续实施将会给公司带来巨大的经济损失、损害投资者利益，公司存在募投项目终止风险。

（七）募投项目实施风险

公司结合当前行业发展情况、公司发展战略等因素对募集资金投资项目进行了审慎、充分的调研、论证和可行性分析，但本次募集资金投资项目在实施过程中仍面临市场供求变化、行业竞争情况变化、技术更新等诸多不确定因素，存在本次募集资金投资项目不能按时顺利完成或项目实施效果不达预期的风险。

（八）募投项目租赁地块到期无法续租的风险

越南胜宏人工智能 HDI 项目用地位于越南北宁省，项目实施主体为越南胜宏。截至本募集说明书签署日，越南胜宏已与 VSIP BAC NINH CO., LTD 签署了土地使用权租赁协议，VSIP 已将租赁项目地块交付给越南胜宏，越南胜宏已取得租赁项目地块的土地使用权证。

根据双方签署的土地使用权租赁协议及越南胜宏取得的土地使用权证，越南胜宏租赁的项目地块租赁期限至 2069 年 1 月 22 日。根据越南《土地法》第 126 条的相关规定，越南胜宏向 VSIP BAC NINH CO., LTD 租赁的土地租期到期后，

可申请延期（延期最多 50 年），预计不会对公司未来生产经营的持续性产生重大不利影响，但仍存在租赁到期后无法续租的风险。

（九）即期回报被摊薄的风险

本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，募集资金投资项目释放经济效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

四、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔，2024 年原材料成本占营业成本比重为 62.67%，原材料成本占比较高，是公司产品定价的重要影响因素之一。原材料大幅涨价的情形下，公司会相应提高产品售价，但向下游的传导存在一定滞后。公司原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大，2023 年和 2024 年，LME 铜现货平均结算价分别较上年同期变动-3.63%和 7.90%。若未来原材料对应大宗商品价格大幅上涨导致原材料价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

五、商誉减值风险

2025 年 3 月末，公司商誉账面价值为 121,567.43 万元，占公司总资产的比例为 5.81%，为公司 2023 年收购 PSL 100%股权时形成的商誉 116,877.05 万元和公司 2024 年收购泰国胜宏 100%股权时形成的商誉 4,690.38 万元，暂未发生减值情形。未来，若 PSL 相关的 MFS 资产组和泰国胜宏资产组出现经营不善或其他重大不利变化的情形，导致业绩不及预期，上述商誉存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

六、汇率波动对业绩产生不利影响的风险

公司外销收入的金额较大，外销客户的区域包括中国台湾、中国香港、东南亚及美国等地区，主要以美元和港币结算，受到汇率波动的影响。虽然公司采用

远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

报告期各期，公司汇兑损益分别为-11,104.59万元、-1,173.07万元、-7,815.65万元和-1,355.58万元，波动较大。由于汇率受到全球政治、经济环境等多种因素的影响，存在一定的不确定性，若未来汇率出现较大波动，且公司未对汇率风险采取有效措施进行管理，将对公司业绩产生不利影响。

七、应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为261,657.38万元、320,579.06万元、388,660.39万元及480,401.66万元，整体应收账款金额较高。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款的增长将加大公司的营运资金周转压力；同时，如果下游行业或主要客户的经营状况发生重大不利变化，公司可能面临坏账损失影响整体利润的风险。

八、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为112,447.32万元、137,683.40万元、204,540.33万元和233,010.37万元，整体存货金额较高。较高的存货金额对公司流动资金占用较大，可能导致一定的存货积压风险，且由于近年来宏观经济存在一定波动且市场竞争有可能加剧，若未来遇到管理不善或者客户需求发生重大变动，公司可能面临存货跌价损失影响整体利润的风险。

九、流动比率及速动比率较低、资产负债率较高导致的偿债风险

截至2025年3月31日，公司借款规模较高，公司流动比率、速动比率分别为1.18、0.88，低于同行业可比公司平均水平，公司资产负债率为52.54%，高于同行业可比公司平均水平。如公司未来经营状况发生重大变化导致财务状况恶化，将对公司偿债能力产生不利影响。

十、无形资产摊销风险

公司于2023年11月30日收购PSL 100%股权，合并日无形资产价值为72,569.37万元。2023年12月，公司对收购PSL公司所得无形资产计提摊销282.74万元，年化后摊销金额为3,392.85万元，占2023年利润总额的比例为4.53%，占2024年利润总额的比例为2.59%，占比较小。如公司未来经营状况发生重大

不利变化,收购 PSL 所得无形资产摊销费用将对公司的经营业绩产生不利影响。

十一、管理风险

本次募集资金投资项目实施后,公司将面临更加具有深度和广度的国际化经营布局,生产和办公场所覆盖中国、马来西亚、泰国、越南等多个国家,对公司管理团队的能力提出更高要求,公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也面临更大的挑战。如公司不能高质量实施全球化战略,国际化运营能力与业务布局不匹配,将可能面临一定的管理风险。

十二、境外投资风险

为了建立全球化配套能力,更好地服务客户,公司在境外收购或设立了 PSL、越南胜宏、泰国胜宏等子公司。公司境外投资规模的进一步扩大,对公司境外子公司的管理能力提出更高的要求。境外子公司所在国在政治、经济、文化、法律等方面与我国存在较大差异,若境外市场发生重大不利变化或公司未及时组建具有国际化视野的管理团队,将可能导致境外子公司经营不善,进而影响公司业绩。

十三、宏观经济波动的风险

公司的主营业务为印制线路板的研发、生产和销售,产品包括高端多层板、HDI 板、FPC、软硬结合板等。作为电子信息产业的一种核心基础组件,PCB 行业的发展与电子信息产业发展以及宏观经济景气度紧密联系,特别是随着电子信息产业国际化程度的日益提高,PCB 需求深受国内、国际两个市场的影响。如果国际、国内宏观经济形势以及国家的财政政策、货币政策、贸易政策等宏观政策发生不利变化或调整,将对公司经营业绩产生不利影响。

十四、市场竞争风险

PCB 行业内企业众多,市场竞争较为激烈,日益呈现“大型化、集中化”的趋势。快速发展的下游行业和稳定合作的优质客户是公司持续发展的重要保证。如果宏观经济波动等因素导致下游需求减少,或 AI 等行业技术路线发生变化,进而导致市场竞争加剧且公司未能提升自身市场竞争力,或公司未能保持在产品性能、可靠性、交付能力等方面的优势导致订单减少,或公司不能充分抓住市场机遇,在产品开发、市场策略等方面及时适应市场需求及竞争状况,公司的市场竞争优势将可能被削弱,并面临市场份额下降或被竞争对手超越的风险。

十五、人工成本上升的风险

随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受到负面影响。

第七节 有关声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：



陈涛

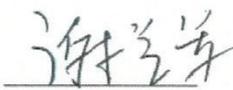
刘春兰



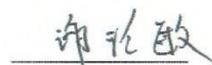
陈勇



赵启祥



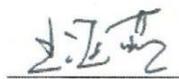
谢兰军



谢玲敏

张继海

全体监事签名：



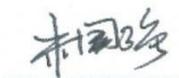
王海燕

魏军义



王耘

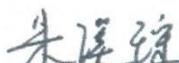
其他高级管理人员签名：



朱国强



王辉



朱溪瑶



周定忠



Victor J. Taveras

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年7月18日

第七节 有关声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈 涛

刘春兰

陈 勇

赵启祥

谢兰军

谢玲敏



张继海

全体监事签名：

王海燕

魏军义

王 耘

其他高级管理人员签名：

朱国强

王 辉

朱溪瑶

周定忠

Victor J. Taveras

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年7月18日

第七节 有关声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 陈 涛	_____ 刘春兰	_____ 陈 勇
_____ 赵启祥	_____ 谢兰军	_____ 谢玲敏
_____ 张继海		

全体监事签名：

		
_____ 王海燕	_____ 魏军义	_____ 王 耘

其他高级管理人员签名：

_____ 朱国强	_____ 王 辉	_____ 朱溪瑶
_____ 周定忠	_____ Victor J. Taveras	

胜宏科技（惠州）股份有限公司

 2025 年 7 月 18 日

第七节 有关声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：



陈 涛

刘春兰

陈 勇

赵启祥

谢兰军

谢玲敏

张继海

全体监事签名：

王海燕

魏军义

王 耘

其他高级管理人员签名：

朱国强

王 辉

朱溪瑶

周定忠

Victor J. Taveras

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年 7 月 18 日

控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东签名：深圳市胜华欣业投资有限公司（盖章）

控股股东法定代表人：



陈涛

实际控制人签名：

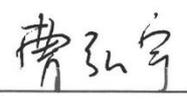


陈涛

2025年7月18日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

曹弘宇

保荐代表人：
 
张 茜 郭振国

法定代表人：

张纳沙



保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读胜宏科技（惠州）股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



邓 舸

董事长：



张纳沙



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：

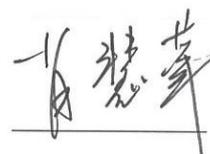


华晓军

经办律师签名：



蒋文俊



肖慧萍



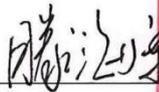
北京市君合律师事务所
2025年7月18日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读胜宏科技（惠州）股份有限公司(以下简称“发行人”)募集说明书，确认募集说明书与本所出具的 2023 年度、2024 年度审计报告（报告文号为：信会师报字[2024]第 ZC10270 号、信会师报字[2025]第 ZC10197 号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对募集说明书中引用的经本所审计的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

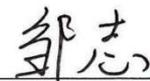
本声明仅供发行人申请面向特定对象发行股份之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

经办注册会计师（签字）：_____



滕海军





邹志



会计师事务所负责人（签字）：_____



杨志国



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所
(特殊普通合伙)

2025年07月

日



发行人董事会声明

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划及行业发展趋势，同时结合公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他除本次向特定对象发行股票外的股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报所采取的措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行后，公司的总股本规模将增加，导致每股收益可能会在短期内出现小幅下降的情况，为了填补被摊薄即期回报，公司决定采取如下措施：

1、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

2、加快募投项目实施进度，提高资金使用效率

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，该项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提

高资金使用效率，争取募投项目尽快达产并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加强募集资金管理，保证募集资金规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效。根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次向特定对象发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，以保证募集资金合理规范使用。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保护公众投资者的合法权益。

公司提醒投资者，以上填补回报措施不代表对公司未来利润任何形式的保证，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

- 2、对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（三）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺

公司控股股东深圳胜华、实际控制人陈涛先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

- “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
- 3、公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 4、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”

（本页无正文，为本募集说明书《发行人董事会声明》之盖章页）

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025年7月18日

附件一 自有房地产清单

一、境内自有房地产

序号	类别	权利人	证书编号	坐落	用途	建筑/土地面积 (m ²)
1	房产	胜宏科技	粤（2017）惠东县不动产权第 0024501、0024347、0024503、0024467、0024455、0024470、0024472、0024365、0024505、0024516 号	巽寮村海滨公路下侧海公元商住小区 J 栋 12 层 01-10 号房	住宅	合计 736.94
2	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032696 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号仓库二	仓库	34,108.94
3	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032649 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂房二	厂房	83,743.71
4	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107284 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂区厂房六	厂房	24,548.30
5	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032650 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂房三	厂房	67,650.31
6	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032654 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂房五	厂房	15,974.06
7	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032694 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号（A1 幢）	厂房	31,652.26
8	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107365 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号地下室	地下室车库	6,037.38
9	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032698 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号（B1 幢）	辅助楼	16,728.58
10	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107356 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂区辅助楼二	辅助楼仓库	719.45
11	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032658 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号干部宿舍（C 栋）	员工宿舍	7,192.89
12	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032686 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号干部宿舍（D 栋）	员工宿舍	7,028.00
13	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107353 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂区干部宿舍加建员工餐厅	员工餐厅	1,625.15
14	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107360 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号厂区危废仓库	危废仓库	368.66
15	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107374 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号研发中心办公楼二	研发中心办公楼二	5,566.24

序号	类别	权利人	证书编号	坐落	用途	建筑/土地面积 (m ²)
16	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107376 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号研发中心办公楼三	研发中心办公楼三	18,052.62
17	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3107371 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号研发中心办公楼一	研发中心办公楼一	14,329.85
18	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032681 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号（C1 幢）	员工宿舍	13,851.77
19	房产	胜宏科技	粤（2024）惠州市不动产权第 3032648 号	惠州市惠阳区淡水街道新乐大道 13 号生产应急水池	生产应急水池	1,925.85
20	房产	胜宏科技	粤（2022）惠州市不动产权第 3046575 号等共 128 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 4 幢 2-33 层共 128 套房	员工宿舍	合计 14,369.28
21	房产	胜宏科技	粤（2022）惠州市不动产权第 3040397 号等共 156 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 6 幢 1 单元 1-32 层共 156 套房	员工宿舍	合计 14,618.36
22	房产	胜宏科技	粤（2022）惠州市不动产权第 3020235 号等共 126 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 6 幢 2 单元 1-32 层共 126 套房	员工宿舍	合计 13,748.30
23	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3004319 号等共 90 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 1 幢 1 单元 1-32 层共 90 套房	员工宿舍	合计 8,968.33
24	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3005280 号等共 118 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 1 幢 2 单元 1-33 层共 118 套房	员工宿舍	合计 12,836.43
25	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3001930 号等共 45 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 5 幢 1 单元 2-32 层共 45 套房	员工宿舍	合计 4,765.69
26	房产	胜宏科技	粤（2023）惠州市不动产权第 3001992 号等共 82 个房产证	惠州市惠阳区淡水街道新桥村排浪地段新乐大道 10 号珑禧花园 5 幢 2 单元 2-32 层共 82 套房	员工宿舍	合计 8,840.71
27	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0012908 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号	厂房	6,614.00

序号	类别	权利人	证书编号	坐落	用途	建筑/土地面积 (m ²)
28	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0013058 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号	门卫室	23.09
29	房产	维胜电路板	湘（2021）长沙县不动产权第 0029714 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号垃圾站 101 室	仓库	54.76
30	房产	维胜电路板	湘（2021）长沙县不动产权第 0029716 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号新建化学品仓库 101 室	仓库	513.24
31	房产	维胜电路板	湘（2021）长沙县不动产权第 0029717 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号新建危废仓库 102 室	仓库	1,403.83
32	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0012948 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号 101 室	厂房	9,170.94
33	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0012951 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号 101	厂房	4,416.25
34	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0012953 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号整栋	厂房	10,628.41
35	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0012955 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号整栋	食堂	1,463.44
36	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0013047 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号整栋	宿舍	2,665.52
37	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0013048 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号整栋	门卫室	21.87
38	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0013054 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号整栋	配电房	1,019.92
39	房产	维胜电路板	湘（2016）长沙县不动产权第 0013057 号	长沙经济技术开发区东二路 10 号整栋	厂房	1,294.79
40	房产	益阳维胜	湘（2021）资阳区不动产权第 0060425 号	益阳市资阳区长春经开区清水潭社区	厂房	20,204.09
41	房产	益阳维胜	湘（2021）资阳区不动产权第 0060427 号	益阳市资阳区长春经开区清水潭社区	仓库	1,166.40
42	房产	益阳维胜	湘（2021）资阳区不动产权第 0060428 号	益阳市资阳区长春经开区清水潭社区	厂房	3,300.73

序号	类别	权利人	证书编号	坐落	用途	建筑/土地面积 (m ²)
43	房产	益阳维胜	湘(2021)资阳区不动产权第0060430号	益阳市资阳区长春经开区清水潭社区	宿舍、食堂	453.81
44	房产	益阳维胜	湘(2021)资阳区不动产权第0060426号	益阳市资阳区长春经开区清水潭社区	厂房	448.00
45	房产	益阳维胜	湘(2021)资阳区不动产权第0060429号	益阳市资阳区长春经开区清水潭社区	厂房	4,608.00
46	房产	维胜电路板	湘(2024)长沙县不动产权第0040829号	长沙经济技术开发区东二路10号装配工厂-101等4套	厂房	7,774.21
47	地产	胜宏科技	惠阳国用(2012)第0101537号	惠阳区淡水新桥惠澳大道东行诚工业园	工业用地	217,480.00
48	地产	胜宏科技	惠阳国用(2014)第0101594号	惠阳区淡水新桥排浪地段	工业用地	17,817.00
49	地产	维胜电路板	长国用(2010)第(4527)号	长沙经开区金华路(东二路)	工业用地	90,590.00
50	地产	益阳维胜	湘(2019)资阳区不动产权第0000020号	益阳市资阳区长春镇清水潭村、新祝村	工业用地	107,211.30

注：上述第20-26项因购房按揭贷款而存在抵押情形，其他房地产均无他项权利。

二、境外自有房地产

序号	权利人	土地证编号	土地坐落	土地面积 (m ²)	建筑物
1	MFSM	43070	Lot 6324, Mukim Bachang, Daerah Melaka Tengah, Negeri Melaka (简称“Lot 5 Factory”)	22,800.00	生产工厂
2	泰国胜宏	71639	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	250.00	单层住宅房屋
3	泰国胜宏	71640	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	290.80	单层住宅房屋
4	泰国胜宏	54496	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	272.40	双层住宅房屋
5	泰国	46485	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya	1,577.20	四层住宅房屋

序号	权利人	土地证编号	土地坐落	土地面积 (m ²)	建筑物
	胜宏		Province		
6	泰国胜宏	46501	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	1,123.60	无
7	泰国胜宏	48712	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	600.00	无
8	泰国胜宏	48713	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	1,158.40	无
9	泰国胜宏	48716	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	1,025.20	无
10	泰国胜宏	56106	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	43,244.00	<p>单层建筑，用于工厂、办公、仓库和食堂；</p> <p>两座单层建筑，用作厕所；</p> <p>两座车库；</p> <p>道路、停车场、雨水排放系统、废水排放管道</p>
11	泰国胜宏	33636	Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province	32,112.00	<p>单层工厂建筑；</p> <p>雨水排水系统，废水排放管道</p> <p>建筑地基</p> <p>四层建筑，用作工厂、办公和仓库；</p> <p>单层建筑，用作厕所；</p> <p>停车建筑；</p> <p>地下储罐建筑；</p> <p>围栏、标识、道路和停车场、雨水排放系统、废水处理管道</p> <p>单层建筑，用于废水处理系统；</p> <p>双层建筑，用于娱乐（已拆除）；</p> <p>道路、雨水排水系统、废水排放管道</p>

序号	权利人	土地证编号	土地坐落	土地面积 (m ²)	建筑物
					修正：四层建筑，用于工厂、办公和仓库

注：上述第1项Lot 5 Factory的一部分自2001年8月1日起至2031年7月31日被租赁给Tenaga Nasional Berhad用于变电站的建设和维护，租约有效期为30年；其他房地产均无他项权利。

附件二 租赁房产清单

一、境内租赁房产

序号	承租人	出租人	用途	物业坐落	建筑面积 (m ²)	租赁到期 日
1	胜宏电子	深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	办公	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1806、1807、1808、2304 房	702.22	2025.11.30
2	胜华电子	马安镇新乐经济联合社	厂房及办公	马安镇新乐经济联合社新乐工业区	13,871.89	2033.11.30
3	胜宏精密	惠州市卓业产业园管理有限公司	厂房	惠州市惠阳区三和经济开发区中建电讯科技园(卓业科创产业园 A3 栋)A3 栋一至二楼	29,444	2027.6.15
4	胜宏精密	惠州市卓业产业园管理有限公司	厂房	广东省惠州市惠阳区三和经济开发区卓业科创产业园 A1、A2 栋一楼		2027.6.15
5	维胜科技	湖南和润祥企业运营管理有限公司	员工住宿	和祥科技园内和祥公寓(综合宿舍楼)二-六楼 129 间房	6,952.00	2025.12.31
6	益阳维胜	湖南安一保健品有限公司	员工住宿	资阳区五福路湖南安一保健品有限公司倒班宿舍 2 至 4 层	1,941.00	2025.12.31
7	维胜电路板	彭丹	员工住宿	沙湾路 289 号运达中央广场 4 栋 3104 房	179.21	2025.11.19
8	维胜电路板	李治云	员工住宿	北京市昌平区回龙观镇龙兴园小区 12 号楼 2 单元 501 号房	86.77	2025.12.31
9	益阳维胜	郭阿敏	员工住宿	益阳市资阳区帝景嘉园 12 栋 2002	121.00	2026.08.31
10	维胜科技	上海唐巢公共租赁住房运营有限公司	员工住宿	上海市浦东新区龚路支路 473 弄 4 号 603 室	75.51	2026.1.4
11	维胜科技	郭泽锋	员工住宿	成都市郫筒镇蜀信东路 18 号 23 栋 1 单元 7 楼 703 号	93.00	2026.1.7
12	胜宏精密	惠州市卓业产业园管理有限公司	厂房	惠州市惠阳区三和开发区卓业科创产业园(中建电讯科技园) A5 栋 1 楼 101、102、	13,000	2034.12.19

序号	承租人	出租人	用途	物业坐落	建筑面积 (m ²)	租赁到期 日
				A5 栋 2 楼、B1 栋		
13	胜宏精密	惠州市卓业产业园管理有限公司	仓储、饭堂	惠州市惠阳区三和开发区卓业科创产业园（中建电讯科技园）B3 栋	1,200	2034.12.19

注：上述第3、4、12、13项租赁房产的实际权利人惠阳中建电讯制品有限公司出租给深圳市卓业投资股份有限公司惠州分公司，并允许其将房屋进行转租，后深圳市卓业投资股份有限公司惠州分公司将其承租权利及义务转让给惠州市卓业产业园管理有限公司；上述第7项为报告期内维胜电路板所承租房屋的续期合同。

二、境外租赁房产

序号	承租方	出租方	坐落	租赁期限	用途
1	MFSS	WBL Technology (Private) Limited	Lot 2783 of Mukim 17 及其上所建的 No. 801 Lorong 7 Toa Payoh Singapore 的建筑物	2025/1/1-2027/12/31	用于手机、医疗和数据存储设备的产品/模型设计
2	MFSM	MIDF Property Berhad	No. 16, Kawasan MIEL Batu Berendam Free Trade Zone III 75350 Batu Berendam Melaka	2022/10/1-2025/10/1	生产目的及/或 MFSM 业务和贸易相关(例如生产及销售柔性印刷电路板)
3	MFSM	Acculex I Venture Holdings Sdn Bhd	Lot 6315 & 6316, Batu Berendam Free Trade Zone, Phase III, Batu Berendam, 75350 Melaka	2022/7/1-2025/6/30	仅允许作为生产工厂的运营
4	MFSM	Wanjun Precision Machining Sdn Bhd	No. 31-13A-30, The CEO, Lebu Nipah 7, Bukit Jambul, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang Malaysia	2023/4/1-2025/3/31	仅作为办公目的
5	MFSM	Yong Soon Ling	Block D, Unit 11-06, Pangsapuri Atlantis, Kota Syahbandar, Jalan KSB 11A, 75200 Melaka	2024/11/1-2025/10/31	供员工住宿

注：就上述第1项租赁房产，租赁合同将在获得相关政府机构的批准后开始履行；就上述第3项租赁房产，2025年1月，MFSM与Acculex I Venture Holdings Sdn Bhd签署了买卖协议，以获取Lot 6315及Lot 6316的所有权，截至2025年3月31日，Lot 6315及Lot 6316的最新的产权证尚在办理中，MFSM仍为Lot 6315及Lot 6316的承租方。